



中国半导体行业薪酬 及股权激励白皮书

CONTENTS

目录

1. 宏观经济	4
1.1 GDP	
1.2 CPI&PPI	
1.3 PMI	
1.4 薪酬指导线	
2. 全球趋势	8
2.1 世界 GDP 趋势	
3. 中国劳动力市场	13
3.1 人口增长率	
3.2 年龄中位数	
3.3 劳动力城镇化	
3.4 三大产业	
4. 半导体行业趋势	18
4.1 全球半导体行业趋势	
4.2 中国半导体行业趋势	
5. 半导体行业薪酬趋势	26
5.1 行业整体薪酬水平	
5.2 按照产业环节细分整体薪酬	
5.3 按照全行业职能类型划分（如研发类、支持类、工程类）	
5.4 年终奖情况	
5.4.1 中国半导体企业年终奖发放情况	
5.3.2 企业 2022 年年终奖的主要成本来源	
5.3.3 企业年终奖发放的决策依据	
5.3.4 与 2021 年相比，2022 年年终奖变化情况	
（一）细分规模及发展阶段，年终奖变化情况	
（二）细分发展阶段年终奖变化情况	
5.3.5 年终奖发放次数	
5.3.6 年终奖发放的时间	
5.3.7 年终奖发放对象	
（一）细分规模，年终奖发放对象	
（二）细分发展阶段，年终奖发放对象	
5.3.8 差异化发放年终奖的主要分配依据	

- (一) 细分规模，差异化发放年终奖的主要分配依据
- (二) 细分发展阶段，差异化发放年终奖的主要分配依据
- 5.3.9 同岗位绩优和普通人员年终奖分配差距系数
 - (一) 细分规模，同岗位绩优和普通人员年终奖分配差距系数
 - (二) 细分发展阶段，同岗位绩优和普通人员年终奖分配差距系数
- 5.3.10 企业 2022 年年终奖发放均值
 - (一) 细分规模，2022 年年终奖发放均值情况
 - (二) 细分发展阶段，2022 年年终奖发放均值情况
- 5.3.11 企业 2022 年年终奖人均金额（单位：万元）
 - (一) 细分规模，2022 年年终奖人均金额
 - (二) 细分发展阶段，2022 年年终奖人均金额
- 5.4 中国半导体企业 2023 年调薪率
 - 5.4.1 企业差异化调薪人员占比
 - 5.4.2 企业 2023 年调薪次数
 - 5.4.3 企业调薪时间
 - 5.4.4 企业 2023 年全员平均调薪率
 - (一) 细分规模，全员平均调薪率
 - (二) 细分发展阶段，全员平均调薪率
- 5.5 校招薪酬数据
 - 5.5.1 不同城市类型近三年年薪变化情况
 - 5.5.2 不同岗位类型近三年年薪变化情况
 - 5.5.3 不同高校层次薪资中位数及平均税前年薪

6. 半导体行业上市公司股权激励

- 6.1 半导体上市公司情况
- 6.1.1 半导体行业上市公司数量和板块分布
- 6.1.2 半导体细分行业首发募集资金情况
- 6.2 半导体行业公司上市后股权激励实施情况
 - 6.2.1 上市后股权激励公告情况统计
 - 6.2.2 上市后股权激励要素统计
 - 6.2.3 上市后股权激励实践情况总结
- 6.3 半导体行业公司上市前股权激励实施情况
- 6.4 半导体行业公司高管及核心员工参与战略配售情况

69

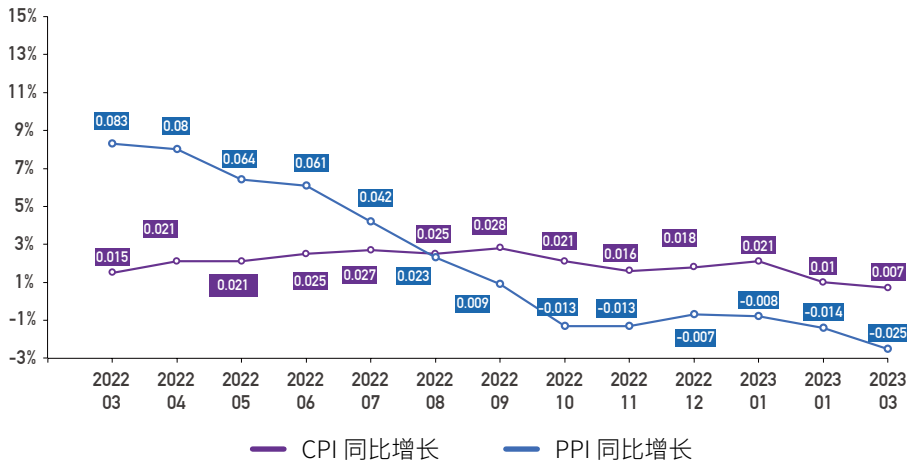


宏观经济

1.1 GDP

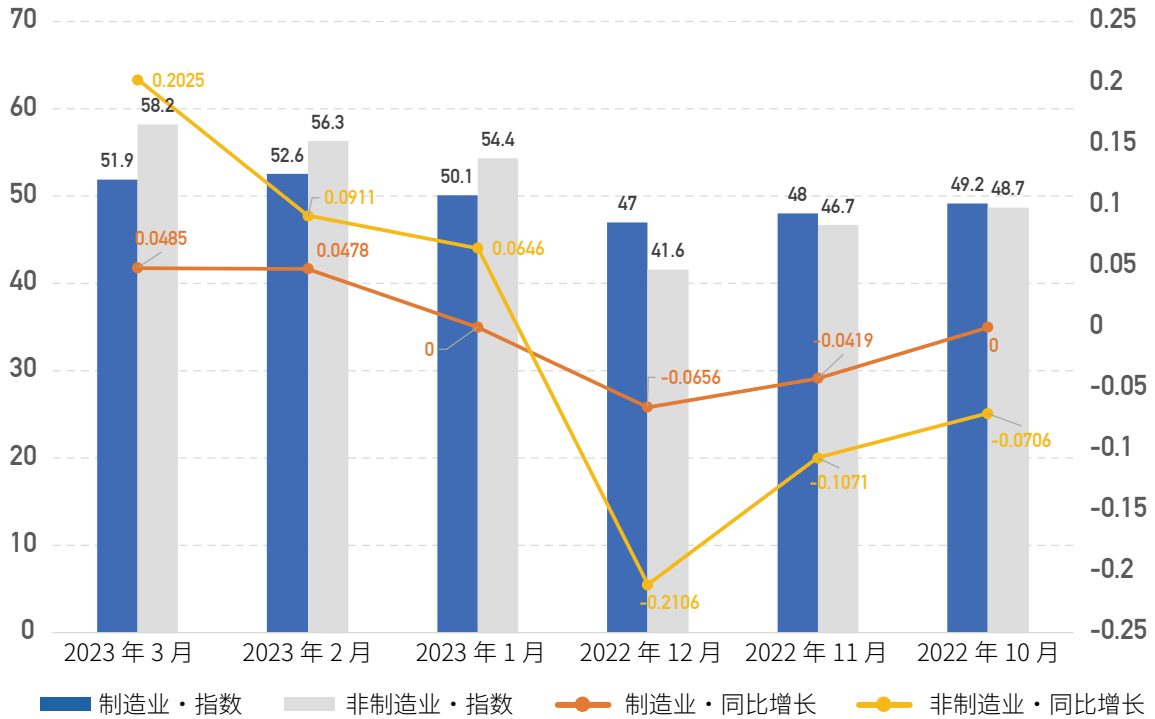
	国内生产总值		第一产业		第二产业		第三产业	
	绝对值(亿元)	同比增长	绝对值(亿元)	同比增长	绝对值(亿元)	同比增长	绝对值(亿元)	同比增长
2022年第1-4季度	1210207.2	3.00%	88345.1	4.10%	483164.5	3.80%	638697.6	2.30%
2022年第1-3季度	874699.3	3.00%	54848.5	4.20%	350563.8	3.90%	469286.9	2.30%
2022年第1-2季度	565428.7	2.50%	29165.2	5.00%	228921.7	3.20%	307341.9	1.80%
2022年第1季度	271509.2	4.80%	10950	6.00%	106283.4	5.80%	154275.8	4.00%
2021年第1-4季度	1149237	8.10%	83216.5	7.10%	451544.1	8.20%	614476.4	8.20%
2021年第1-3季度	823337.5	9.80%	51677.3	7.40%	320611.7	10.60%	451048.5	9.50%
2021年第1-2季度	532049.4	12.70%	28534.8	7.80%	206978.8	14.80%	296535.8	11.80%
2021年第1季度	249200.2	18.30%	11369.3	8.10%	92520.7	24.40%	145310.3	15.60%
2020年第1-4季度	1013567	2.30%	78030.9	3.00%	383562.4	2.60%	551973.7	2.10%
2020年第1-3季度	717948.2	0.70%	48315.2	2.30%	269843.2	0.90%	399789.9	0.40%
2020年第1-2季度	453592.5	-1.6%	26157.1	0.90%	169945.7	-1.90%	257489.7	-1.6%
2020年第1季度	205244.8	-6.8%	10222.5	-3.2%	72415.9	-9.60%	122606.3	-5.2%

1.2 CPI&PPI



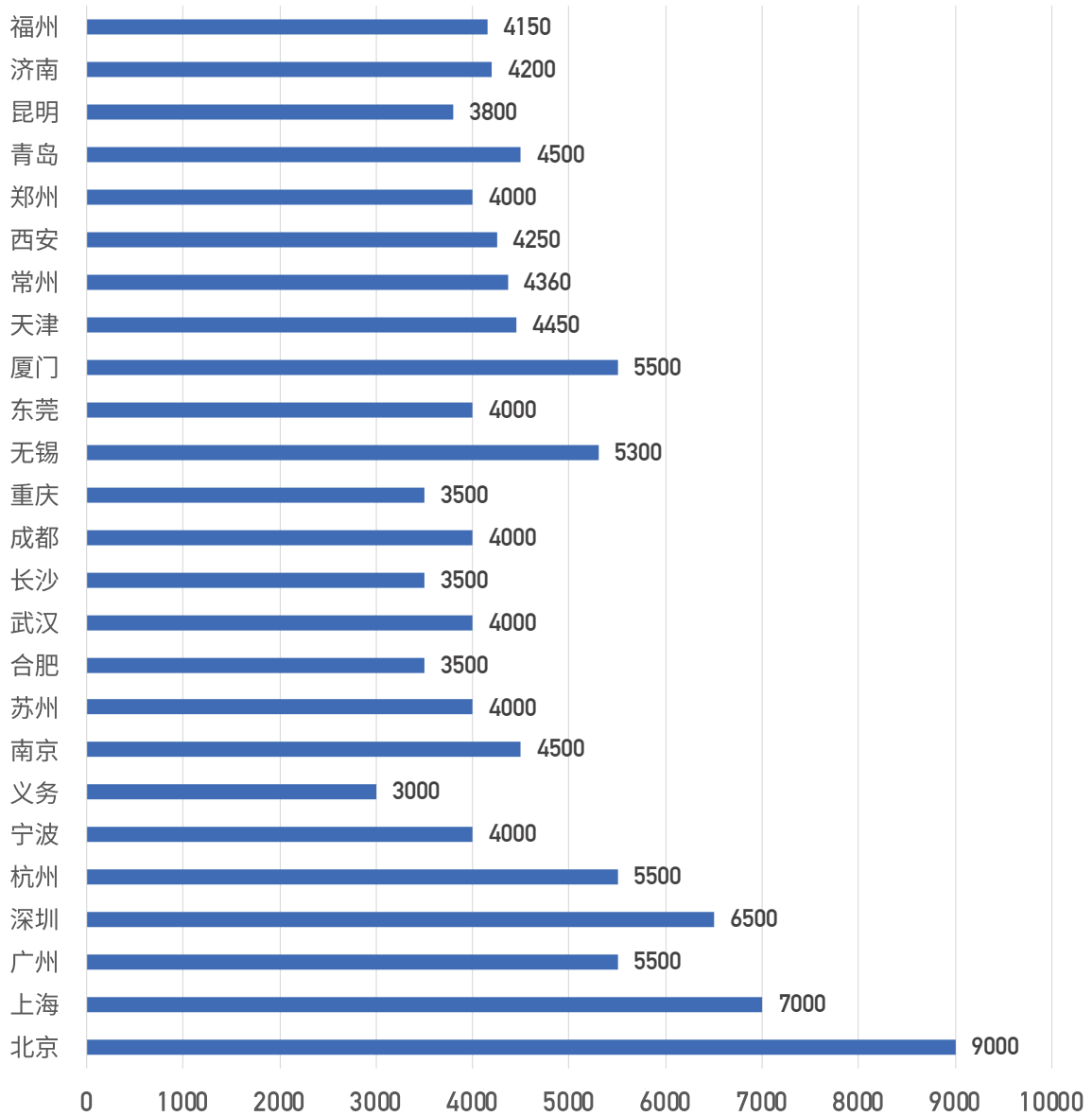
月份	CPI 同比增长	PPI 同比增长
2022.03	1.50%	8.30%
2022.04	2.10%	8.00%
2022.05	2.10%	6.40%
2022.06	2.50%	6.10%
2022.07	2.70%	4.20%
2022.08	2.50%	2.30%
2022.09	2.80%	0.90%
2022.10	2.10%	-1.30%
2022.11	1.60%	-1.30%
2022.12	1.80%	-0.70%
2023.01	2.10%	-0.80%
2023.02	1.00%	-1.40%
2023.03	0.70%	-2.50%

1.3 PMI



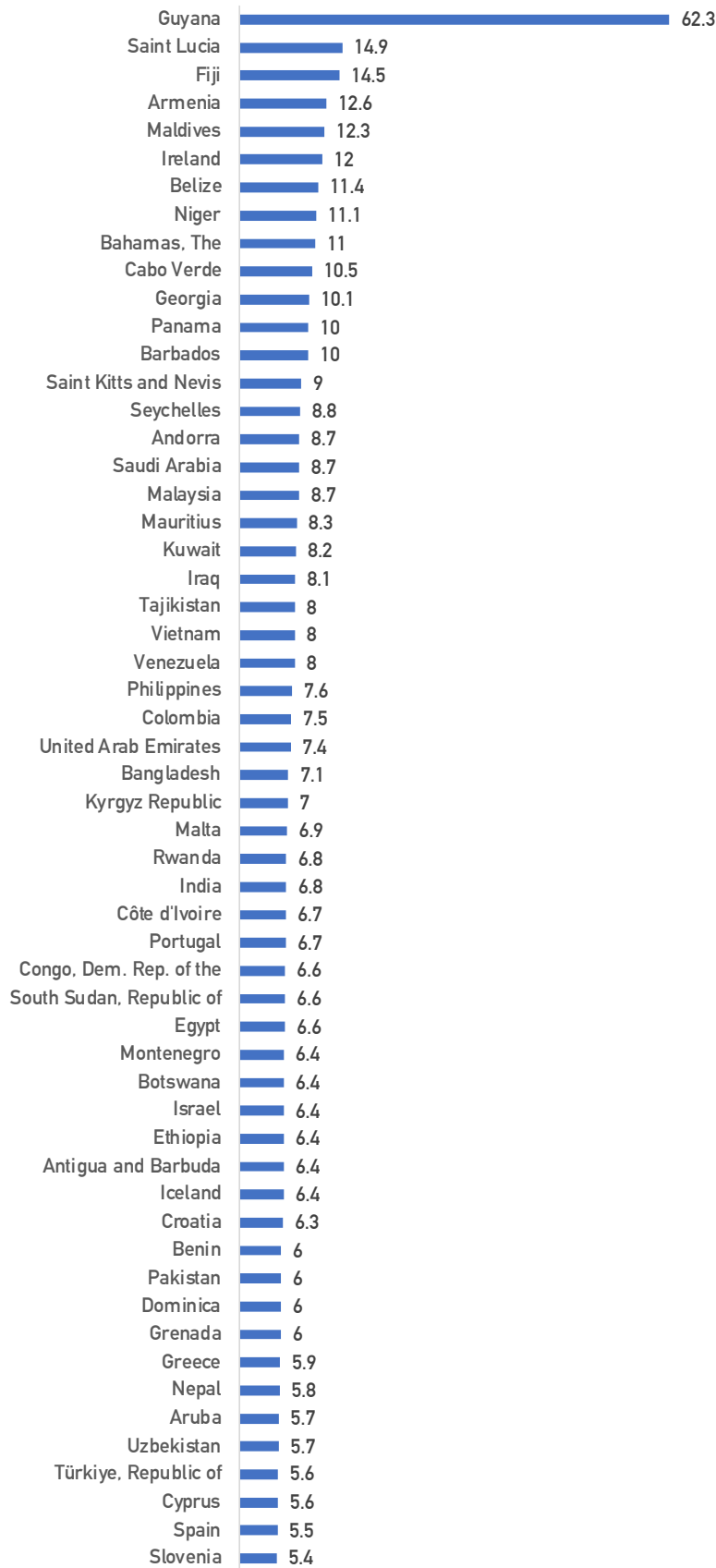
月份	CPI 同比增长	PPI 同比增长	CPI 同比增长	PPI 同比增长
2023.03	51.9	4.85%	58.2	20.25%
2023.02	52.6	4.78%	56.3	9.11%
2023.01	50.1	0.00%	54.4	6.46%
2022.12	47	-6.56%	41.6	-21.06%
2022.11	48	-4.19%	46.7	-10.71%
2022.10	49.2	0.00%	48.7	-7.06%

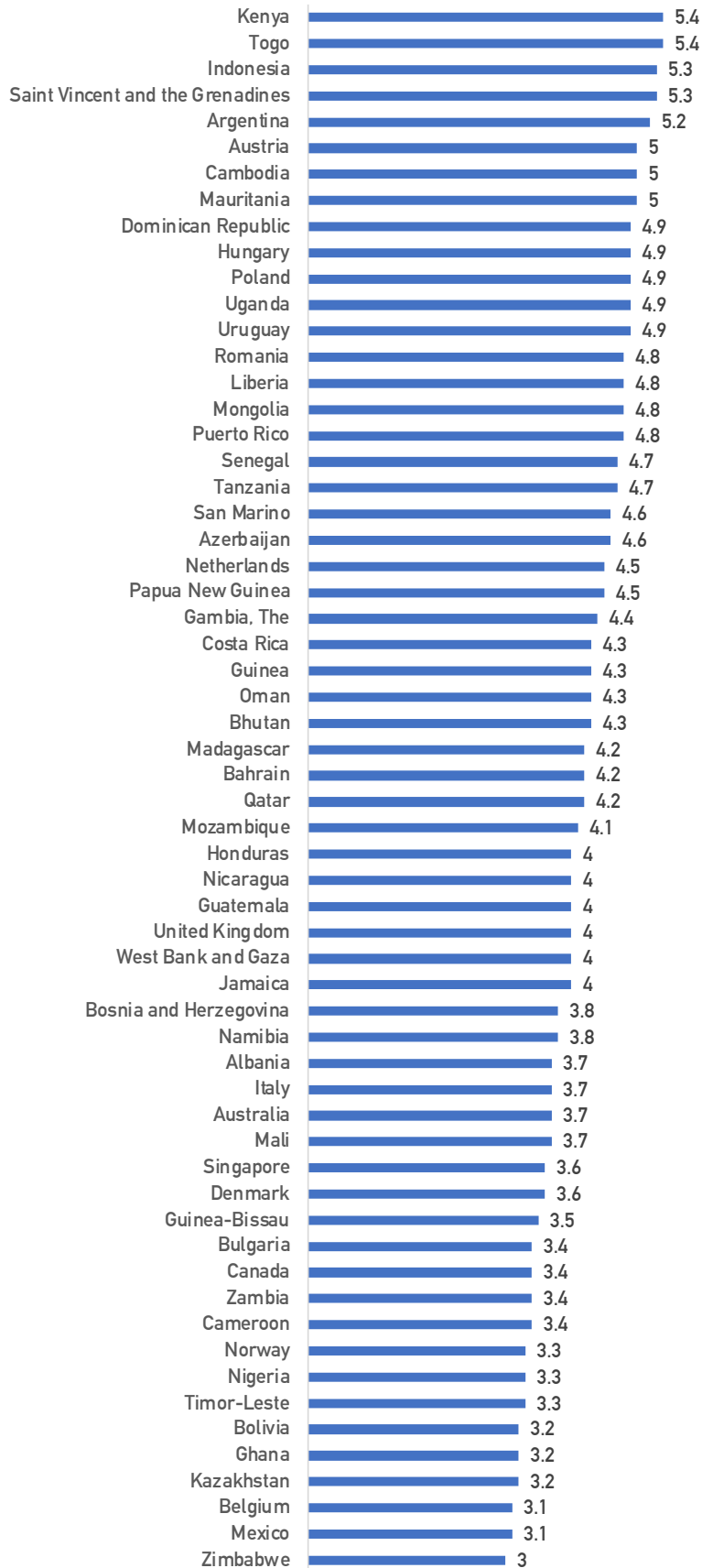
1.4 薪酬指导线

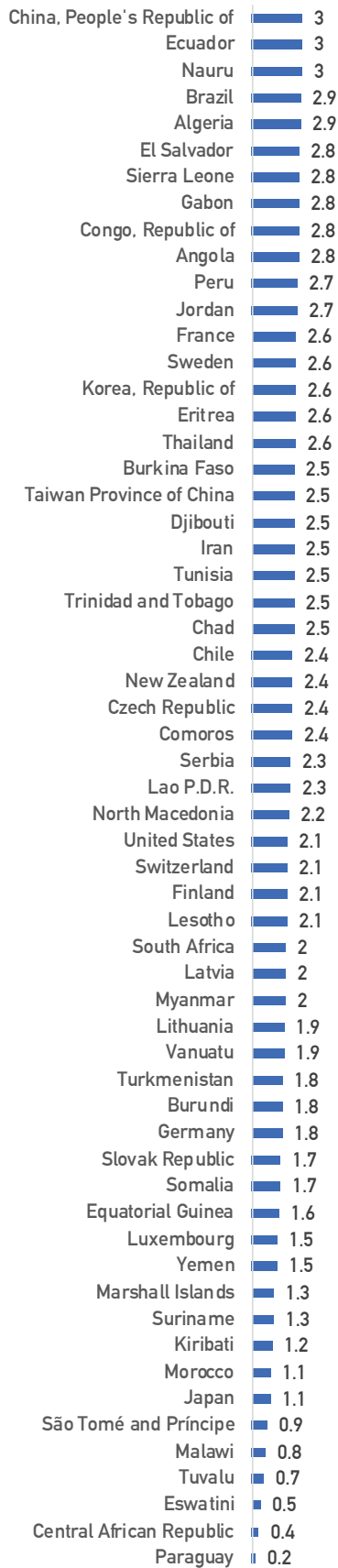


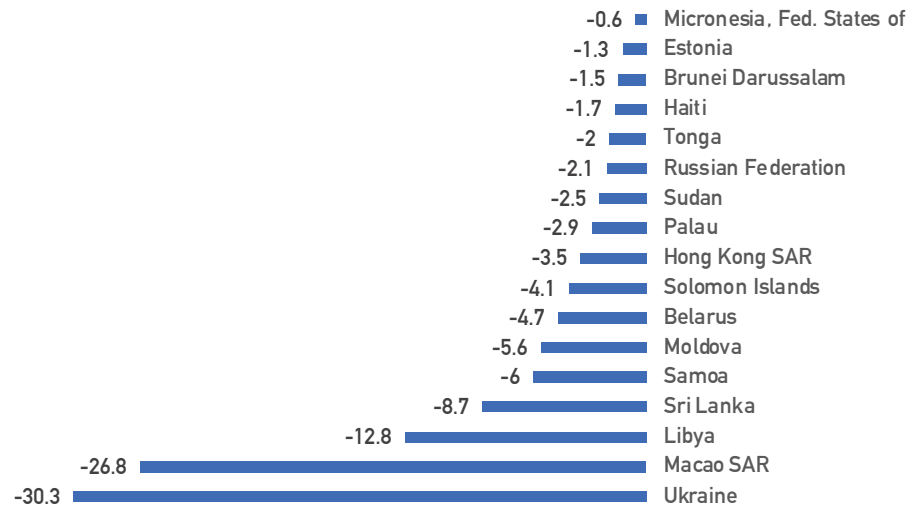


全球趋势









Gross domestic product is the most commonly used single measure of a country's overall economic activity. It represents the total value at constant prices of final goods and services produced within a country during a specified time period, such as one year. Source: World Economic Outlook (April 2023)

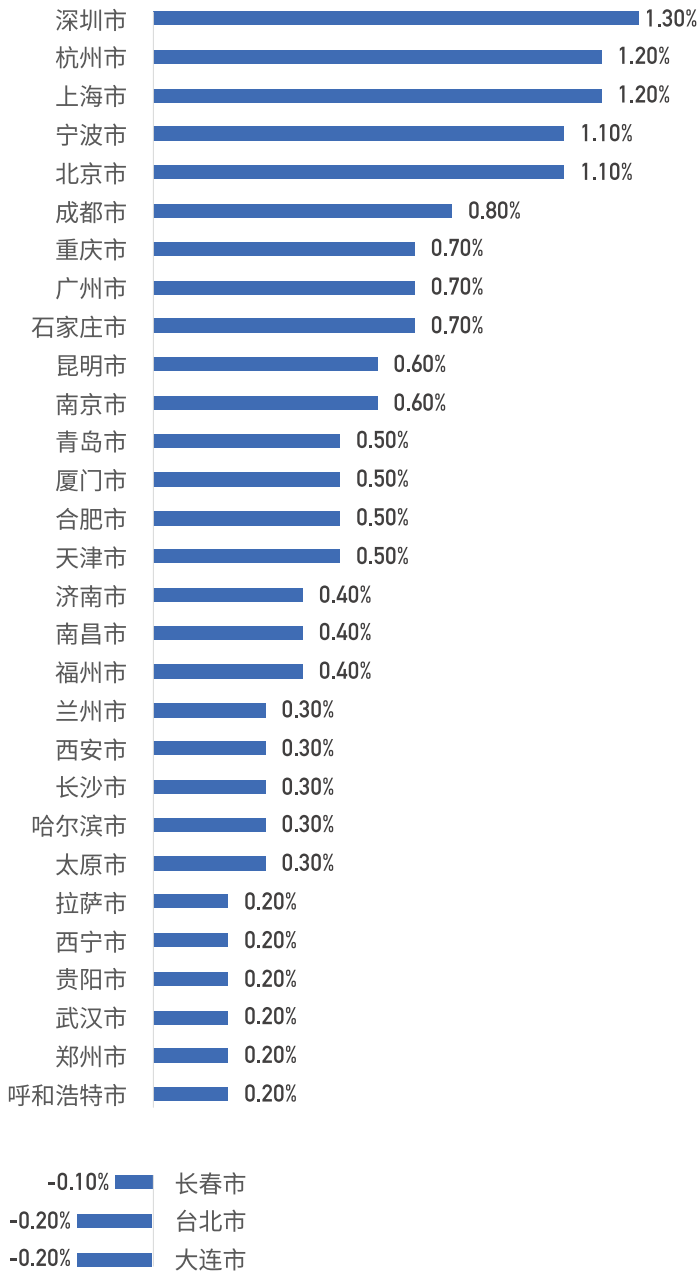


3

中国劳动力市场

3.1 人口增长率

以下是 2021 年中国各城市的人口增长率（仅包括常住人口）：



需要注意的是，人口增长率受多种因素影响，包括出生率、死亡率、迁入和迁出等，不同城市之间的增长率也会因为各种因素而有所差异。

3.2 年龄中位数

中国人力资本指数报告披露
全国劳动力人口平均年龄上升到 **39** 岁



3.3 劳动力城镇化

报告还披露，2001-2020 年间，中国实际人力资本总量增长 4.0 倍。2001-2010 年间，中国人力资本总量的年均增长率为 10.3%，其中城镇人力资本总量的年均增长率为 12.2%，而农村为 5.8%；2011-2020 年间，中国人力资本总量的年均增长率为 7.7%，其中城镇人力资本总量的年均增长率为 9.1%，而农村为 2.0%。



3.3 三大产业

指标	地区	数据时间	数值	所属栏目
第一产业增加值(亿元)	全国	2022年	88345.1	年度数据
第一产业增加值(亿元)	全国	2021年	83216.5	年度数据
第二产业增加值(亿元)	全国	2022年	483164.5	年度数据
第二产业增加值(亿元)	全国	2021年	451544.1	年度数据
第三产业增加值(亿元)	全国	2022年	638697.6	年度数据
第三产业增加值(亿元)	全国	2021年	614476.4	年度数据

指标	地区	数据时间	数值	所属栏目
第一产业就业人员(万人)	全国	2021年	17072	年度数据
第二产业就业人员(万人)	全国	2022年	-	年度数据
第二产业就业人员(万人)	全国	2021年	21712	年度数据
第三产业就业人员(万人)	全国	2022年	-	年度数据
第三产业就业人员(万人)	全国	2021年	35868	年度数据

指标	地区	数据时间	数值	所属栏目
第一产业法人单位数(个)	全国	2021年	1915236	年度数据
第二产业法人单位数(个)	全国	2022年	-	年度数据
第二产业法人单位数(个)	全国	2021年	6697618	年度数据
第三产业法人单位数(个)	全国	2022年	-	年度数据
第三产业法人单位数(个)	全国	2021年	24254118	年度数据

指标	地区	数据时间	数值	所属栏目
第一产业对GDP的贡献率(%)	全国	2022年	10.5	年度数据
第一产业对GDP的贡献率(%)	全国	2021年	6.4	年度数据
第二产业对GDP的贡献率(%)	全国	2022年	47.7	年度数据
第二产业对GDP的贡献率(%)	全国	2021年	38.9	年度数据
第三产业对GDP的贡献率(%)	全国	2022年	41.8	年度数据
第三产业对GDP的贡献率(%)	全国	2021年	54.7	年度数据

指标	地区	数据时间	数值	所属栏目
第一产业对国内生产总值增长的拉动(百分点)	全国	2022年	0.3	年度数据
第一产业对国内生产总值增长的拉动(百分点)	全国	2021年	0.5	年度数据
第二产业对国内生产总值增长的拉动(百分点)	全国	2022年	1.4	年度数据
第二产业对国内生产总值增长的拉动(百分点)	全国	2021年	3.3	年度数据
第三产业对国内生产总值增长的拉动(百分点)	全国	2022年	1.3	年度数据
第三产业对国内生产总值增长的拉动(百分点)	全国	2021年	4.6	年度数据

指标	地区	数据时间	数值	所属栏目
第一产业增加值指数(上年=100)	全国	2022年	104.1	年度数据
第一产业增加值指数(上年=100)	全国	2021年	107.1	年度数据
第二产业增加值指数(上年=100)	全国	2022年	103.8	年度数据
第二产业增加值指数(上年=100)	全国	2021年	108.7	年度数据
第三产业增加值指数(上年=100)	全国	2022年	102.3	年度数据



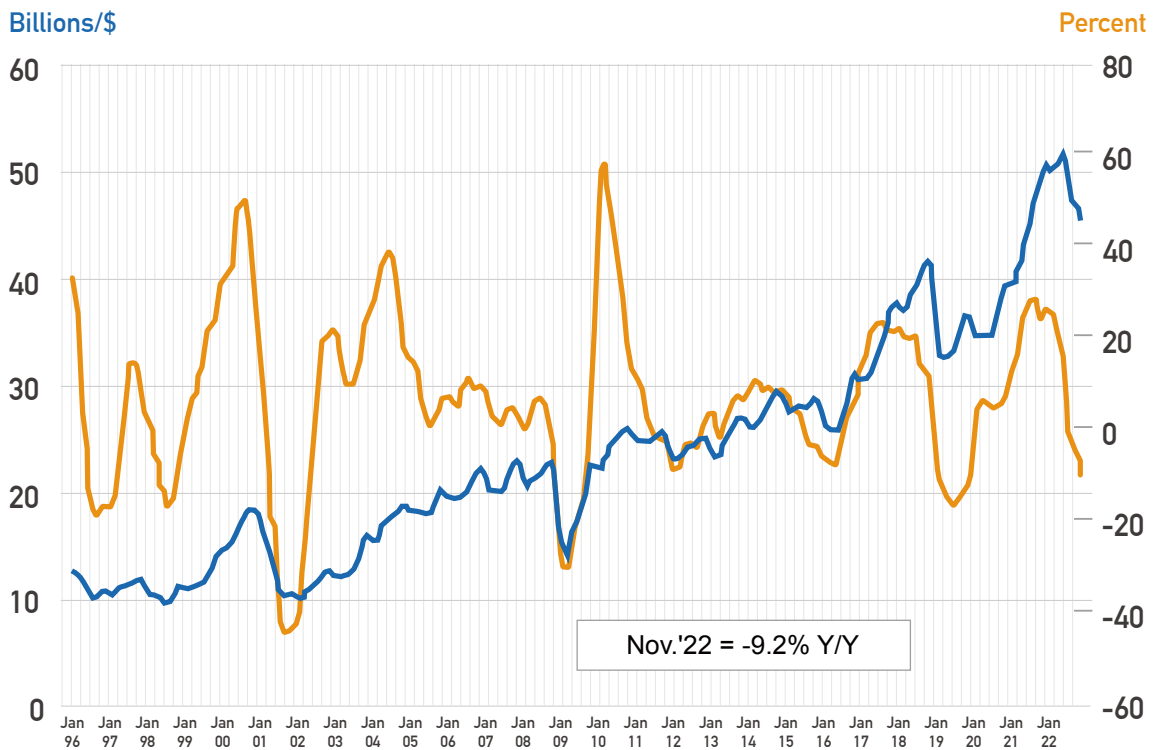
半导体行业趋势

4.1 全球半导体行业趋势

根据美国半导体行业协会 (SIA) 2023 年 2 月公布的数据显示, 即便去年下半年半导体市场持续下滑, 但是 2022 年全球半导体销售金额仍达到 5,735 亿美元, 创下了历史新高纪录。

SIA 表示, 2022 年全球半导体销售金额较 2021 年的 5,559 亿美元增长 3.2%。不过, 2022 年下半年市场持续下滑之后, 第四季销售金额降至 1,302 亿美元, 较 2021 年同期已下滑 14.7%, 较 2022 年第三季也下滑了 7.7%。另外, 2022 年 12 月全球半导体销售金额也降至 434 亿美元, 较 2022 年 11 月下滑 4.4%。

Worldwide Semiconductor Revenues Year-to-Year Percent Change

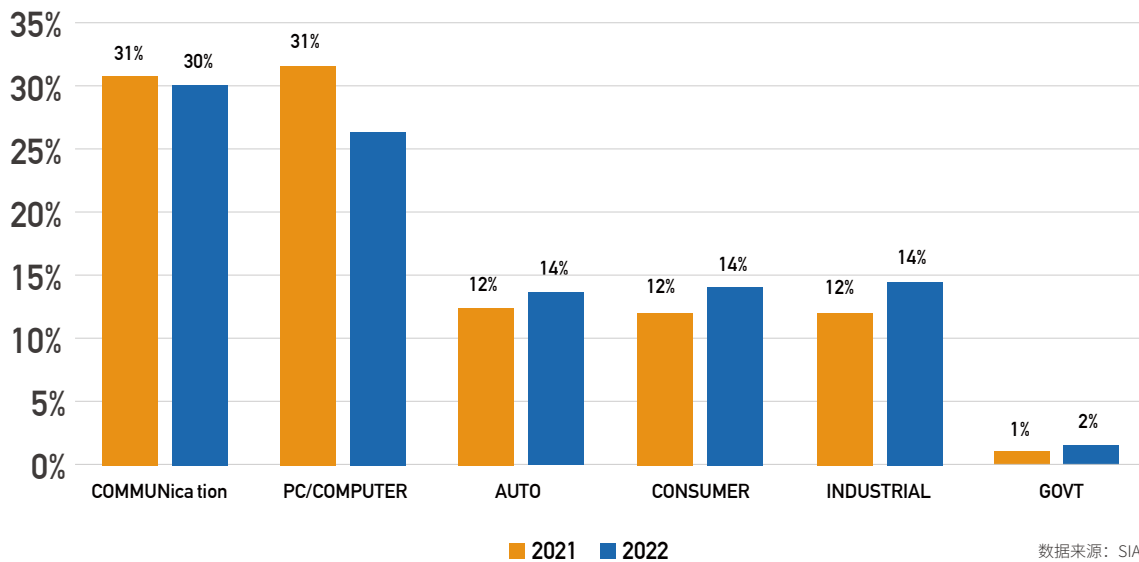


Source: WSTS

— Revenue — Y/Y % Change

数据来源: SIA

Share of Global Sales Revenue by End Market 2021-2022



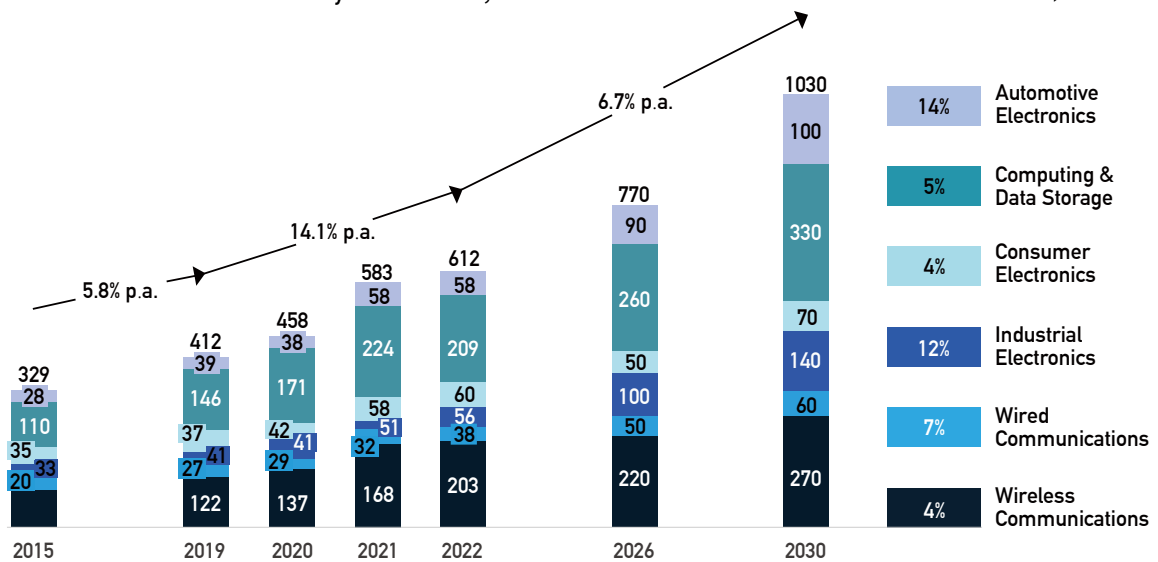
以产品品类划分来看,用于汽车、消费品和计算机的模拟半导体,年成长率达到 7.5%,整体 2022 年销售金额达到 890 亿美元。而逻辑半导体在 2022 年的销售金额为 1,760 亿美元,存储芯片的销售金额 1,300 亿美元,两者是销售金额最大的半导体类别。最后,受到瞩目的汽车半导体销售金额达到创纪录的 341 亿美元,较 2021 年增长 29.2%。

报告指出,根据麦肯锡的分析,2021-2030 年,汽车和工业市场的半导体需求的复合年增长率分别为 14% 和 12%。而其他应用在此期间的复合年增长率不足 10%,汽车和工业将成为半导体需求增长的重要推动力。

2021-2030 年,全球半导体各应用市场需求规模和复合年增长率

Global semiconductor demand by end-market¹, in USD bn

CAGR 2021-30, in %



尽管当前全球半导体市场陷入短期低迷，但长期来看，芯片需求有望呈现强劲增长态势。据悉，美国半导体产业将通过迄今为止超过 2000 亿美元的私人投资提升本土半导体制造能力。

前 15 大半导体供应商在 2022 年第四季度的收入比在 2022 年第三季度下降了 14%。降幅最大的是存储器公司，下降了 25%。非内存公司下跌 9%。15 家公司中有 4 家的收入略有增长，增幅从 0.1% 到 2.4% 不等，分别是英伟达（Nvidia）、AMD、意法半导体和 ADI。

Top Semiconductor Companies Revenue

Change versus prior quarter in local currency

Company	US\$B 4Q22	Reported 4Q22	Guidance 1Q23	Comments on 1Q23
1.Samsung SC	15.9	-13%	n/a	Inventory adjustments
2.Intel	14.0	-21.7%	-21.7%	Excess inventory in PCs
3.Broadcom	8.9	-0.3%	n/a	4Q22 is 3Q22 guidance
4.Qualcomm(IC)	7.9	-20%	-2.4%	Inventory adjustments
5.SKHynix	6.1	-30%	n/a	PC market decline
6.Nvidia	6.0	1.2%	n/a	4Q22 is 3Q22 guidance
7.AMD	5.6	0.6%	-5.3%	Declines in client & gaming
8.TI	4.7	-11%	-6.9%	Declines except automotive
9.STMicro	4.4	2.4%	-5.1%	Auto & industrial strong
10.Infineon	4.2	-4.6%	-1.3%	Auto & industrial strong
11.Micron	4.1	-39%	-7.0%	Inventory levels improving
12.MediaTek	3.6	-24%	-10%	Inventory adjustments
13.NXP	3.3	-3.9%	-9.4%	Auto & industrial strong
14.Analog Devices	3.3	0.1%	-1.5%	Growth in industrial & auto
15.Kioxia	2.1	-26%	n/a	PC & smartphone weak
Total of above		-14%	n/a	
Memory Cos.(US\$)		-25%	n/a	Samsung-Hynix-Micron-Kioxia
Non-Memory Cos.		-9%	-10%	

数据来源：SIA

2023 年第一季度，顶级公司的前景普遍黯淡。半导体行业通常在每年第一季度疲软，但大多数公司预计 2023 年第一季度将弱于正常水平。提供 2023 年第一季度收入报表的九家非内存公司的加权平均跌幅为 10%，九家公司均预计会出现下滑。英特尔最为悲观，预计跌幅达 22%。多家公司将库存调整列为致使前景黯淡的关键因素，尤其是在个人电脑（PC）和智能手机终端市场。

2023 年全年，半导体市场肯定会下滑，但下滑的幅度取决于库存何时恢复正常，以及电子设备的整体需求如何。Gartner 发布的数据显示，2023 年智能手机和 PC 的出货量将下降，但降幅明显低于 2022 年。智能手机出货量 2022 年下降 11%，2023 年预计下降 4%。PC 出货量 2022 年下降 16%，2023 年预计下降 7%。PC 和智能手机的前景长期呈低个位数增长。IDC 预测 2023 年至 2026 年智能手机的复合年增长率 (CAGR) 为 3.1%，PC 和平板电脑的复合年增长率为 2.3%。

Key Semiconductor Drivers Forecast Change

	2022	Source
Smartphones	-11%	Gartner, Jan.2023
PCs	-16%	Gartner, Jan.2023
Light Vehicle Production	6.0%	S&P Global Mobility, Dec.2022
	CAGR:2023-2026	
Smartphones	3.1%	IDC,Dec.2022
PC&Tablets	2.3%	

数据来源：SIA

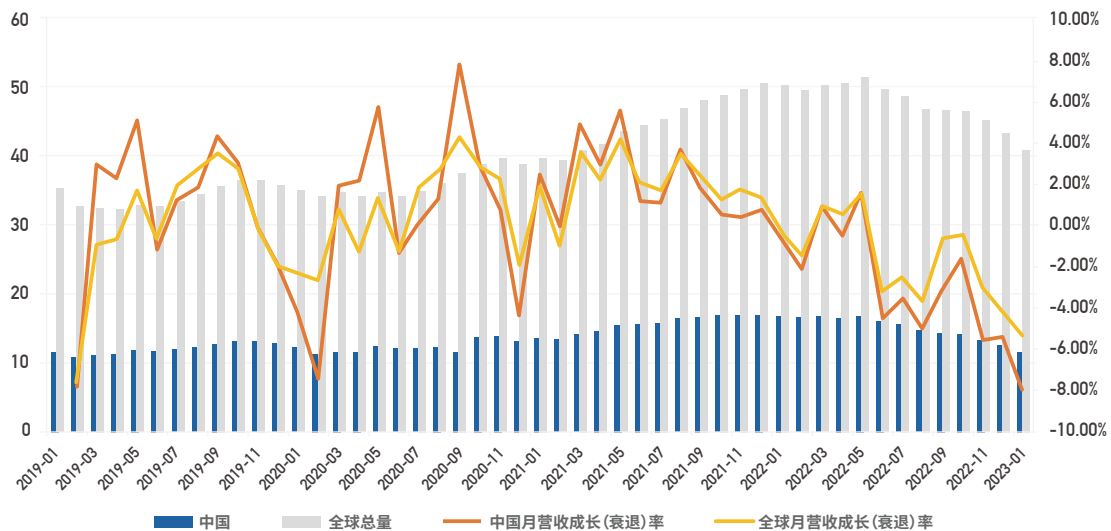
从地区来看，日本 2 月份的同比销售额略有增长 (1.2%)，但欧洲 (-0.9%)、美洲 (-14.8%)、亚太地区 / 所有其他 (-22.1%) 和中国有所下降 (-34.2%)。所有地区的月度销售额均下降：欧洲 (-0.3%)、日本 (-0.3%)、亚太地区 / 所有其他 (-3.6%)、美洲 (-5.3%) 和中国 (-5.9%)。

4.2 中国半导体行业趋势

(截止 2023 年 4 月 15 日 未获得 2022 年最新官方数据)

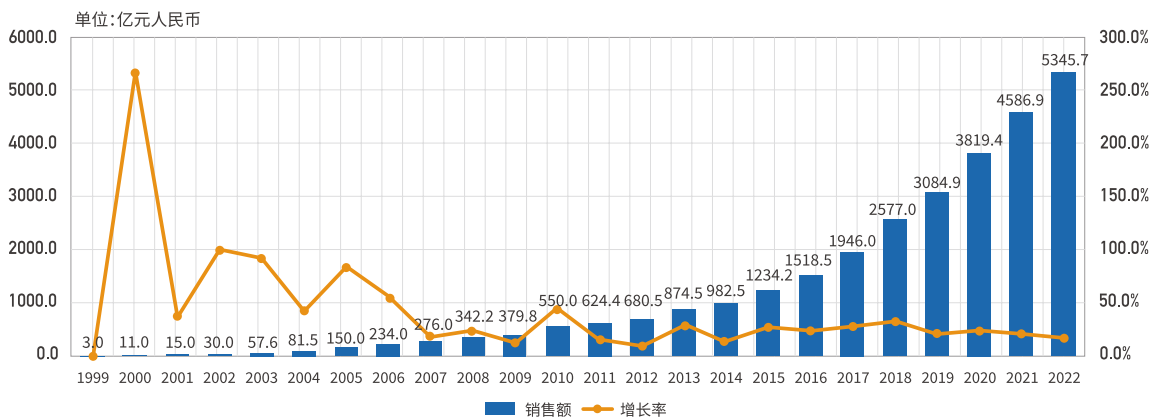
根据 SIA 数据显示,2022 年我国半导体销售额为 1858.1 亿美元,约合人民币 同比下降 1.37%。

我国和全球半导体月销售额 (10 亿美元)



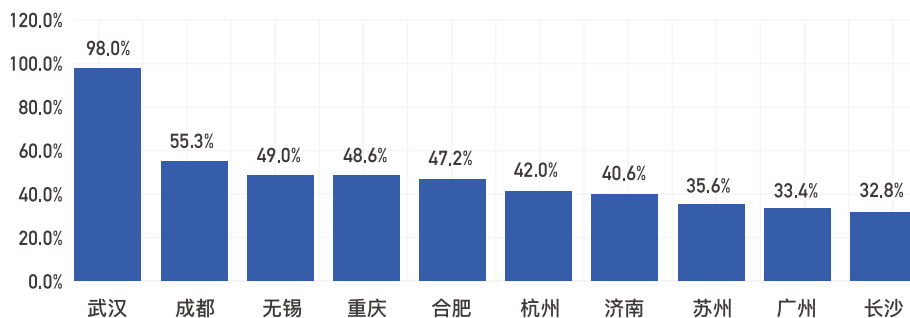
根据中国半导体行业协会集成电路设计分会统计,2022 年国内芯片设计企业的数量已达到 3,243 家,比 2021 年的 2,810 家增加 433 家,数量增长了 15.4%。2022 芯片设计行业销售额预计为 5,345.7 亿元,按照美元与人民币 1:6.8 的平均兑换率,全年销售约为 787.4 亿美元,比 2021 年的 4,586.9 亿元增长 16.5%,增速比 2021 年的 20.1% 降低了 3.6 个百分点。

1999-2022 年设计业销售规模



对主要城市的集成电路设计业统计显示 2022 年，除了大连、香港和福州外其它城市的设计业都录得正增长。排在第一名的武汉市增长 98.0%，第二名成都市增长了 55.3%；所有进入前十的城市的的设计业增速都超过了 30%。

设计业增速最高的十座城市



排序	2021 年		2022 年	
	城市	增长率	城市	增长率
1	济南	193.9%	武汉	98.0%
2	天津	120.0%	成都	55.3%
3	南京	107.0%	无锡	49.0%
4	广州	99.6%	重庆	48.6%
5	无锡	98.1%	合肥	47.2%
6	合肥	86.9%	杭州	42.0%
7	福州	76.4%	济南	40.6%
8	杭州	72.5%	苏州	35.6%
9	北京	69.8%	广州	33.4%
10	成都	66.0%	长沙	32.8%

数据来源：中国半导体行业协会集成电路设计分会

对主要城市的集成电路设计业统计显示，2022 年，除了大连、香港和福州外，其它城市的设计业都录得正增长。排在第一名的武汉市增长 98.0%，第二名成都市增长了 55.3%；所有进入前十的城市的的设计业增速都超过了 30%。

从数据上看，各个产品领域的业绩都在提升。消费类芯片的销售增长最快，达到 24.7%，多媒体芯片紧随其后，增长 22.5%，计算机增长 13.8%，通信芯片增长 10.3%

产品领域分布情况

排序	领域	企业	2022 比例	销售总额	销售增长
1	通信	635	19.6%	1136.2	10.3%
2	智能卡	85	2.6%	85.0	4.3%
3	计算机	395	12.2%	342.8	13.8%
4	多媒体	122	3.8%	290.5	22.5%
5	导航	74	2.3%	41.7	8.6%
6	模拟	414	12.8%	554.9	2.5%
7	功率	236	7.3%	318.4	9.2%
8	消费类	1282	39.5%	2,576.3	24.7%
	总计	3243	100.0%	5,345.8	16.5%

数据来源：中国半导体行业协会集成电路设计分会



5

半导体行业薪酬水平

本章节薪酬数据时间区间为2022年4月至2023年3月(近一年)

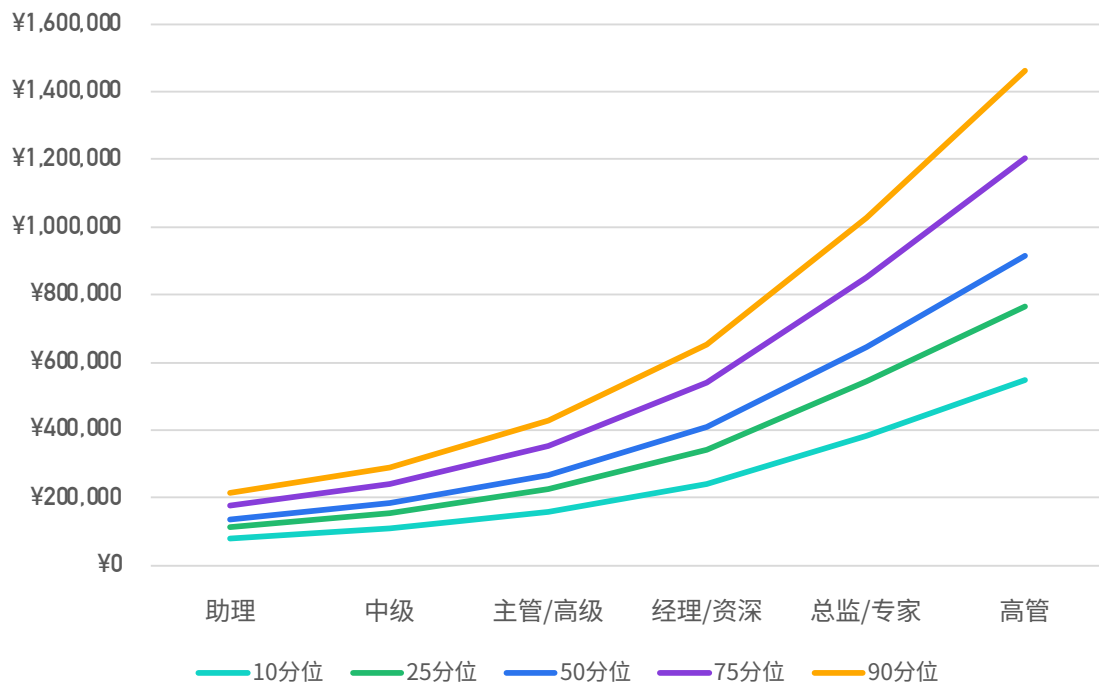
数据来源：薪智 x 半导体 HR 公会智能薪酬 SAAS 平台

smartsalary.isee-hr.cn

5.1 行业整体薪酬水平

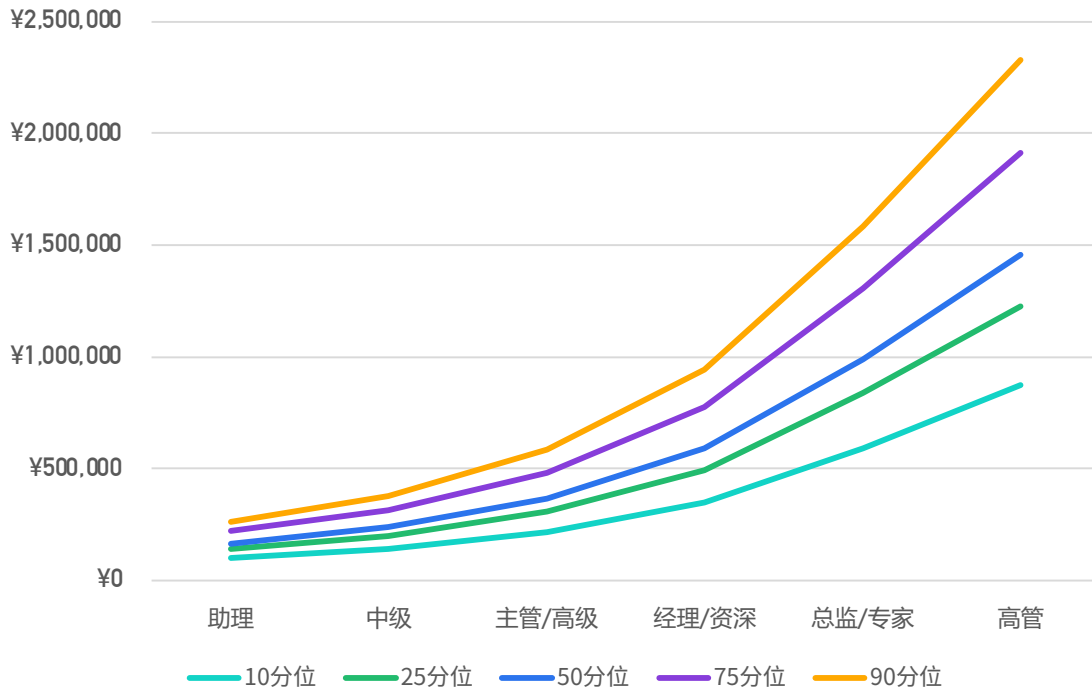
统计口径：年固定薪酬 单位：元（人民币）

职级	10分位	25分位	50分位	75分位	90分位
助理	80,539	112,820	134,517	177,220	214,103
中级	108,615	152,345	182,377	240,769	290,326
主管/高级	158,336	224,471	268,023	353,588	428,185
经理/资深	239,689	342,675	407,710	538,663	650,878
总监/专家	384,546	544,691	646,879	852,430	1,029,147
高管	548,366	766,491	913,570	1,202,517	1,462,194



统计口径：年总现金收入 单位：元（人民币）

职级	10分位	25分位	50分位	75分位	90分位
助理	100,168	140,101	167,245	220,500	265,723
中级	141,399	198,330	237,406	313,561	377,949
主管/高级	216,508	307,344	366,433	483,742	584,665
经理/资深	346,852	495,371	590,326	778,880	942,852
总监/专家	590,241	837,446	992,664	1,308,041	1,583,126
高管	872,810	1,226,890	1,456,270	1,913,978	2,327,603

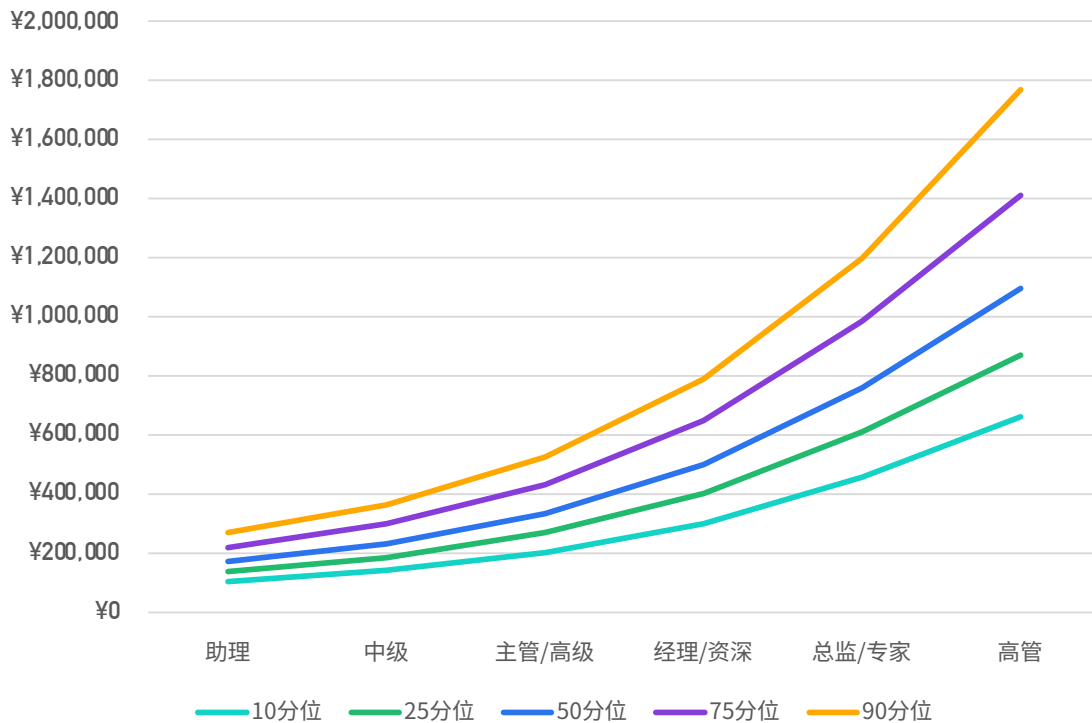


5.2 按照产业环节细分整体薪酬

IC 设计

统计口径：年固定薪酬 单位：元（人民币）

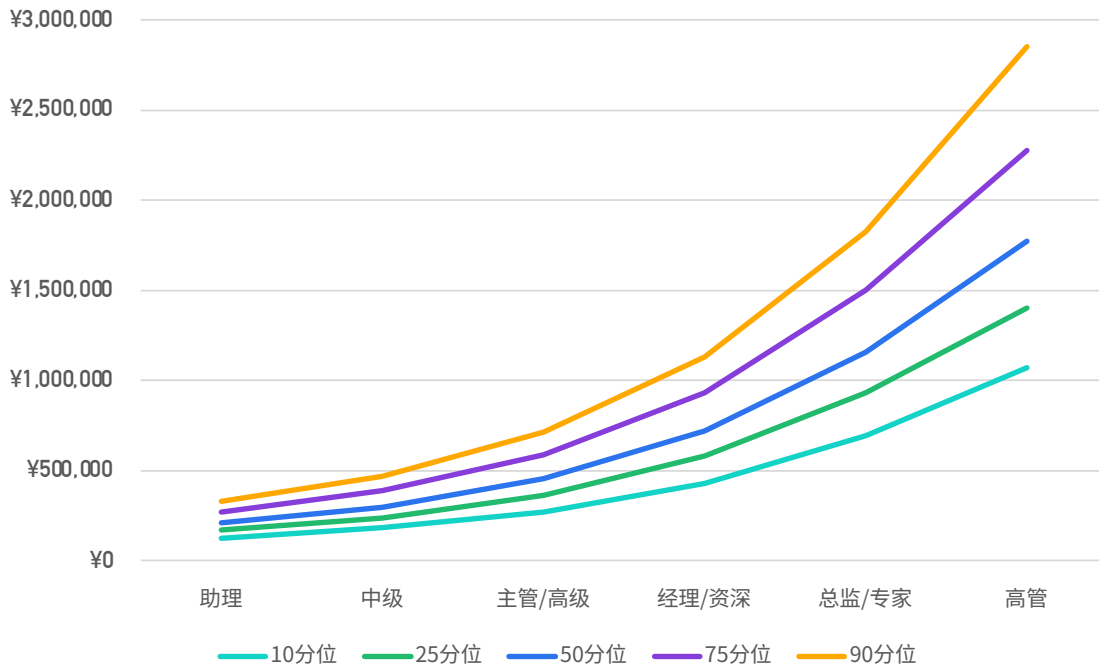
职级	10分位	25分位	50分位	75分位	90分位
助理	103,706	136,961	170,560	220,845	269,624
中级	140,141	184,374	231,391	300,830	364,006
主管/高级	201,088	269,534	334,721	433,735	527,538
经理/资深	300,279	403,316	498,830	649,749	788,440
总监/专家	457,863	612,799	760,609	984,355	1,199,624
高管	662,534	871,839	1,097,935	1,409,437	1,768,949



IC 设计

统计口径：年总现金收入 单位：元（人民币）

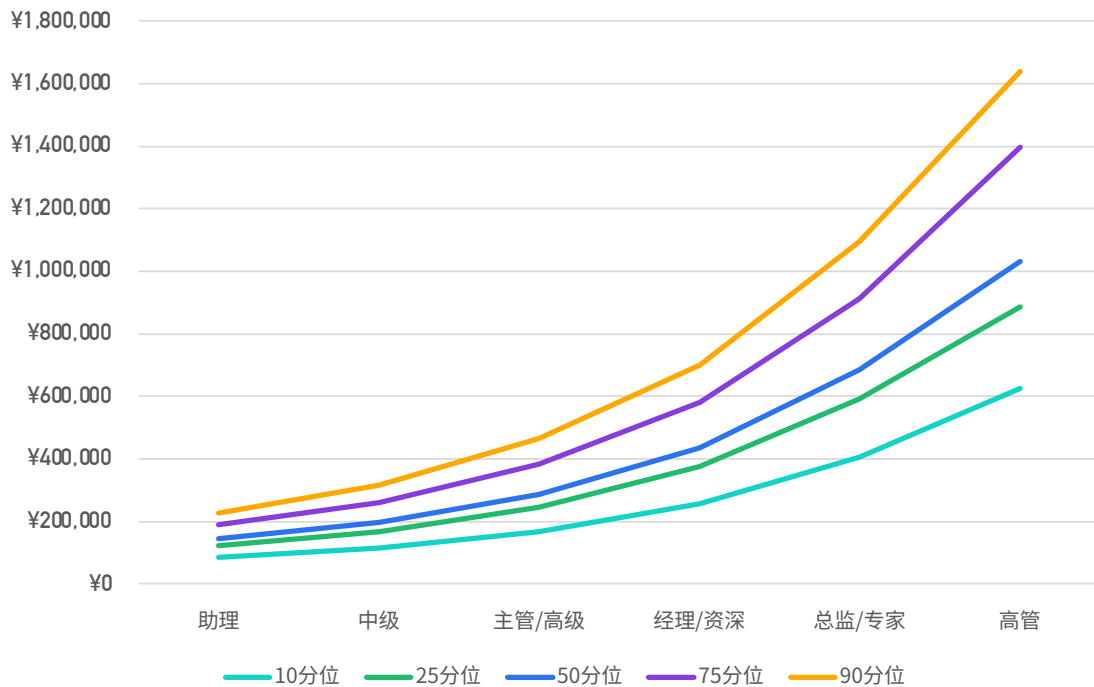
职级	10分位	25分位	50分位	75分位	90分位
助理	127,233	168,427	209,645	271,604	331,393
中级	181,764	238,493	299,413	389,580	470,844
主管/高级	272,469	365,290	454,005	588,346	715,345
经理/资深	431,796	580,760	718,149	934,719	1,134,263
总监/专家	697,631	934,552	1,158,560	1,500,100	1,827,475
高管	1,069,418	1,404,751	1,770,451	2,274,449	2,855,891



IP/EDA

统计口径：年固定薪酬 单位：元（人民币）

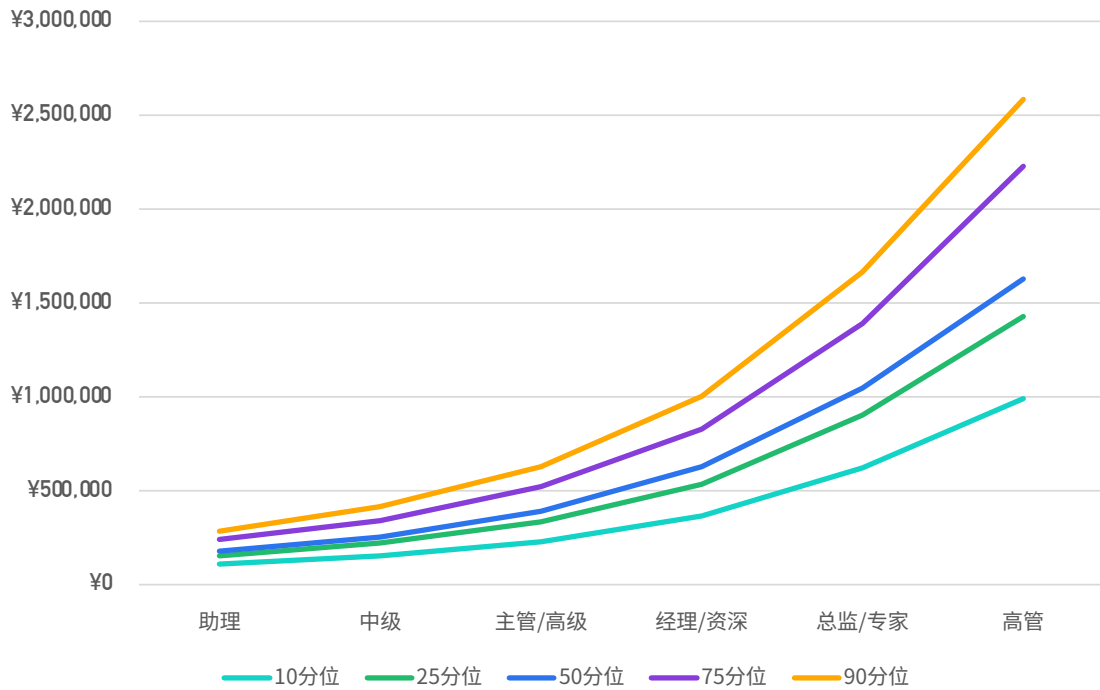
职级	10分位	25分位	50分位	75分位	90分位
助理	103,706	136,961	170,560	220,845	269,624
中级	140,141	184,374	231,391	300,830	364,006
主管/高级	201,088	269,534	334,721	433,735	527,538
经理/资深	300,279	403,316	498,830	649,749	788,440
总监/专家	457,863	612,799	760,609	984,355	1,199,624
高管	662,534	871,839	1,097,935	1,409,437	1,768,949



IP/EDA

统计口径：年总现金收入 单位：元（人民币）

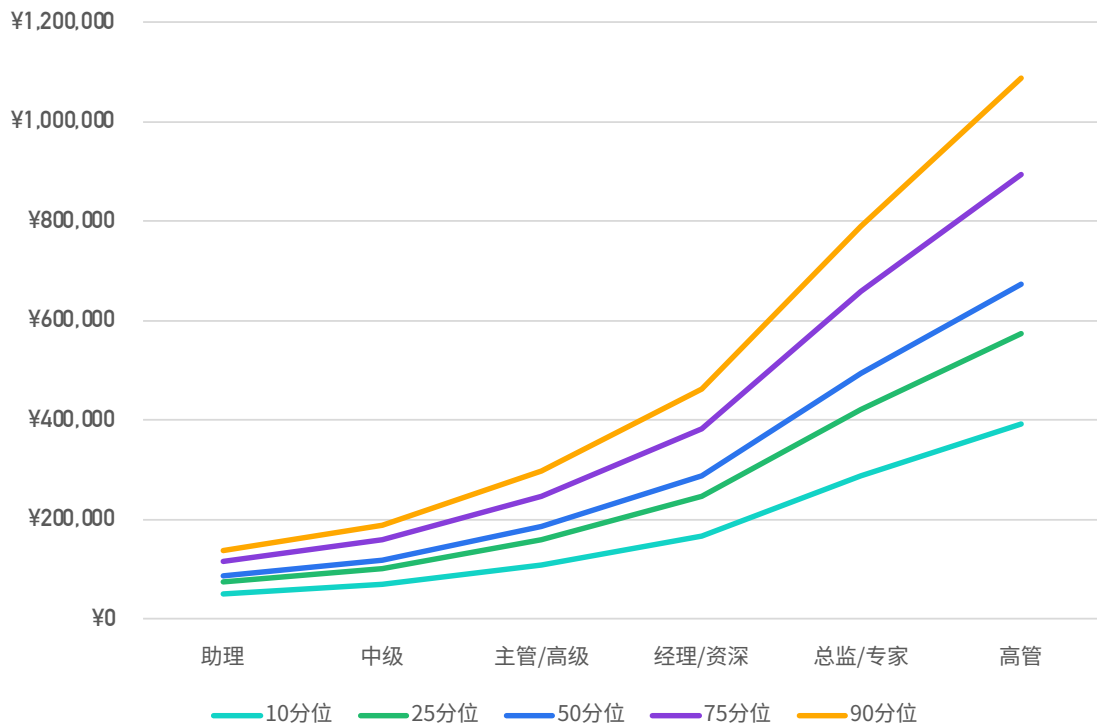
职级	10分位	25分位	50分位	75分位	90分位
助理	85,366	124,121	143,504	191,137	228,675
中级	115,493	168,909	195,791	261,248	316,778
主管/高级	167,280	246,273	285,853	382,240	464,573
经理/资深	254,879	376,132	437,102	582,540	700,368
总监/专家	405,437	592,511	685,099	911,267	1,095,480
高管	625,248	887,174	1,029,958	1,396,341	1,639,735



封测

统计口径：年固定薪酬 单位：元（人民币）

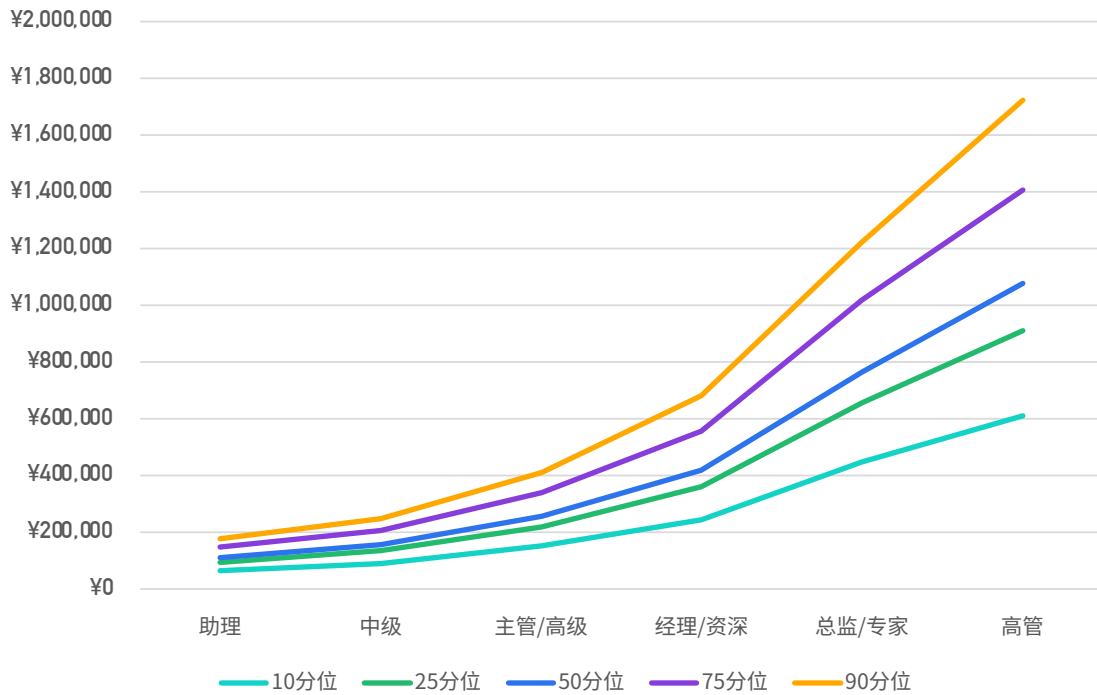
职级	10分位	25分位	50分位	75分位	90分位
助理	51,448	74,593	86,882	116,119	139,096
中级	69,411	101,952	118,810	158,579	189,706
主管/高级	108,657	158,759	185,635	246,576	297,428
经理/资深	166,817	246,734	287,712	381,732	462,178
总监/专家	288,747	422,565	493,094	659,810	789,630
高管	393,528	574,514	672,615	894,627	1,089,018



封测

统计口径：年总现金收入 单位：元（人民币）

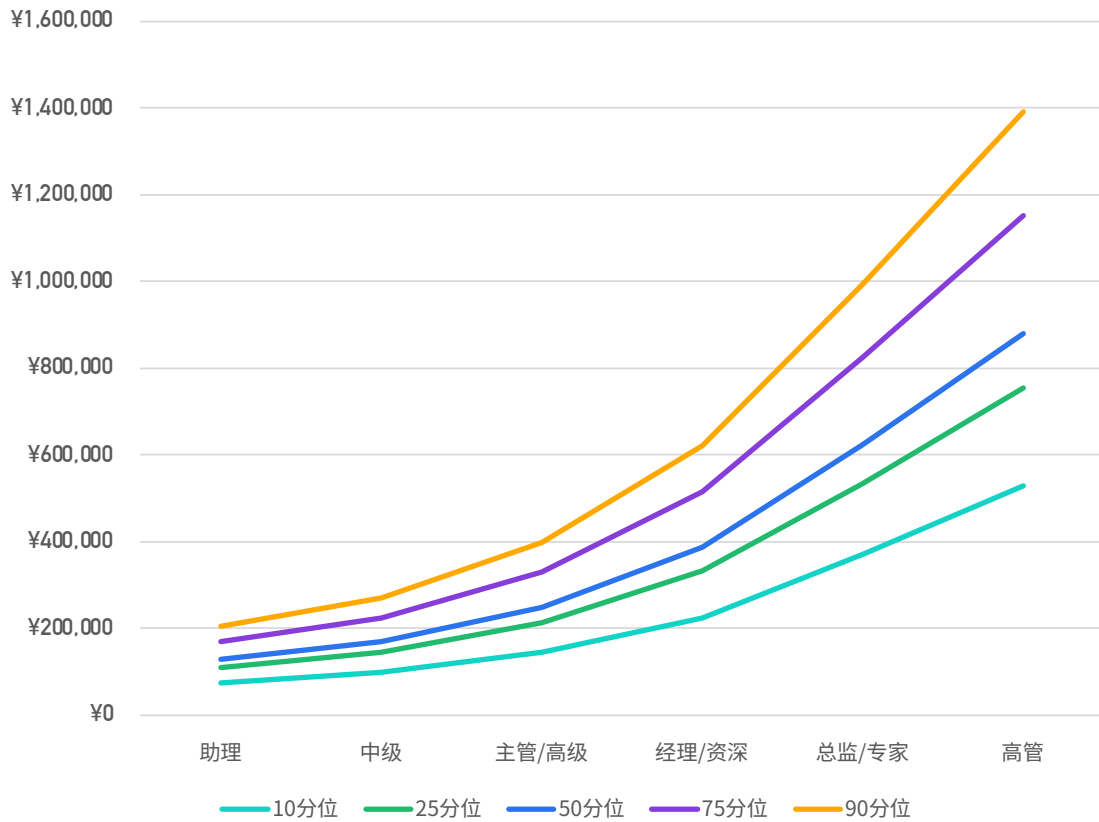
职级	10分位	25分位	50分位	75分位	90分位
助理	64,659	93,679	109,145	145,415	174,581
中级	90,401	133,006	154,733	206,647	246,196
主管/高级	149,549	219,111	256,241	340,304	408,372
经理/资深	244,166	359,462	419,441	555,190	678,892
总监/专家	446,268	656,377	765,261	1,016,828	1,223,864
高管	608,803	908,825	1,077,329	1,406,023	1,723,079



芯片制造

统计口径：年固定薪酬 单位：元（人民币）

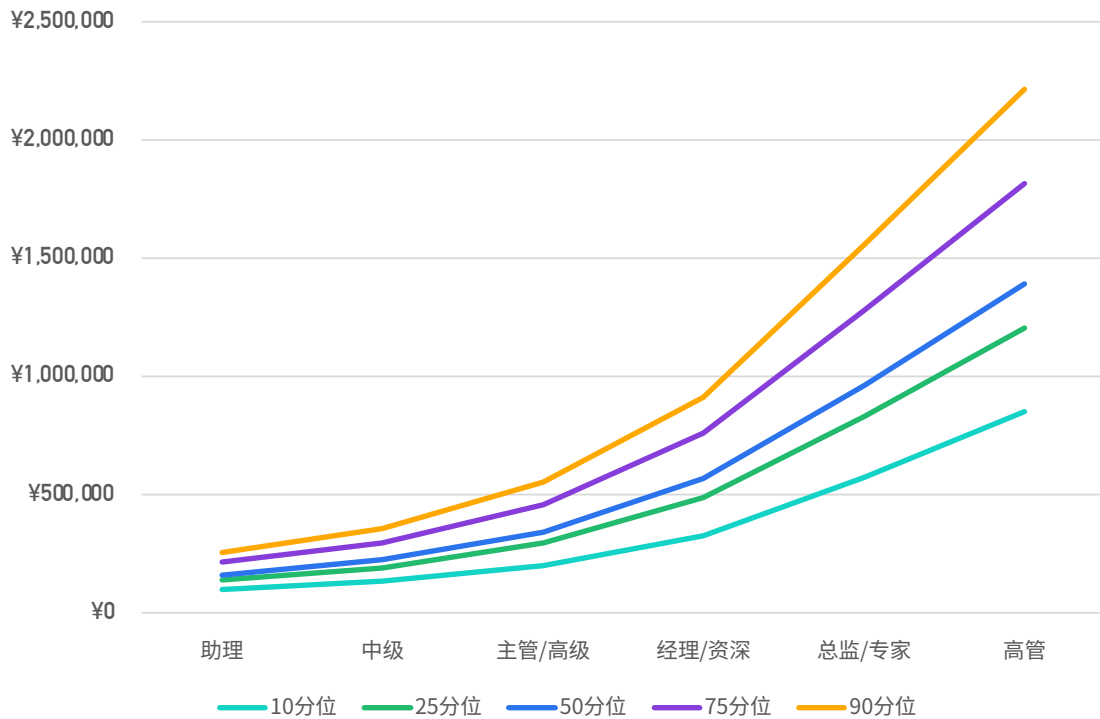
职级	10分位	25分位	50分位	75分位	90分位
助理	75,638	109,748	127,750	169,723	204,437
中级	100,027	145,316	169,225	225,247	270,287
主管/高级	144,927	212,409	248,259	331,202	398,548
经理/资深	223,441	332,080	386,960	516,243	621,975
总监/专家	370,084	534,967	623,950	825,619	994,743
高管	528,310	754,542	878,942	1,150,619	1,392,313



芯片制造

统计口径：年总现金收入 单位：元（人民币）

职级	10分位	25分位	50分位	75分位	90分位
助理	95,491	137,904	160,550	214,002	256,267
中级	131,121	190,825	222,009	296,650	355,456
主管/高级	200,588	294,693	342,655	458,378	550,093
经理/资深	327,427	485,180	566,069	758,154	910,417
总监/专家	573,530	829,555	962,810	1280,816	1556,317
高管	847,737	1,202,462	1,389,675	1,816,568	2,212,553

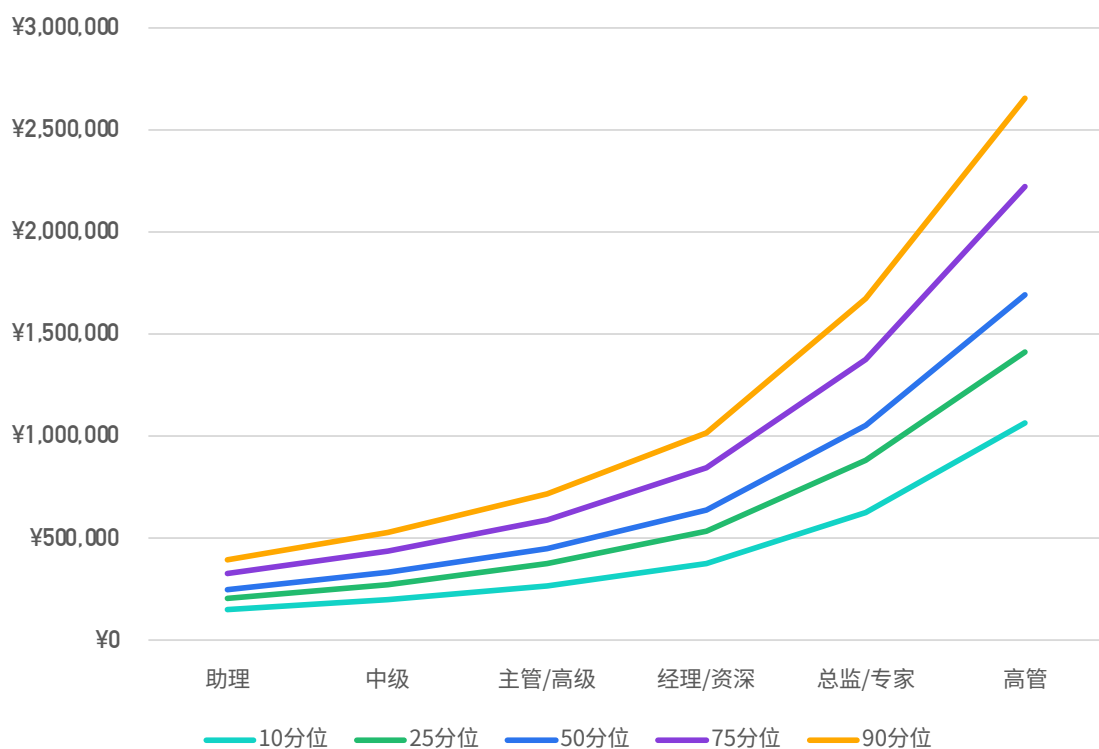


5.3 按照全行业职能类型划分（如研发类、支持类、工程类）

研发类

统计口径：年固定薪酬 单位：元（人民币）

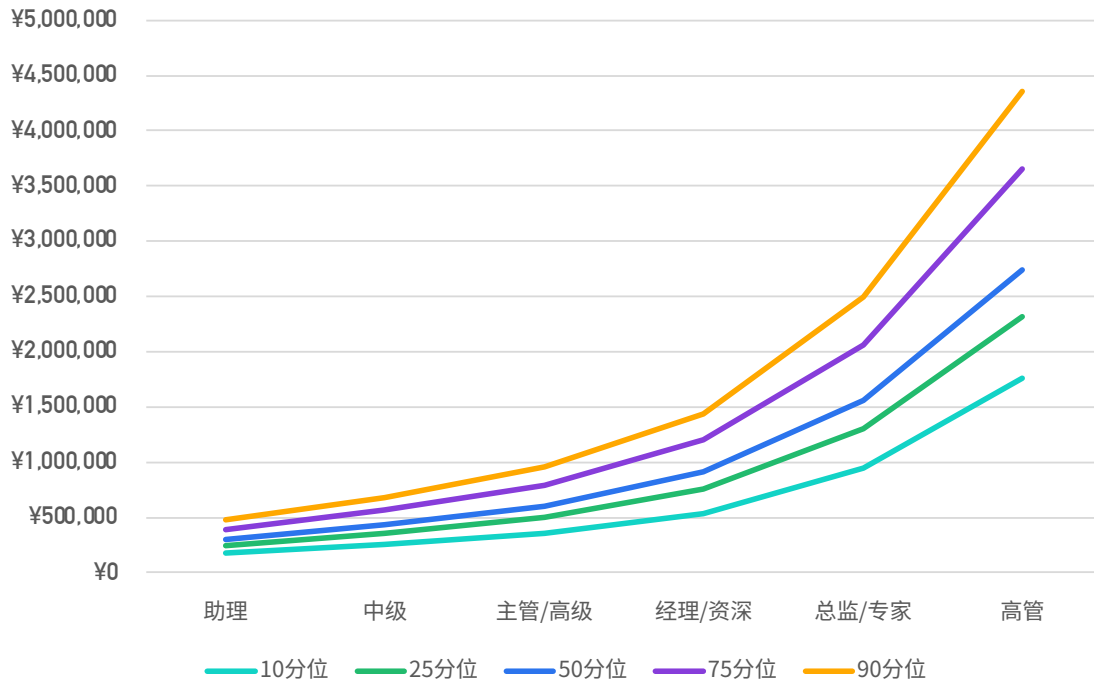
职级	10分位	25分位	50分位	75分位	90分位
助理	150,608	207,039	248,414	325,953	396,502
中级	199,568	274,981	332,940	437,419	528,299
主管/高级	267,035	375,155	450,035	592,161	717,781
经理/资深	377,914	536,185	640,273	846,299	1,015,818
总监/专家	628,784	880,272	1,052,398	1,376,683	1,675,730
高管	1,065,890	1,413,364	1,695,127	2,223,878	2,659,767



研发类

统计口径：年总现金收入 单位：元（人民币）

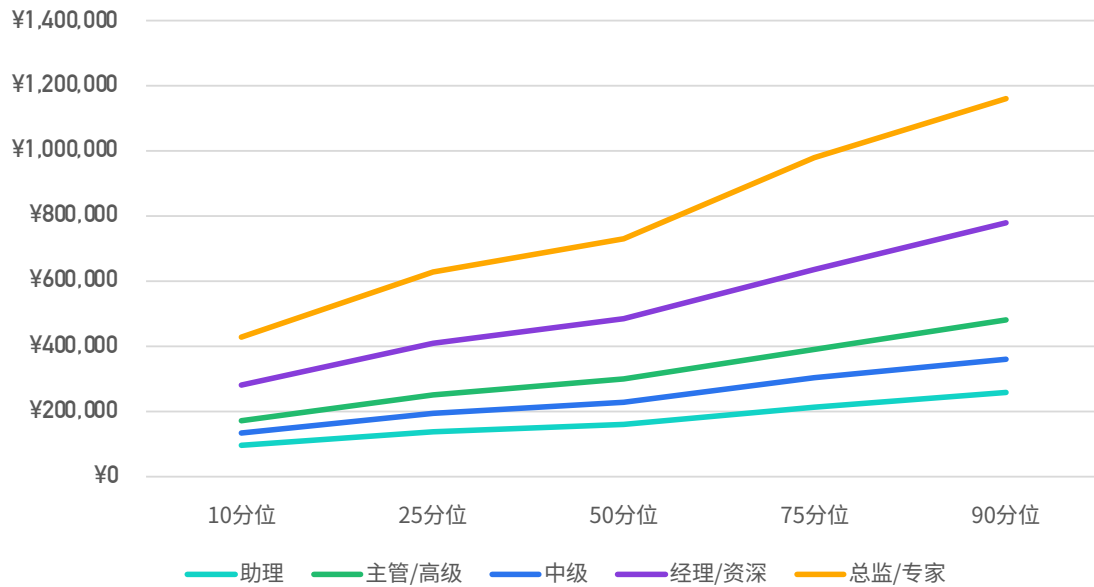
职级	10分位	25分位	50分位	75分位	90分位
助理	181,596	249,443	300,229	394,169	477,896
中级	257,660	355,205	429,194	563,814	682,834
主管/高级	358,383	503,411	602,861	794,918	961,999
经理/资深	534,981	756,499	907,545	1,197,768	1,436,708
总监/专家	940,998	1,307,516	1,559,534	2,059,604	2,494,637
高管	1,758,949	2,319,948	2,737,278	3,654,090	4,353,880



支持类

统计口径：年固定薪酬 单位：元（人民币）

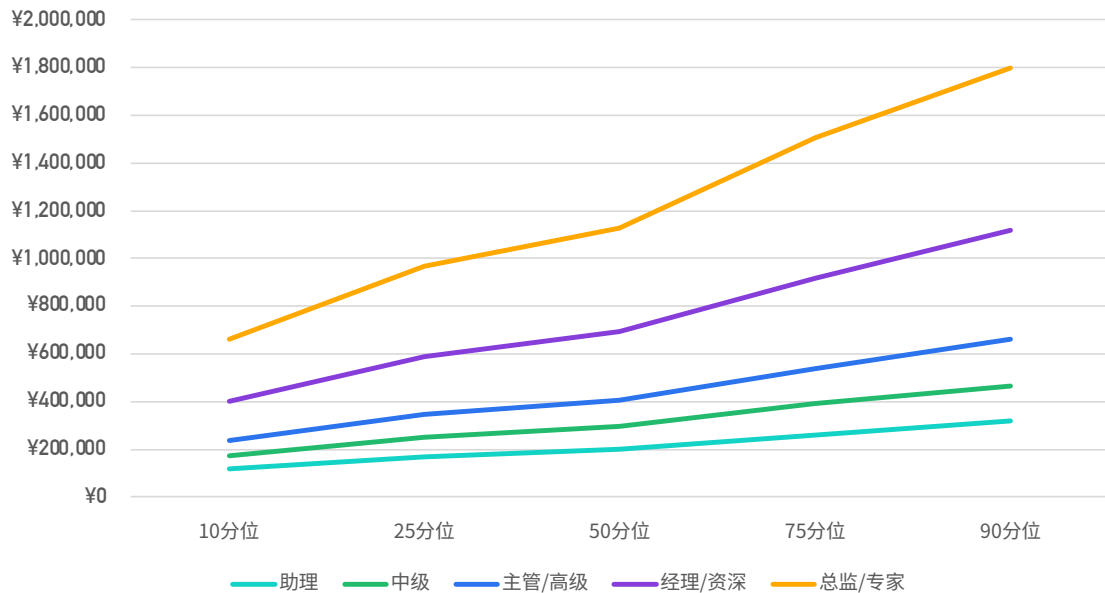
职级	10分位	25分位	50分位	75分位	90分位
助理	97,818	136,461	161,373	212,086	258,455
主管/高级	173,034	251,343	298,459	391,284	481,252
中级	133,552	193,654	227,830	304,570	360,447
经理/资深	281,008	409,062	484,088	636,751	780,066
总监/专家	428,272	628,276	731,773	9,814,73	1,160,366



支持类

统计口径：年总现金收入 单位：元（人民币）

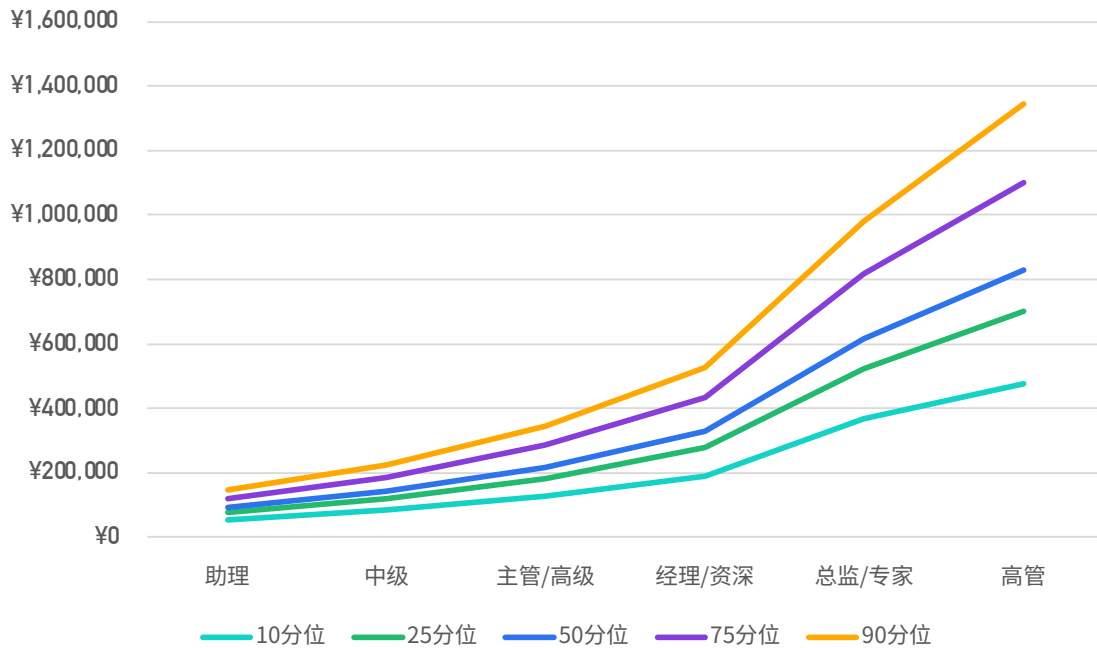
职级	10分位	25分位	50分位	75分位	90分位
助理	119,572	167,345	198,560	261,418	317,960
中级	171,422	249,585	294,585	391,092	463,872
主管/高级	236,623	347,598	406,824	540,250	661,636
经理/资深	402,523	590,611	693,022	918,716	1,118,952
总监/专家	662,696	968,102	1,126,653	1,503,606	1,799,362



销售类

统计口径：年固定薪酬 单位：元（人民币）

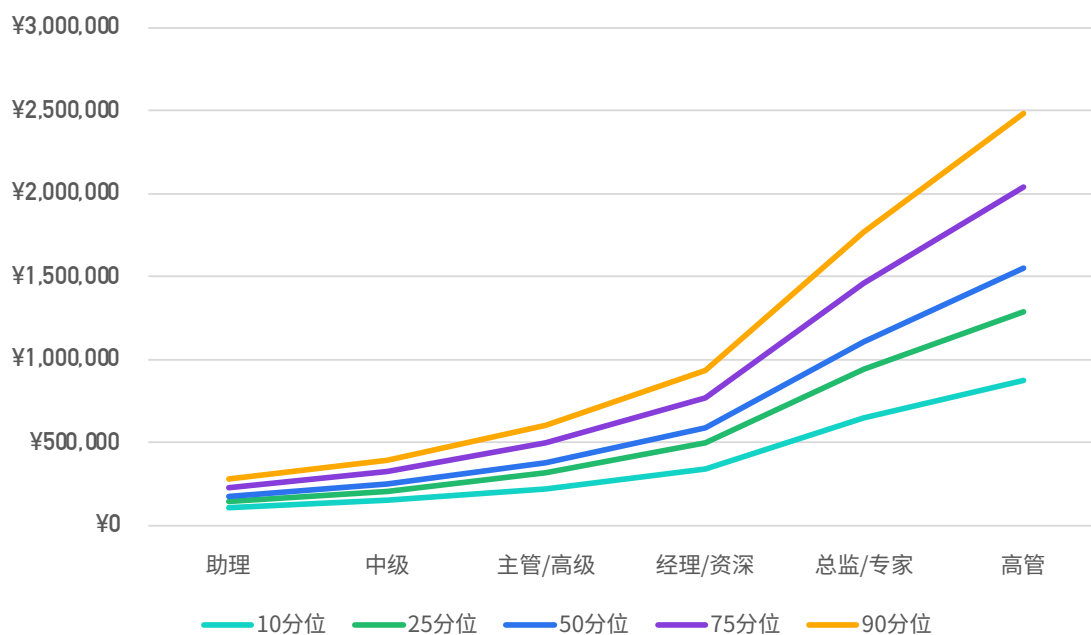
职级	10分位	25分位	50分位	75分位	90分位
助理	55,206	76,308	91,855	121,147	145,792
中级	86,124	118,790	141,609	186,517	224,621
主管/高级	126,623	180,590	215,929	286,457	345,724
经理/资深	191,416	279,303	329,202	433,384	527,893
总监/专家	366,286	522,687	616,568	818,055	979,046
高管	478,008	701,053	831,118	1,101,023	1,345,784



销售类

统计口径：年总现金收入 单位：元（人民币）

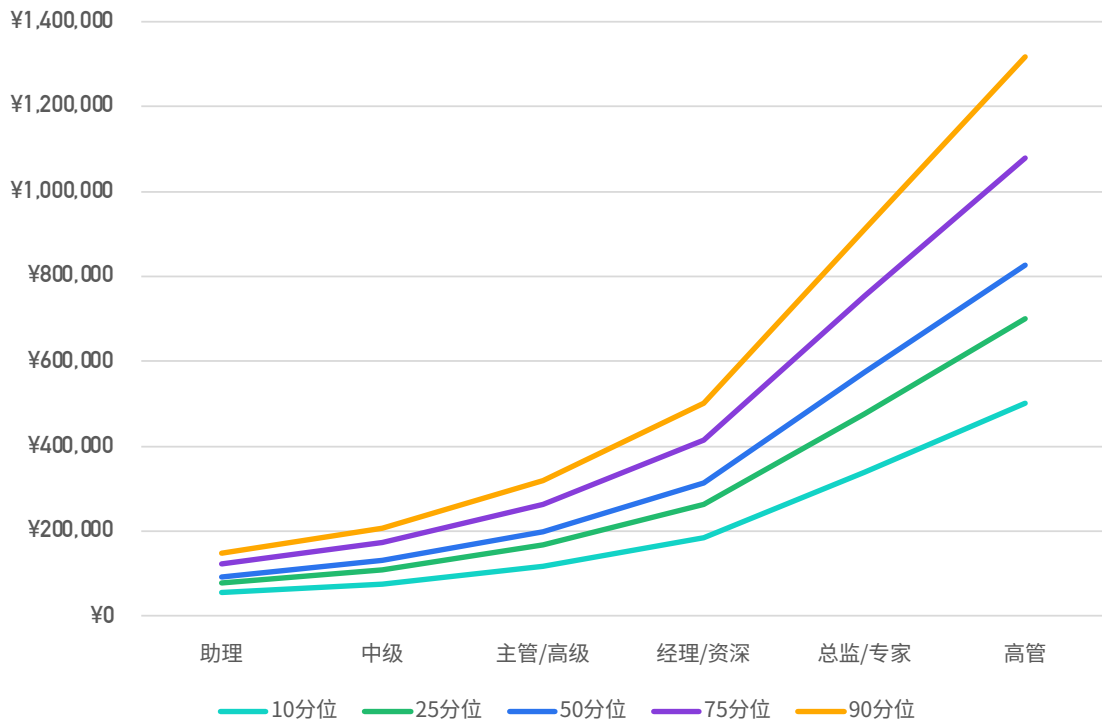
职级	10分位	25分位	50分位	75分位	90分位
助理	104,860	146,289	173,563	229,690	277,779
中级	150,782	206,489	248,003	326,439	391,385
主管/高级	220,844	316,862	379,031	501,988	602,622
经理/资深	341,505	495,602	585,930	771,880	938,732
总监/专家	652,584	943,567	1,111,324	1,464,510	1,770,634
高管	872,357	1,284,607	1,553,812	2,036,441	2,483,294



生产运营类

统计口径：年固定薪酬 单位：元（人民币）

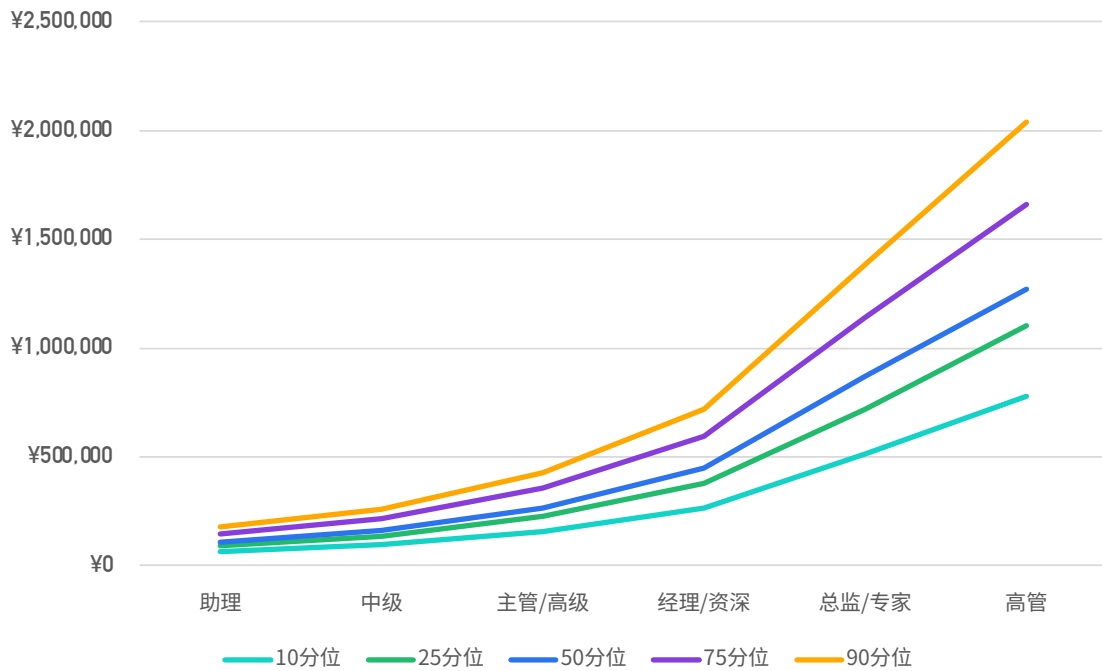
职级	10分位	25分位	50分位	75分位	90分位
助理	55,290	78,404	93,283	123,978	149,579
中级	76,639	109,410	130,567	173,748	207,434
主管/高级	117,104	167,609	198,402	263,162	319,669
经理/资深	184,681	263,269	313,860	414,780	501,352
总监/专家	338,975	476,013	574,985	754,609	909,060
高管	501,004	701,468	827,486	1,077,449	1,317,171



生产运营类

统计口径：年总现金收入 单位：元（人民币）

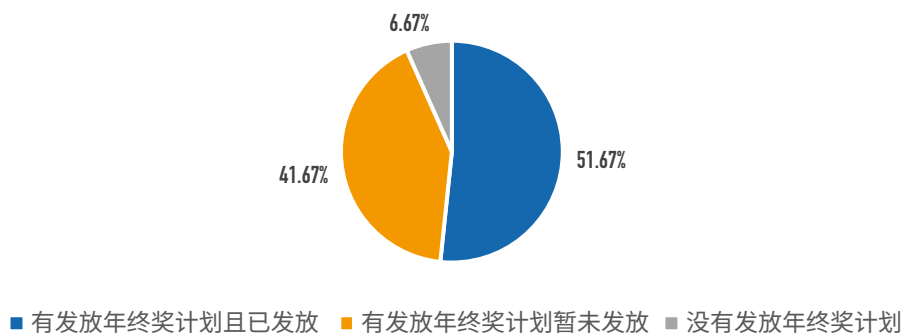
职级	10分位	25分位	50分位	75分位	90分位
助理	65,638	92,570	110,337	145,978	176,380
中级	96,048	136,949	163,052	218,146	258,896
主管/高级	156,764	224,951	264,820	354,003	427,410
经理/资深	264,268	377,526	448,417	591,967	717,323
总监/专家	513,852	721,540	871,056	1,142,957	1,385,542
高管	777,136	1,105,562	1,272,173	1,660,196	2,039,224



5.4 年终奖情况

5.4.1 中国半导体企业年终奖发放情况

2022年企业是否发放年终奖分布

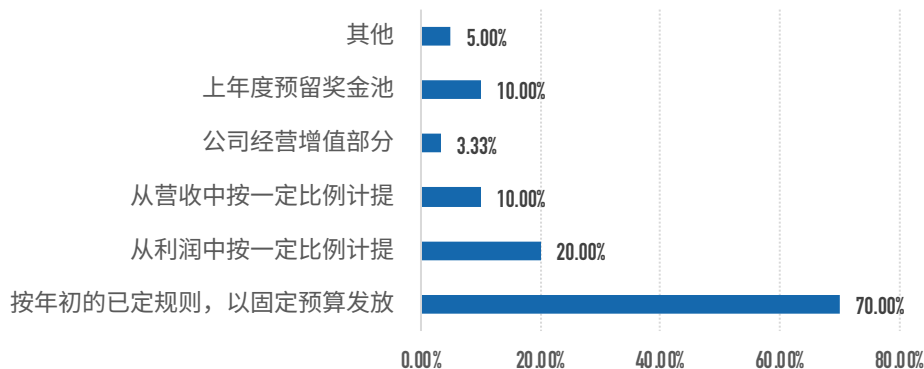


数据来源：半导体 HR 公会调研数据

2022 年外部市场环境变化众多，企业普遍表示经营挑战增大，成本压力不断上升，有相当一部分员工担心是否还有年终奖。据半导体 HR 公会调研显示，有 93.34% 的企业表示有发放年终奖的计划，截止到 2023 年 2 月 28 日，有 51.67% 的企业表示年终奖已经发放。

5.3.2 企业 2022 年年年终奖的主要成本来源

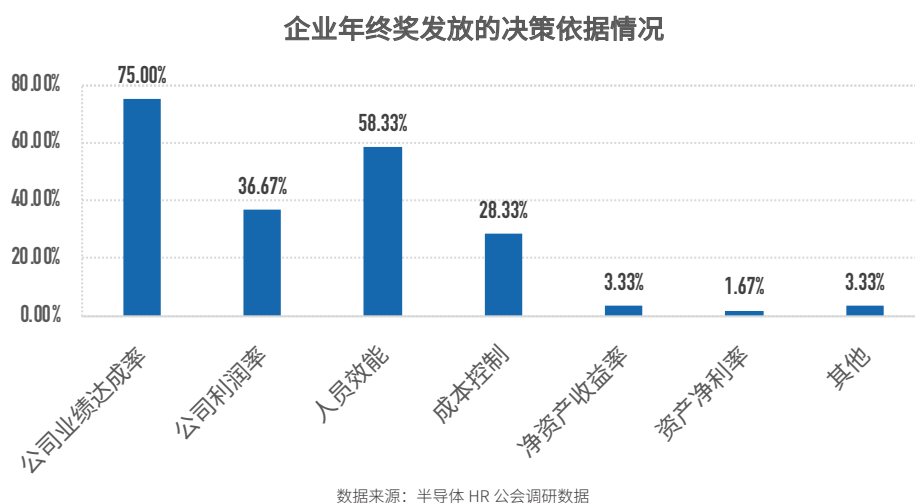
企业2022年年年终奖的主要成本来源情况



数据来源：半导体 HR 公会调研数据

企业 2022 年年年终奖的主要成本来源中，按年初的已定规则，以固定预算发放为主，占比为 70%，其次为从利润中按已定比例计提、从营收中按一定比例计提、上年度预留奖金池以及公司经营增值部门等来源。

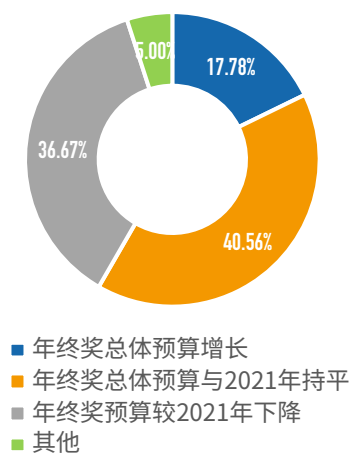
5.3.3 企业年终奖发放的决策依据



从企业年终奖发放的决策依据来看，绝大多数企业选择了公司业绩达成率（75%），接着是人员效能（58.33%）、公司利润率（36.67%）、成本控制（28.33%）等因素。

5.3.4 与 2021 年相比，2022 年年终奖变化情况

与上一年相比，2022 年年终奖变化情况

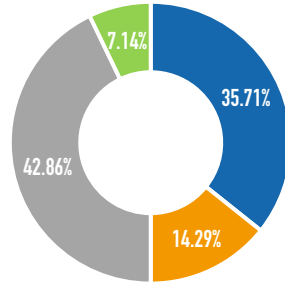


对于 2022 年不断变化的市场环境，很多员工担心年终奖是否会有减少。据调研结果显示，有过半数企业在年终奖这块与 2021 年相比变化不会很大，其中 40.56% 的企业表示年终奖总体预算与 2021 年持平，没有太大变化，17.78% 的企业表示年终奖总体预算是增长的，但同时也有 36.67% 的企业表示在年终奖预算这块较 2021 年相比出现了下降。还有 5% 的企业表示是 2022 年刚成立或 2021 年没有发放年终奖，无数据对比的情况。

（一）细分规模及发展阶段，年终奖变化情况

从企业规模来看，与2021年相比，2022年的年终奖变化情况，只有500人以上企业在年终奖预算较2021年相比下降的比例超过了5成，同时在预算增长方面，500人以上的企业占比同样是最高的，将近3成（28.57%）。

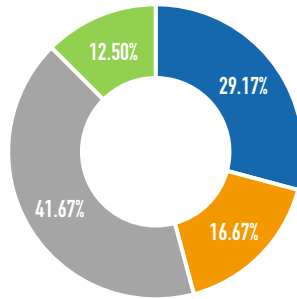
100人以下企业年终奖变化情况



- 年终奖预算较2021年下降
- 年终奖总体预算增长
- 年终奖总体预算与2021年持平
- 其他

数据来源：半导体 HR 公会调研数据

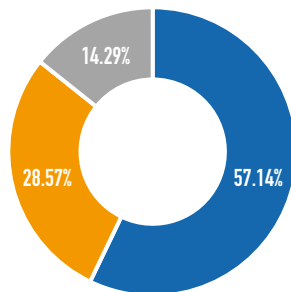
100-500人企业年终奖变化情况



- 年终奖预算较2021年下降
- 年终奖总体预算增长
- 年终奖总体预算与2021年持平
- 其他

数据来源：半导体 HR 公会调研数据

500人以上企业年终奖变化情况



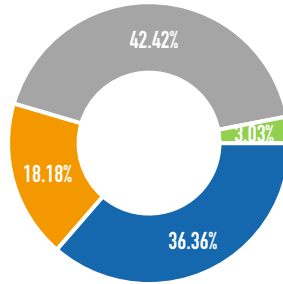
- 年终奖预算较2021年下降
- 年终奖总体预算增长
- 年终奖总体预算与2021年持平

数据来源：半导体 HR 公会调研数据

（二）细分发展阶段年终奖变化情况

从发展阶段来看，与2021年相比，2022年年终奖变化情况，未量产企业年终奖预算较2021年相比下降的比例达到5成，在预算增长方面，各个阶段差距不大，量产未上市企业占比最高，将近2成（18.18%）

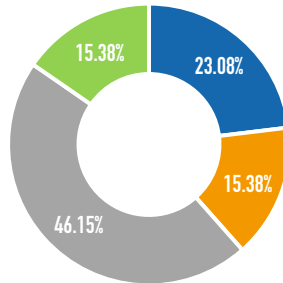
量产未上市企业年终奖变化情况



- 年终奖预算较2021年下降
- 年终奖总体预算增长
- 年终奖总体预算与2021年持平
- 其他

数据来源：半导体 HR 公会调研数据

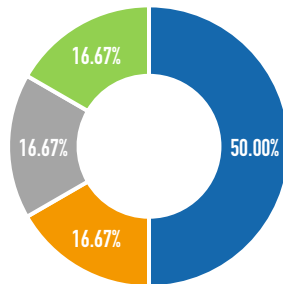
量产已上市企业年终奖变化情况



- 年终奖预算较2021年下降
- 年终奖总体预算增长
- 年终奖总体预算与2021年持平
- 其他

数据来源：半导体 HR 公会调研数据

未量产企业年终奖变化情况

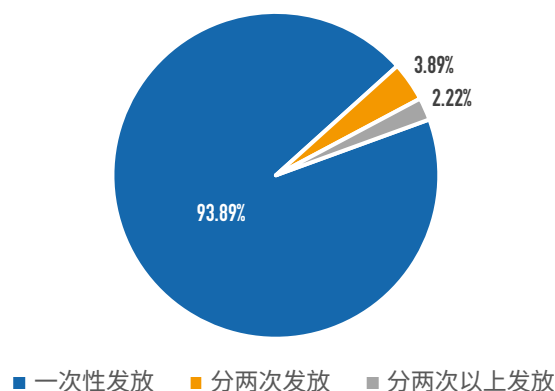


- 年终奖预算较2021年下降
- 年终奖总体预算增长
- 年终奖总体预算与2021年持平
- 其他

数据来源：半导体 HR 公会调研数据

5.3.5 年终奖发放次数

企业年终奖发放次数情况

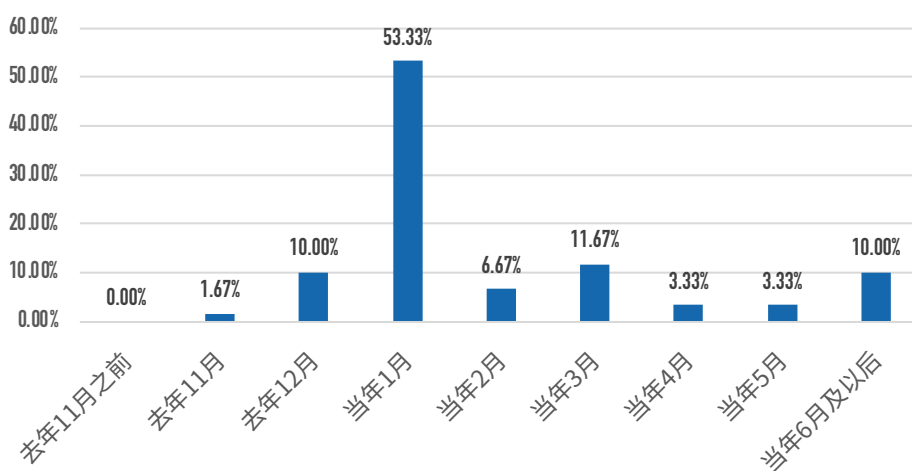


数据来源：半导体 HR 公会调研数据

据调研结果显示，在有年终奖发放及计划发放的企业中，有 93.89% 的企业奖一次性发放年终奖，3.89% 的企业决定分两次发放，另外还有 2.22% 的企业表示会分两次以上发放年终奖。

5.3.6 年终奖发放的时间

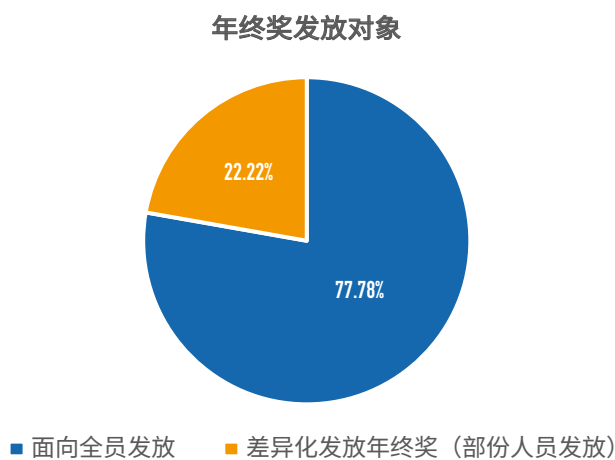
企业首次/一次性发放年终奖时间



数据来源：半导体 HR 公会调研数据

从年终奖发放的时间来看，有少部分企业（1.67%）在去年的 11 月已经发放了年终奖，绝大多数（71.67%）的企业选择在第一季度发放年终奖，5 成左右（53.33%）的企业选择在 1 月份发放，甚至还有部份（10%）的企业表示将在 2023 年 6 月之后发放。

5.3.7 年终奖发放对象



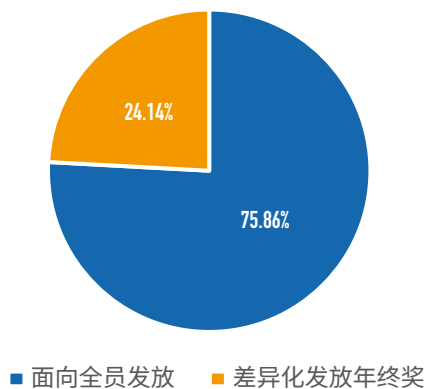
数据来源：半导体 HR 公会调研数据

在有计划或已发放年终奖的企业中，有 77.78% 的企业面向全员发放年终奖，另外还有 22.67% 的企业表示会差异化发放年终奖（向部份人员发放）。

（一）细分规模，年终奖发放对象

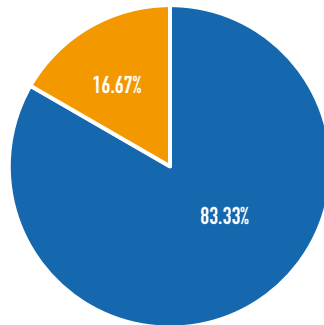
从企业规模来看，500 人以上的企业选择差异化发放年终奖的比例最大，为 28.57%。

100人以下企业年终奖发放对象



数据来源：半导体 HR 公会调研数据

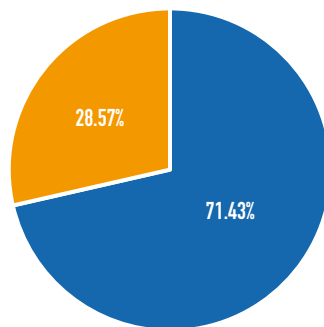
100-500人企业年终奖发放对象



■ 面向全员发放 ■ 差异化发放年终奖

数据来源：半导体 HR 公会调研数据

500人以上企业年终奖发放对象



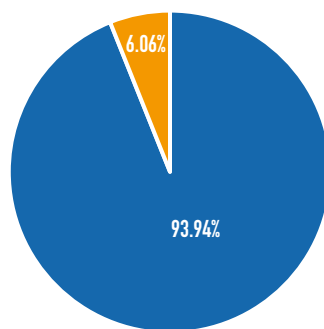
■ 面向全员发放 ■ 差异化发放年终奖

数据来源：半导体 HR 公会调研数据

（二）细分发展阶段，年终奖发放对象

从发展阶段来看，未量产企业选择差异化发放年终奖的比例最大，为 41.67%，量产未上市企业几乎全部选择面向全员发放。

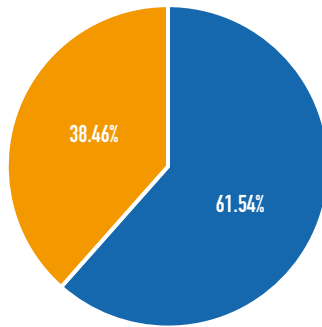
量产未上市企业年终奖发放对象



■ 面向全员发放 ■ 差异化发放年终奖

数据来源：半导体 HR 公会调研数据

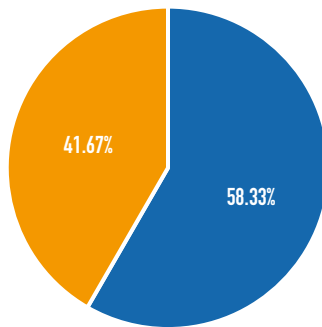
量产已上市企业年终奖发放对象



■ 面向全员发放 ■ 差异化发放年终奖

数据来源：半导体 HR 公会调研数据

未量产企业年终奖发放对象

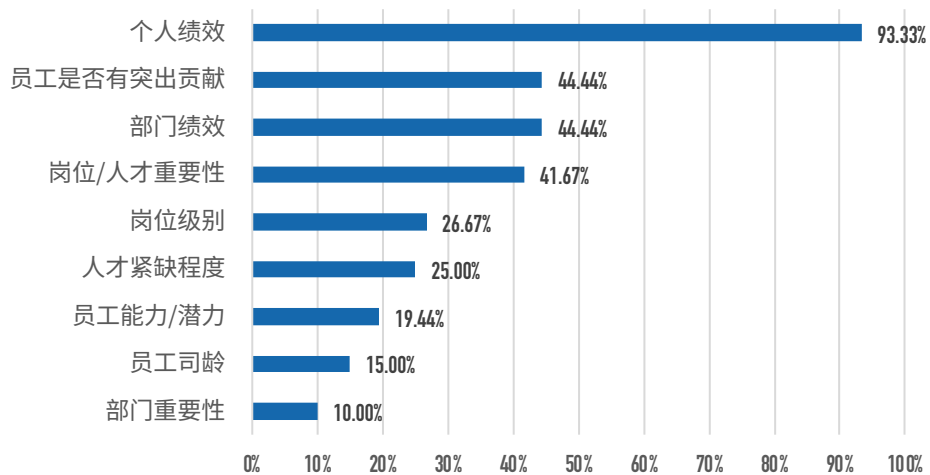


■ 面向全员发放 ■ 差异化发放年终奖

数据来源：半导体 HR 公会调研数据

5.3.8 差异化发放年终奖的主要分配依据

差异化发放年终奖主要分配依据



数据来源：半导体 HR 公会调研数据

5.3.8 差异化发放年终奖的主要分配依据

从年终奖的分配依据来看，超过九成的企业（93.33%）会把员工的个人绩效，作为年终奖分配的首要依据，除个人绩效外，企业同时也会参考员工是否有突出贡献（44.44%）、部门绩效（44.44%）、岗位/人才重要性（41.67%）、岗位级别等因素。

（一）细分规模，差异化发放年终奖的主要分配依据

从企业规模来看，随着规模的增长，在对企业差异化发放年终奖的主要分配依据中，岗位级别这一依据排名逐渐靠前。

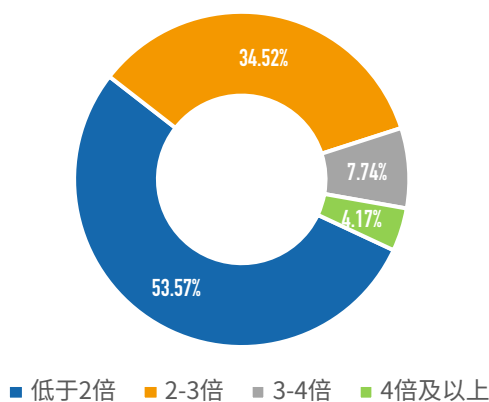
量产未上市企业差异化发放年终奖的主要分配依据 TOP5	量产已上市企业差异化发放年终奖的主要分配依据 TOP5	未量产企业差异化发放年终奖的主要分配依据 TOP5
个人绩效	个人绩效	个人绩效
部门绩效	员工是否有突出贡献	员工是否有突出贡献
员工是否有突出贡献	员工司龄	员工司龄
岗位/人才重要性	岗位/人才重要性	岗位/人才重要性
人才紧缺程度	岗位级别	岗位级别

数据来源：半导体 HR 公会调研数据

5.3.9 同岗位绩优和普通人员年终奖分配差距系数

从年终奖的分配依据来看，超过九成的企业（93.33%）会把员工的个人绩效，作为年终奖分配的首要依据，除个人绩效外，企业同时也会参考员工是否有突出贡献（44.44%）、部门绩效（44.44%）、岗位/人才重要性（41.67%）、岗位级别等因素。

同岗位绩优和普通人员年终奖分配差距系数



数据来源：半导体 HR 公会调研数据

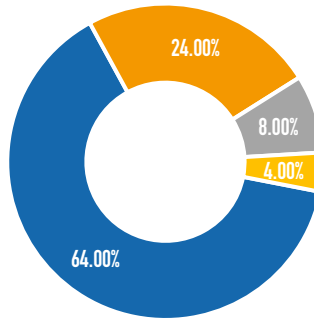
半导体 HR 公会调研结果显示，五成（53.57%）左右的企业表示同岗位绩优人员的年终奖与普通人员的年终奖差距在 2 倍以内，34.52% 的企业表示同岗位绩优人员的年终奖是普通人员的 2-3 倍，11.91% 的企业同岗位绩优人员的年终奖高于普通人员 3 倍以上。

企业根据员工绩效评估结果合理拉开年终奖分配差距，可以在控制成本的同时提升激励效果。

（一） 细分规模，同岗位绩优和普通人员年终奖分配差距系数

从企业规模来看，500 人以上的企业同岗位绩优和普通人员年终奖分配差距系数在 3 倍以上的占比最高，为 14.29%。100-500 人的企业同岗位绩优和普通人员年终奖分配差距系数在 2-3 倍的占比最高，为 37.5%。

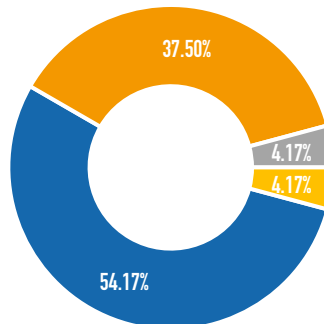
100人以下 同岗位绩优和普通人员年终奖分配差距系数



■ 低于2倍 ■ 2-3倍 ■ 3-4倍 ■ 4倍及以上

数据来源：半导体 HR 公会调研数据

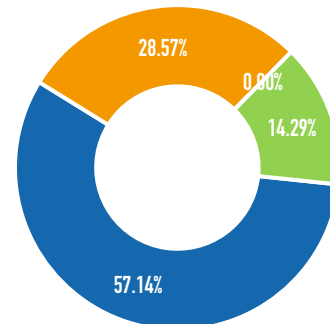
100-500人 同岗位绩优和普通人员年终奖分配差距系数



■ 低于2倍 ■ 2-3倍 ■ 3-4倍 ■ 4倍及以上

数据来源：半导体 HR 公会调研数据

500人以上 同岗位绩优和普通人员年终奖分配差距系数



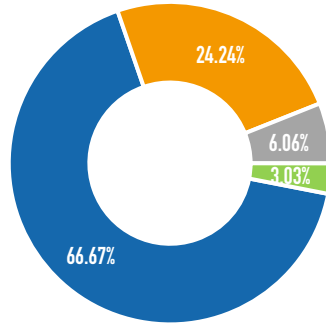
■ 低于2倍 ■ 2-3倍 ■ 3-4倍 ■ 4倍及以上

数据来源：半导体 HR 公会调研数据

（二） 细分发展阶段，同岗位绩优和普通人员年终奖分配差距系数

从发展阶段来看，未量产企业同岗位绩优和普通人员年终奖分配差距系数在3 倍以上的占比最高，为 16.66%。量产已上市企业同岗位绩优和普通人员年终奖分配差距系数在 2-3 倍的占比最高，甚至接近半数，为 46.15%。

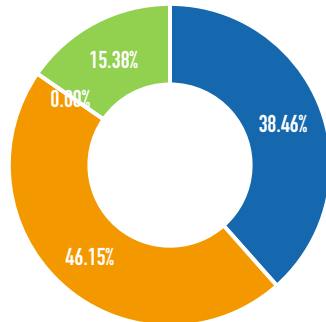
量产未上市企业同岗位绩优和普通人员年终奖分配差距系数



■ 低于2倍 ■ 2-3倍 ■ 3-4倍 ■ 4倍及以上

数据来源：半导体 HR 公会调研数据

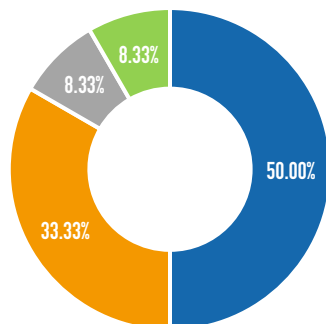
量产已上市企业同岗位绩优和普通人员年终奖分配差距系数



■ 低于2倍 ■ 2-3倍 ■ 3-4倍 ■ 4倍及以上

数据来源：半导体 HR 公会调研数据

未量产企业同岗位绩优和普通人员年终奖分配差距系数

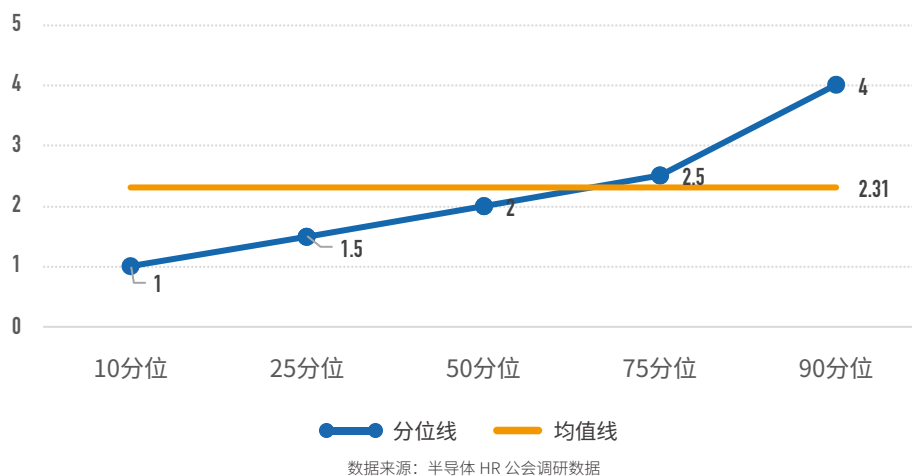


■ 低于2倍 ■ 2-3倍 ■ 3-4倍 ■ 4倍及以上

数据来源：半导体 HR 公会调研数据

5.3.10 企业 2022 年年终奖发放均值

2022年年终奖发放的均值（单位：个月）

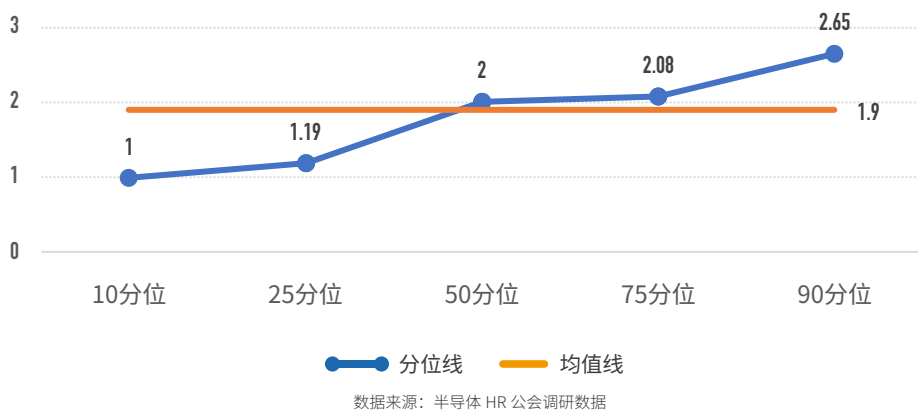


据调研结果显示，半导体行业 2022 年年终奖发放的均值是在 2.31 个月，50 分位与 70 分位分别是 2 个月和 2.5 个月。

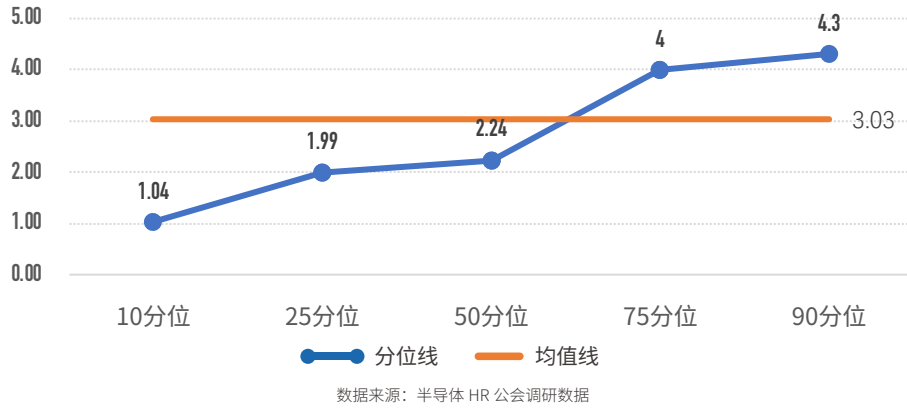
（一） 细分规模，2022 年年终奖发放均值情况

从企业规模来看，100-500 人的企业 2022 年年终奖发放均值最高，为 3.03 个月，100 人以下企业 2022 年年终奖发放均值最低，为 1.9 个月。

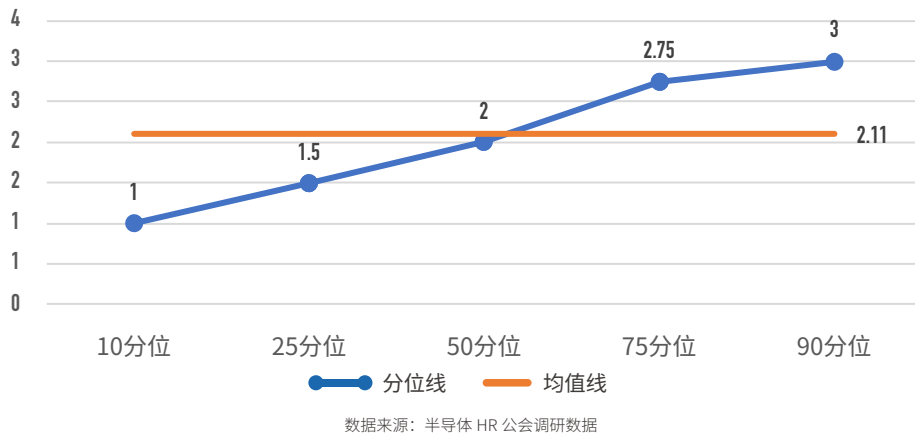
100人以下企业2022年年终奖发放均值（单位：个月）



100-500人企业2022年年终奖发放均值（单位：个月）



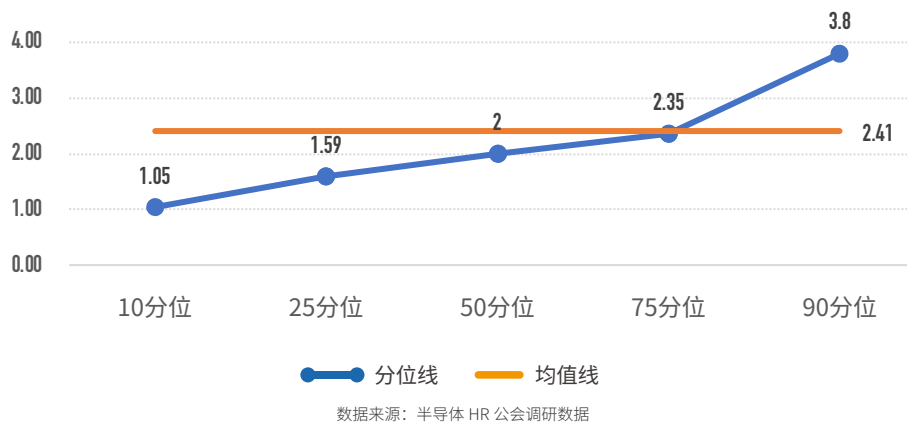
500人以上企业2022年年终奖发放均值（单位：个月）



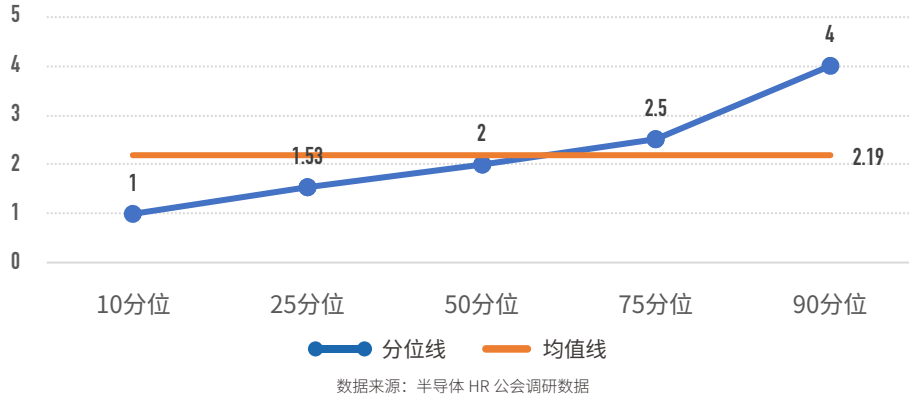
（二） 细分发展阶段，2022 年年终奖发放均值情况

从发展阶段来看，量产未上市企业 2022 年年终奖发放均值最高，为 2.41 个月，量产已上市企业 2022 年年终奖发放均值最低，为 2.19 个月。

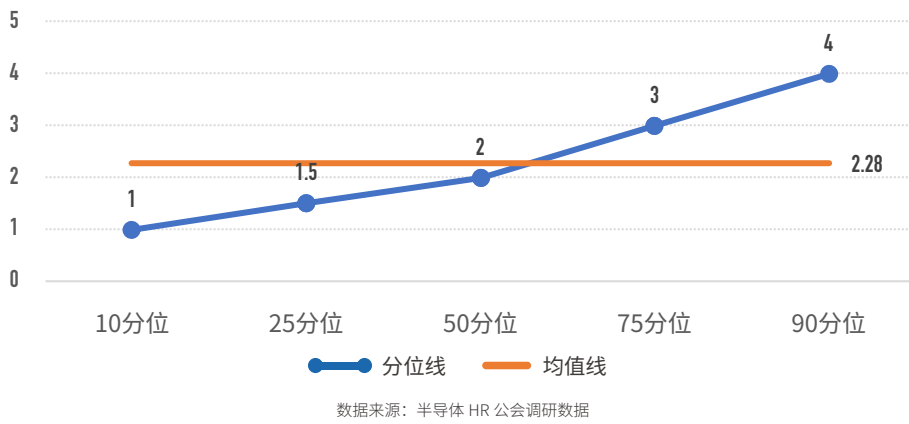
企业2022年年终奖发放均值-量产未上市企业（单位：个月）



企业2022年年终奖发放均值-量产已上市企业（单位：个月）

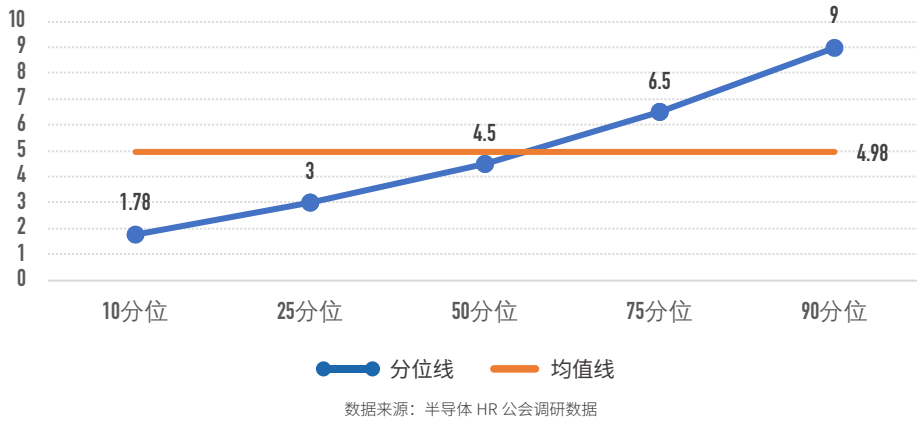


企业2022年年终奖发放均值-未量产企业（单位：个月）



5.3.11 企业 2022 年年终奖人均金额 (单位: 万元)

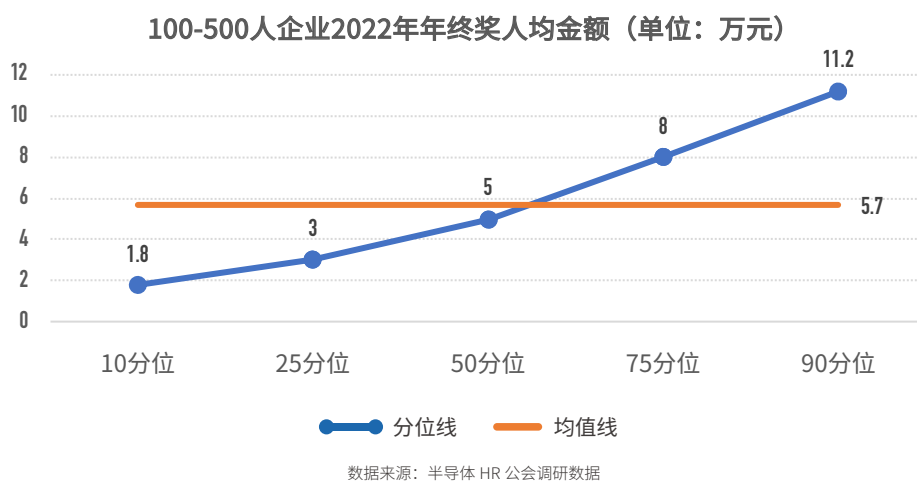
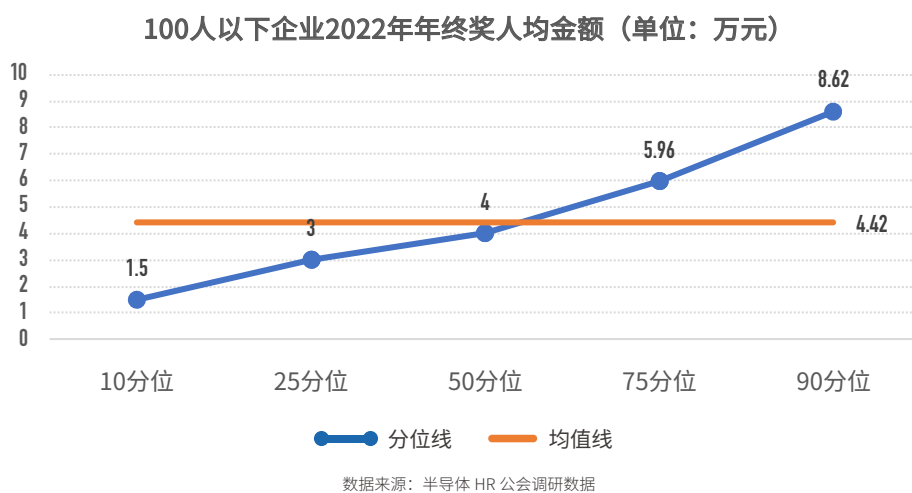
企业2022年年终奖人均金额（单位：万元）



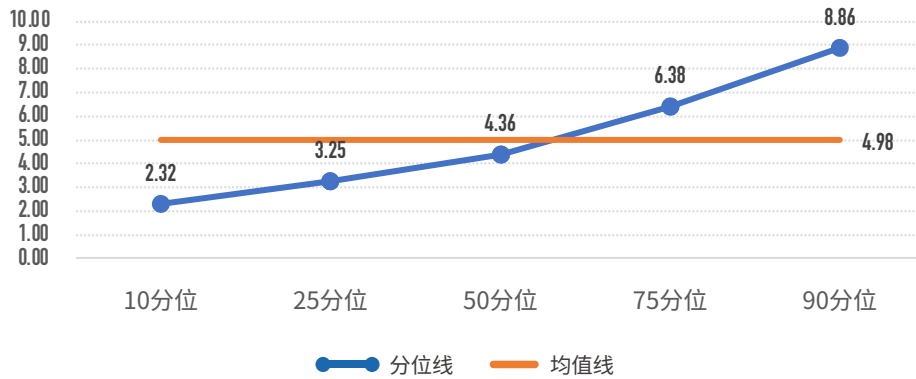
在具体年终奖发放人均金额方面，调研结果显示半导体行业 2022 年年终奖人均金额为 4.873 万元，50 分位与 70 分位的金额分别为 4.5 万元与 6.5 万元，企业发放年终奖人均金额最高值为 12 万元。

（一） 细分规模，2022 年年终奖人均金额

从企业规模来看，100-500 人的企业 2022 年年终奖人均金额的均值最高，为 5.7 万元，100 人以下企业 2022 年年终奖人均金额的均值最低，为 4.42 万元。



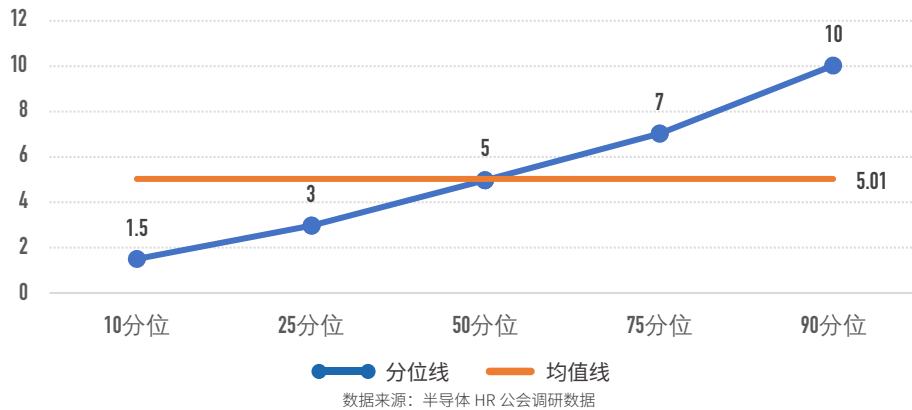
500人以上企业2022年年终奖人均金额（单位：万元）



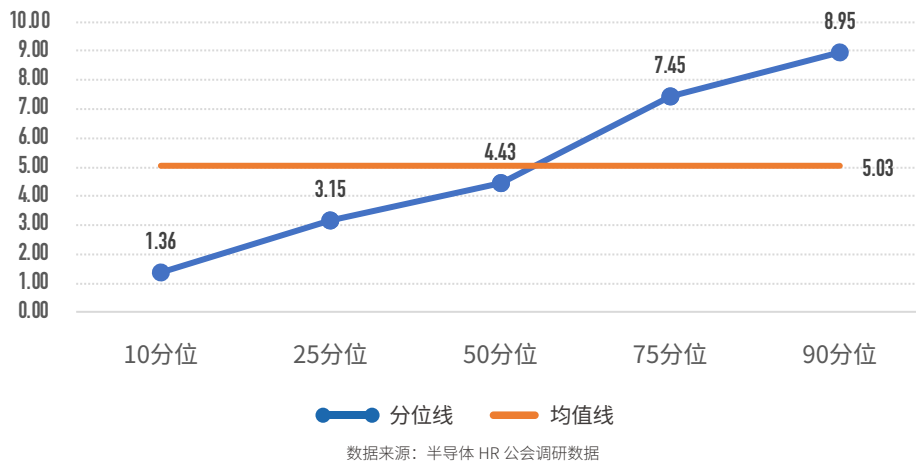
（二） 细分发展阶段，2022 年年终奖人均金额

从发展阶段来看，不同发展阶段的企业，在人均金额的均值上来说，差距并不是很大。其中未量产企业2022年年终奖人均金额的均值最高，为5.2万元，量产未上市企业2022年年终奖人均金额的均值最低，为5.01万元。

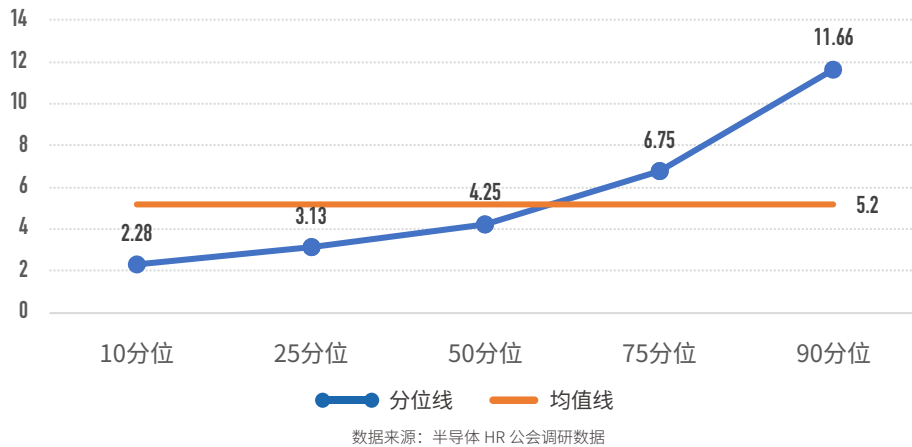
量产未上市企业2022年年终奖人均金额（单位：万元）



量产已上市企业2022年年终奖人均金额（单位：万元）



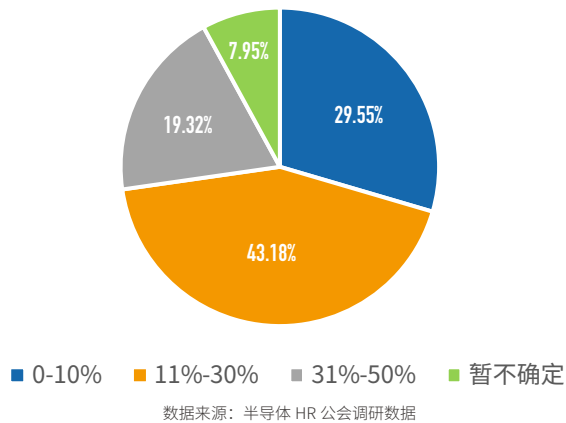
未量产企业2022年年终奖人均金额（单位：万元）



5.4 中国半导体企业 2023 年调薪率

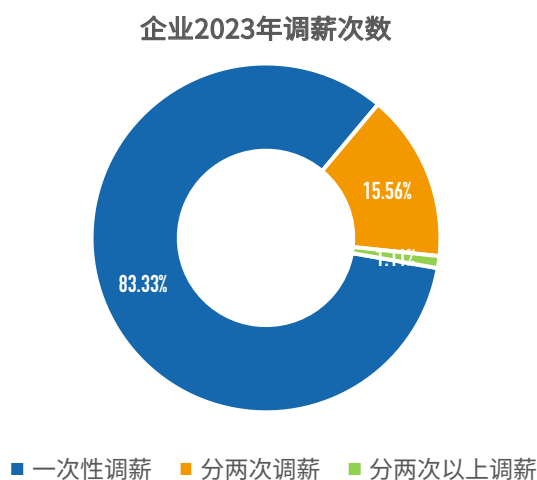
5.4.1 企业差异化调薪人员占比

企业2023年差异化调薪人员占比



据调研结果显示，在进行差异化调薪的企业中，三成（29.55%）的企业将 2023 年差异化调薪的人员占比设置为 10% 以下，四成（43.18%）的企业选择将差异化调薪人员占比设置为 11%-30% 之间，两成（19.32%）的企业差异化人员占比设置高达 31%-50%，截止调研时间 2023 年 2 月 28 日，还有 7.95% 的企业暂不确定 2023 年差异化人员调薪人员占比。

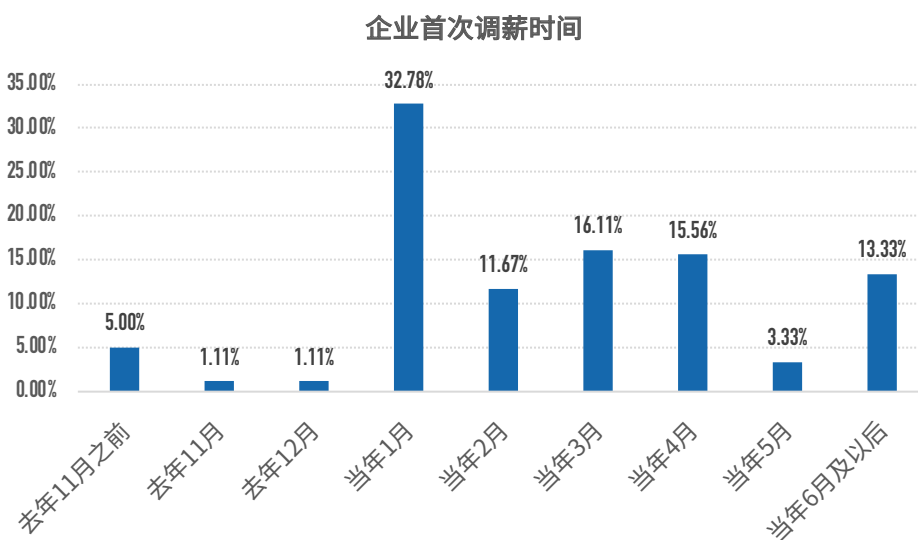
5.4.2 企业 2023 年调薪次数



数据来源：半导体 HR 公会调研数据

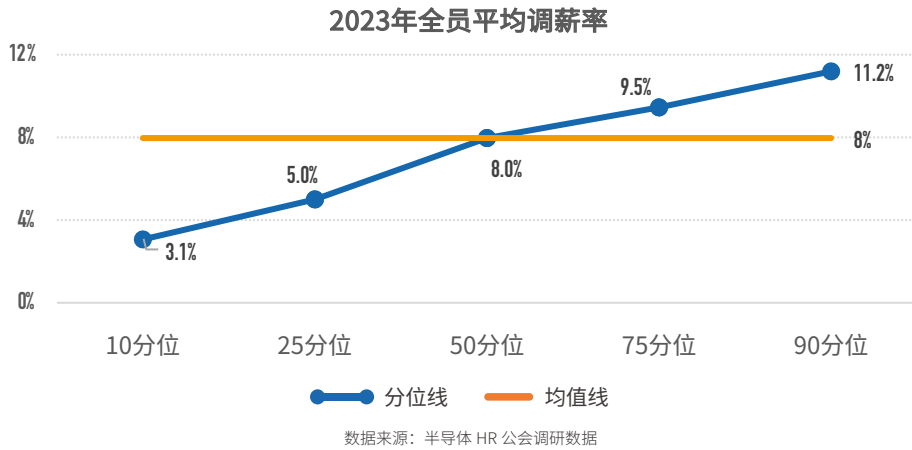
在调薪次数方面，八成（83.33%）企业表示在 2023 年选择一次性调薪，不到两成（15.56%）的企业选择分两次进行调薪，除此之外，还有极少（1.11%）企业表示会进行两次以上的调薪。

5.4.3 企业调薪时间



从调薪的时间来看，一半的企业表示会在 2023 年第一季度进行一次性或首次调薪，其中主要（32.78%）集中在 1 月份调薪。不到一成（7.22%）的企业已经在 2022 年的第四季度进行了 2023 年度的一次性或首次调薪。

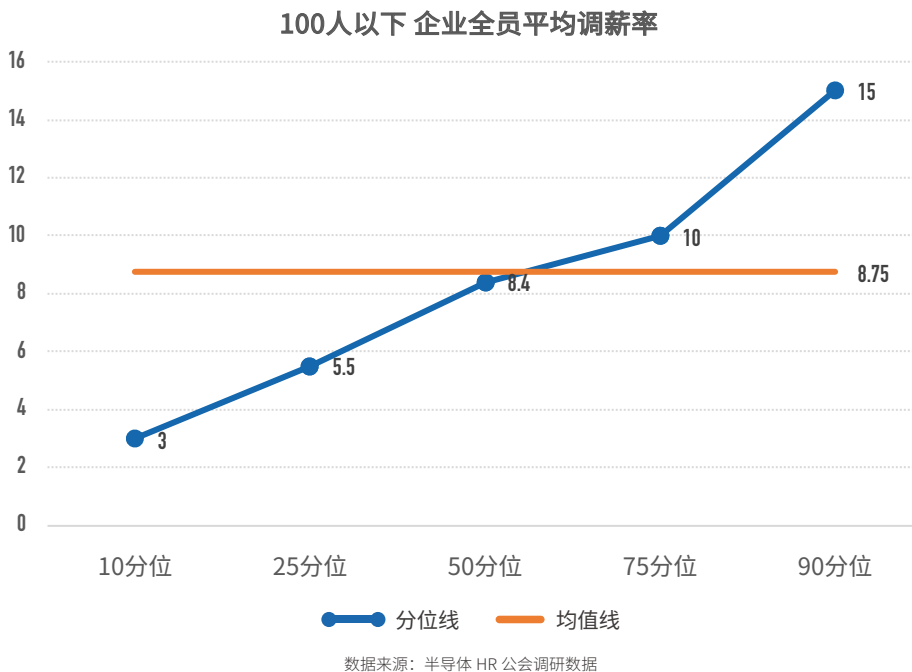
5.4.4 企业 2023 年全员平均调薪率



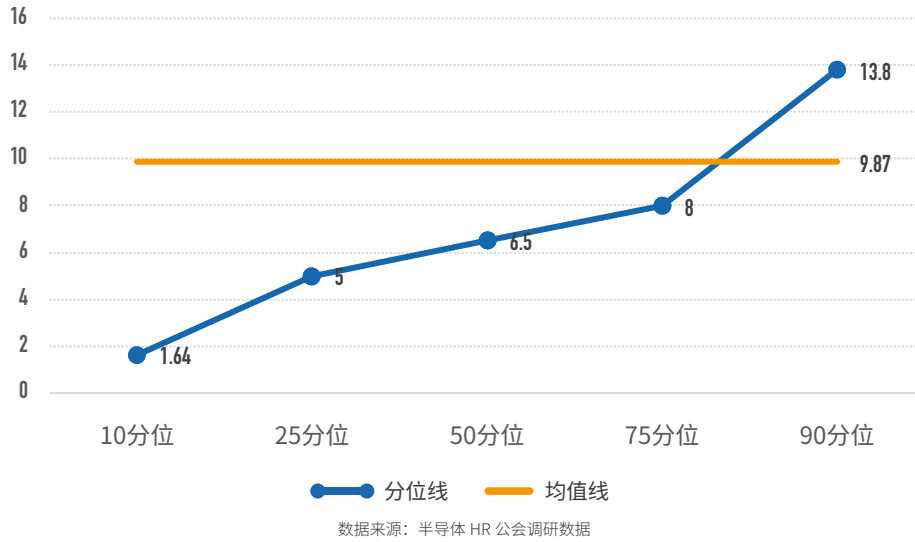
据调研结果显示，半导体行业企业在 2023 年的全员平均调薪率为 8%，50 分位与 75 分位的调薪率分别为 8% 与 9.5%，在参调企业中，最低有的企业在 2023 年的调薪率为 -15%（降薪 15%），最高为 100%。

（一） 细分规模，全员平均调薪率

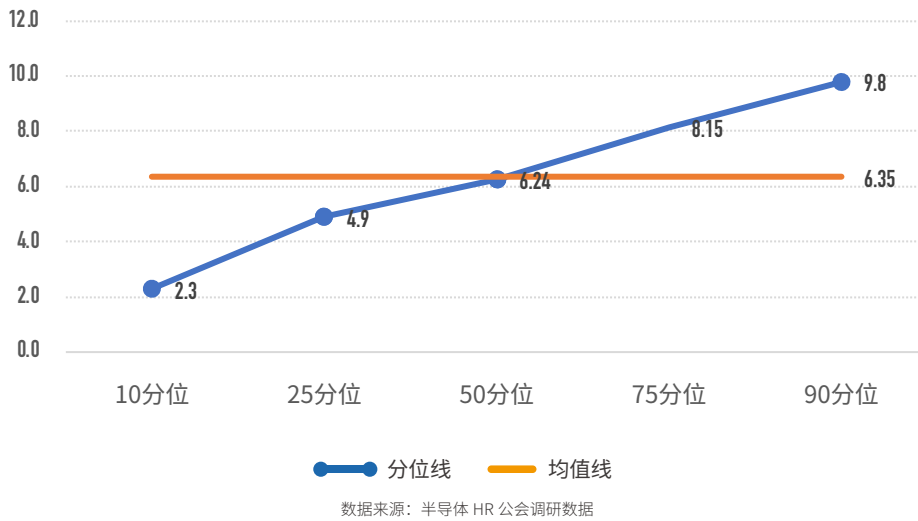
从企业规模来看，100-500 人的企业全员平均调薪率均值最高，为 9.87%，500 人以上企业全员平均调薪率均值最低，为 6.35%。



100-500人 企业全员平均调薪率



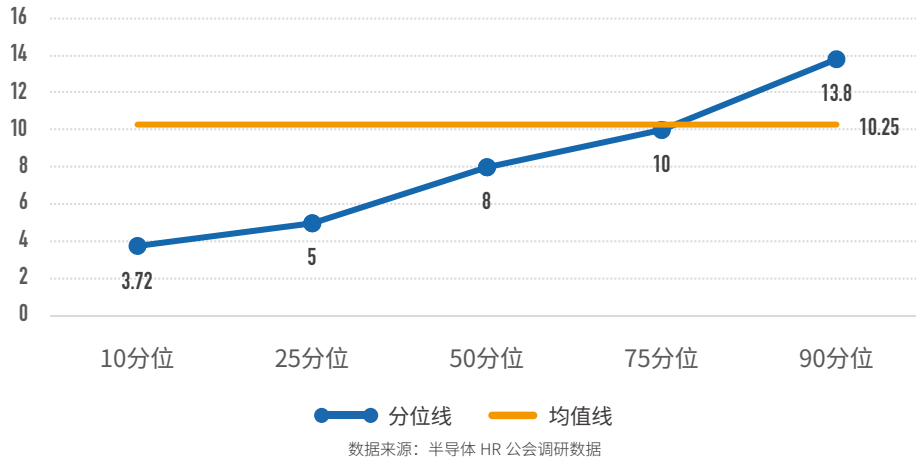
500人以上 企业全员平均调薪率



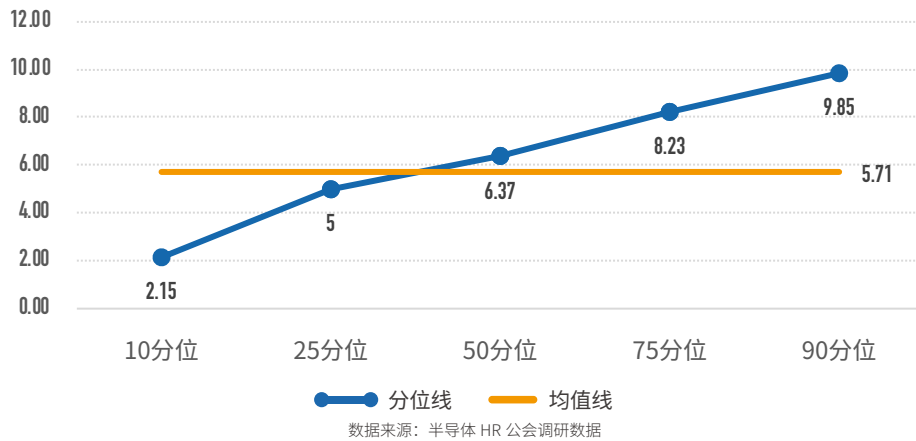
（二） 细分发展阶段，全员平均调薪率

从发展阶段来看，量产未上市企业全员平均调薪率均值最高，为 10.25%，量产已上市企业全员平均调薪率均值最低，为 5.71%。

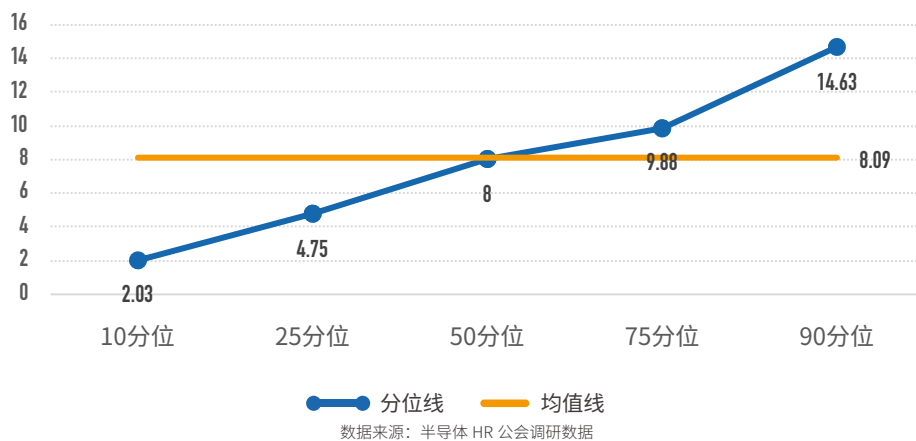
量产未上市企业全员平均调薪率



量产已上市企业全员平均调薪率

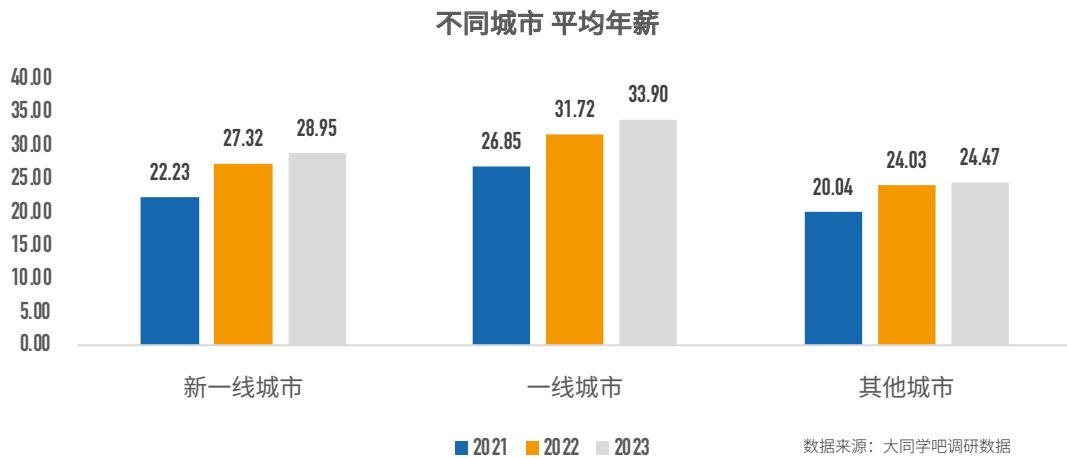


未量产企业全员平均调薪率



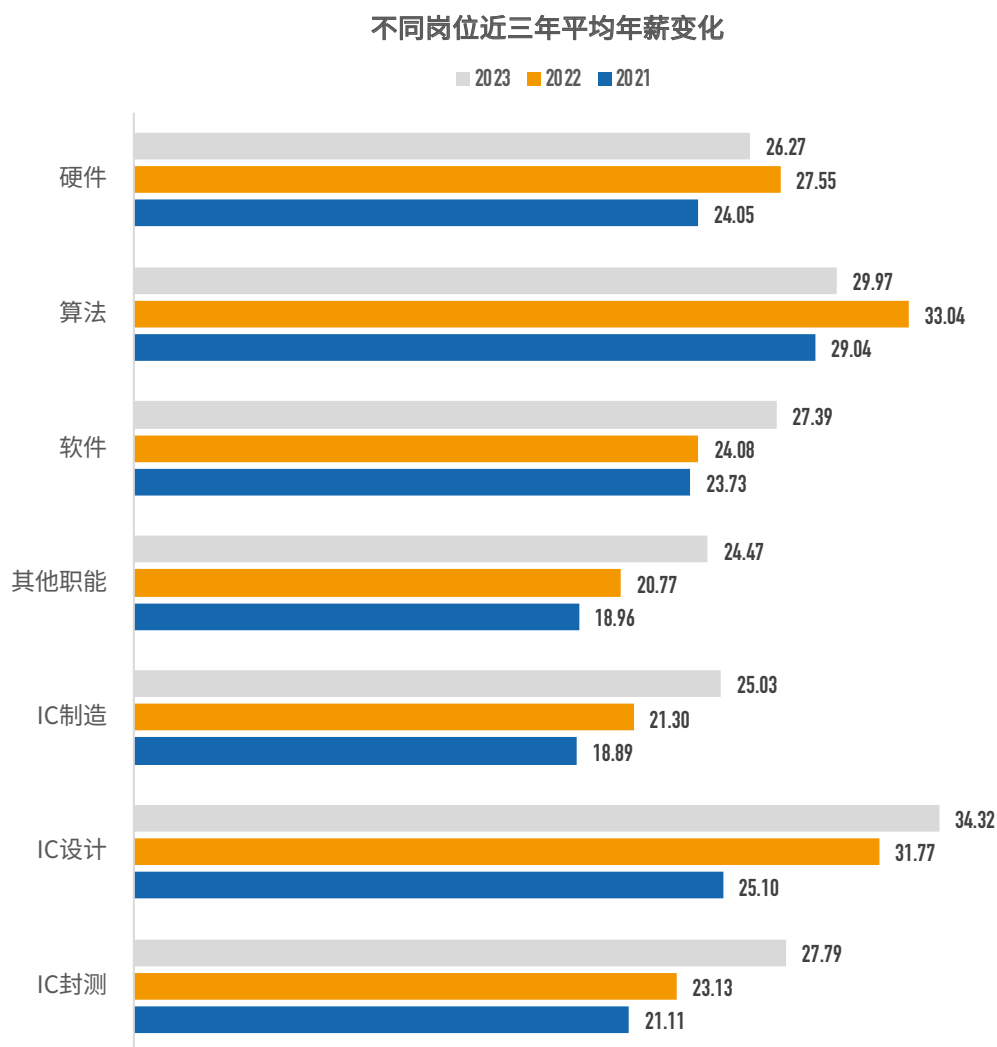
5.5 校招薪酬数据

5.5.1 不同城市类型近三年年薪变化情况



2021-2023 年三年期间，一线、新一线、其他城市的平均薪资均在稳步增长，其中 21-22 年增长最快的是新一线城市，增幅是 5.09 万，2022-2023 年增长最快的是一线城市，增幅是 2.18 万。和 2021-2022 年的增幅相比，2022-2023 年的薪资增长变缓慢。

5.5.2 不同岗位类型近三年年薪变化情况



数据来源：大同学吧调研数据

在 2021-2023 年内，除了算法和硬件岗位，其他岗位的平均年薪每一年都在逐步增长。

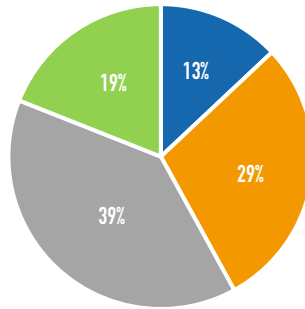
2021-2022 年平均薪资增幅最大的岗位是 IC 设计岗位，增幅有 6.67 万，增幅最小的是软件岗位，增幅是 0.35 万。2022-2023 年平均薪资增幅最大的岗位是 IC 封测岗位，增幅是 4.66 万，增幅最小的是 IC 设计岗位，增幅是 2.55 万。

算法和硬件岗位平均薪资在 2021-2022 年有所增加，而在 2023 年的平均薪资有所回落，2023 年高于 2021 年平均薪资但低于 2022 年平均薪资。

5.5.3 不同高校层次薪资中位数及平均税前年薪

不同学校性质占比

■ 普通高校 ■ 211 ■ 985 ■ C9

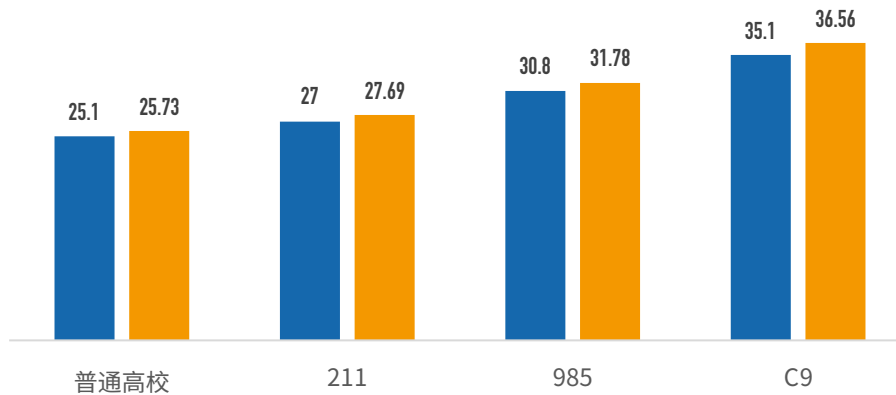


数据来源：大同学吧调研数据

从不同高校层次占比情况来看，985 高校的学生占比最多 39%，其次是 211 高校 29%，C9 高校 19%，普通高校 13%。

不同高校层次薪资中位数及平均税前年薪

■ 中位数 ■ 平均税前年薪



数据来源：大同学吧调研数据

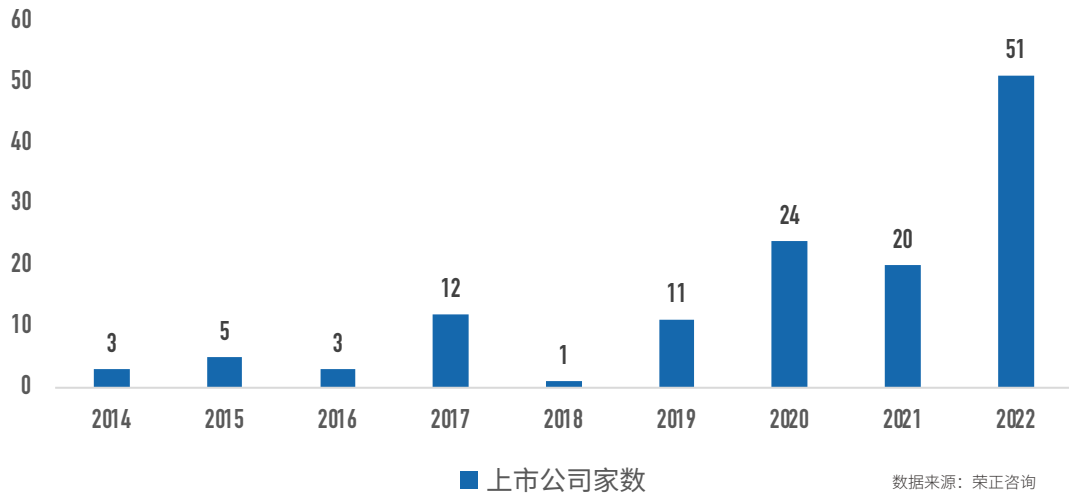
高校层次通常与其平均年薪成正比，C9 院校学生年薪高达 36.56W，其次为 985 院校，达到 31.78W，211 高校和普通高校分别为 27.69W 和 25.73W。



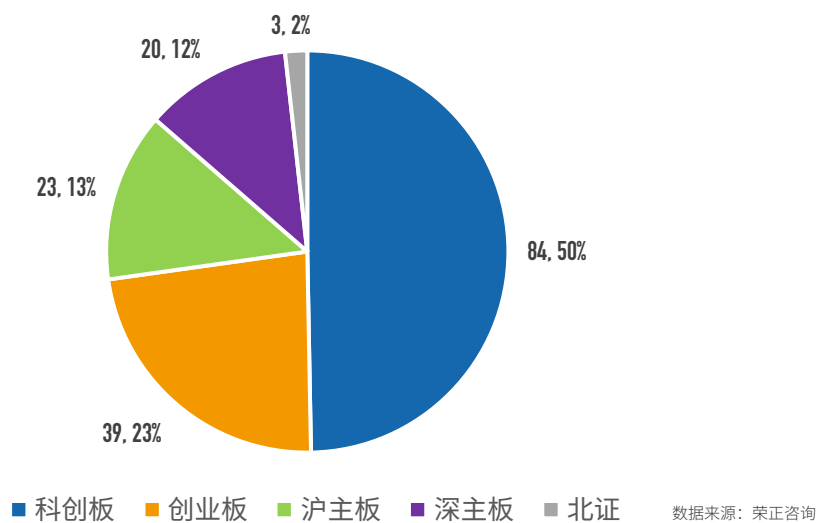
半导体行业上市公司股权激励

6.1 半导体上市公司情况

6.1.1 半导体行业上市公司数量和板块分布

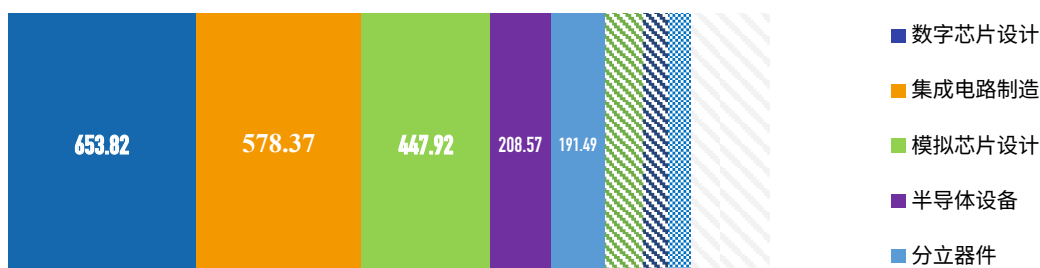


我们选取中信 - 半导体、WIND- 半导体、SW- 半导体板块截至 2022 年 12 月 31 日的 195 家公司，剔除其中的电力设备 - 光伏设备和电力设备 - 电池板块的 26 家后，样本数据共 169 家。如图 各年度半导体行业登陆 A 股市场家数所示，2022 年上市的半导体公司数量为历年最多，达到 51 家，超过过去两年上市数量之和。总体而言，2022 年，是半导体行业 IPO 丰收的一年，在整个 A 股市场行情出现明显调整的情况下，也不改半导体公司冲刺 IPO 的热情。



如上图所示，在这 169 家上市半导体公司中，科创板上市公司数为 84 家，占比高达 50%。其次为创业板，上市公司为 39 家，占比为 23%。北交所只有 3 家，占比为 2%。这些半导体公司主要集中在“双创板”（科创板和创业板）上市，也从侧面体现了“双创板”上市公司的含“科”属性，半导体行业以技术研发作为企业发展的重要推力，对于科技型人才有更高的需求。

6.1.2 半导体细分行业首发募集资金情况

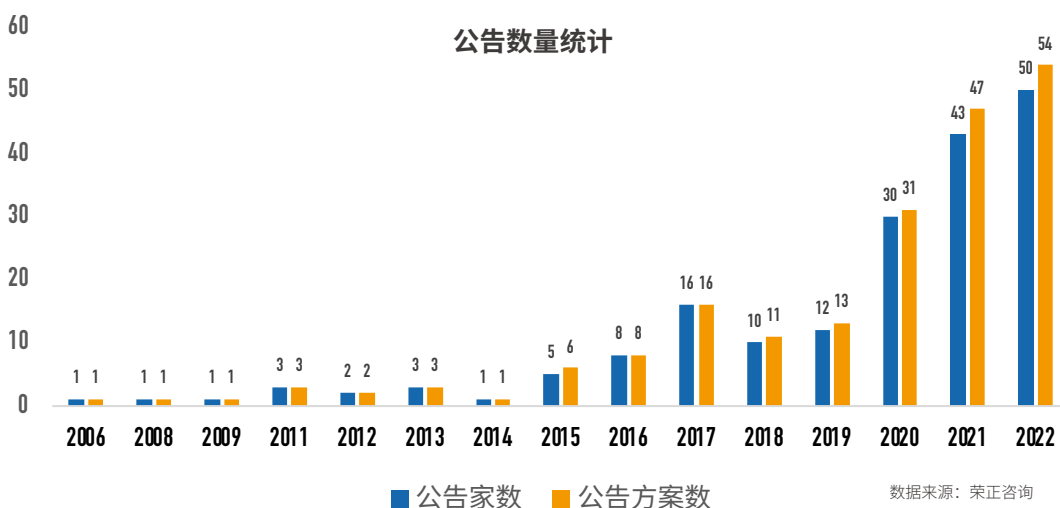


数据来源：荣正咨询

从半导体行业募集资金情况可以看到，募集资金排名前三的细分行业为数字芯片设计、集成电路及模拟芯片设计，对应募集资金额为 653.82 亿、578.37 亿和 447.92 亿，从细分领域来看，半导体设计类企业仍是主力军。这可能与芯片设计行业相较于其他细分领域而言投入成本较小，回报周期较短，而且市场空间相对更大有关。通过对半导体行业上市情况、市值和首发募集资金情况的了解，我们将从半导体行业公司上市后股权激励实施情况、半导体行业公司上市前股权激励实施情况、半导体行业公司高管及核心员工参与战略配售情况三个部分，了解半导体行业股权激励具体的实践情况。

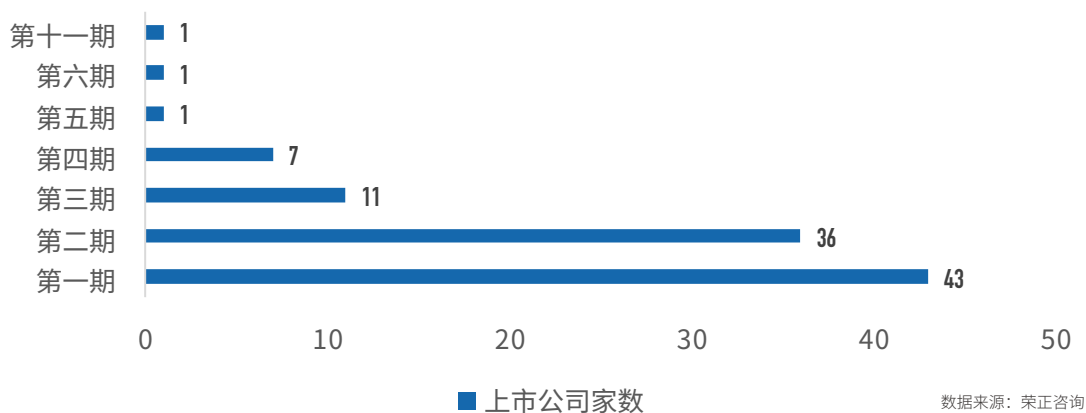
6.2 半导体行业公司上市后股权激励实施情况

6.2.1 上市后股权激励公告情况统计

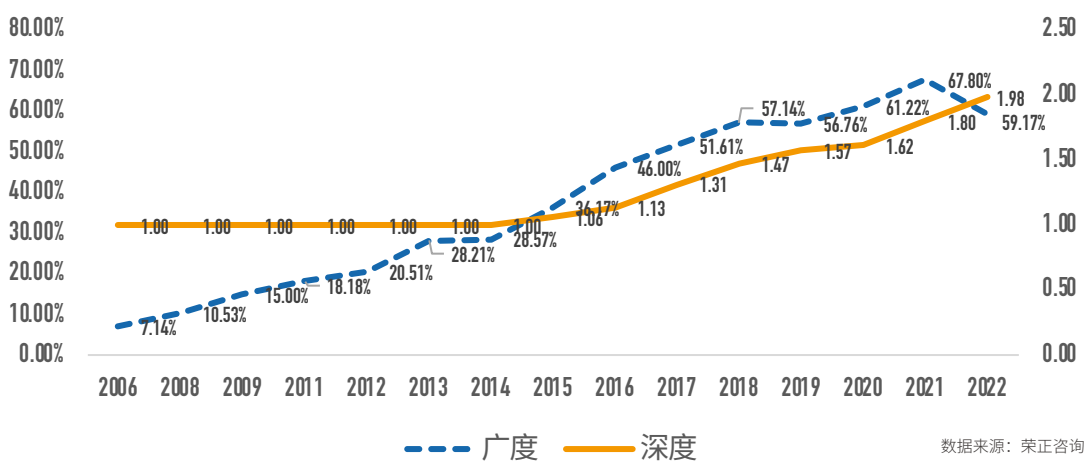


数据来源：荣正咨询

2022年度，A股有50家半导体上市公司累计公告了54期股权激励计划。截至2022年12月31日，A股169家半导体上市公司样本中，100家上市公司累计公告了198期股权激励计划，近年来公告计划期数基本保持了逐年上升的态势。

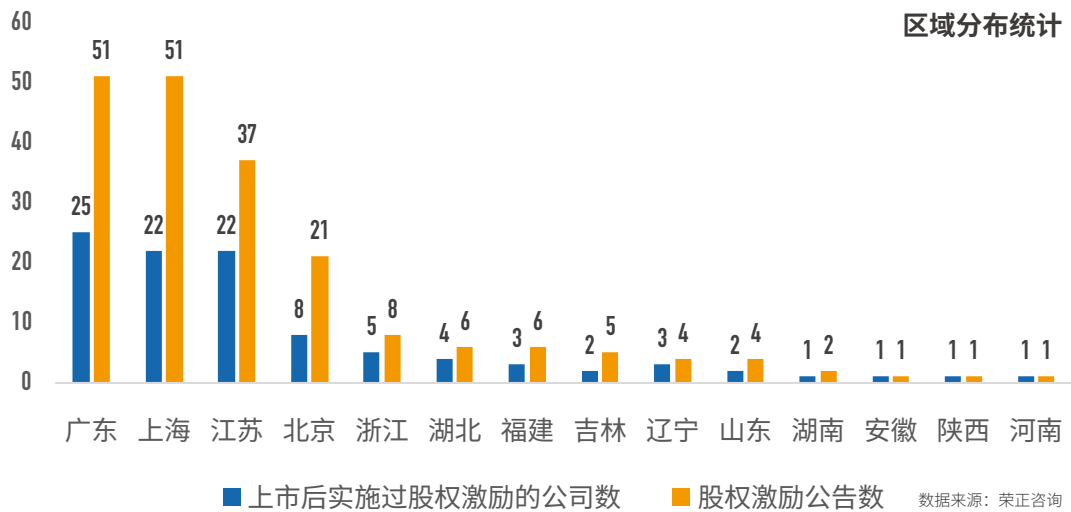


已实施股权激励计划的上市公司中，已有过半数公司实施了多期方案，一定程度上说明股权激励制度已成为大多数半导体行业上市公司的常态化激励制度。

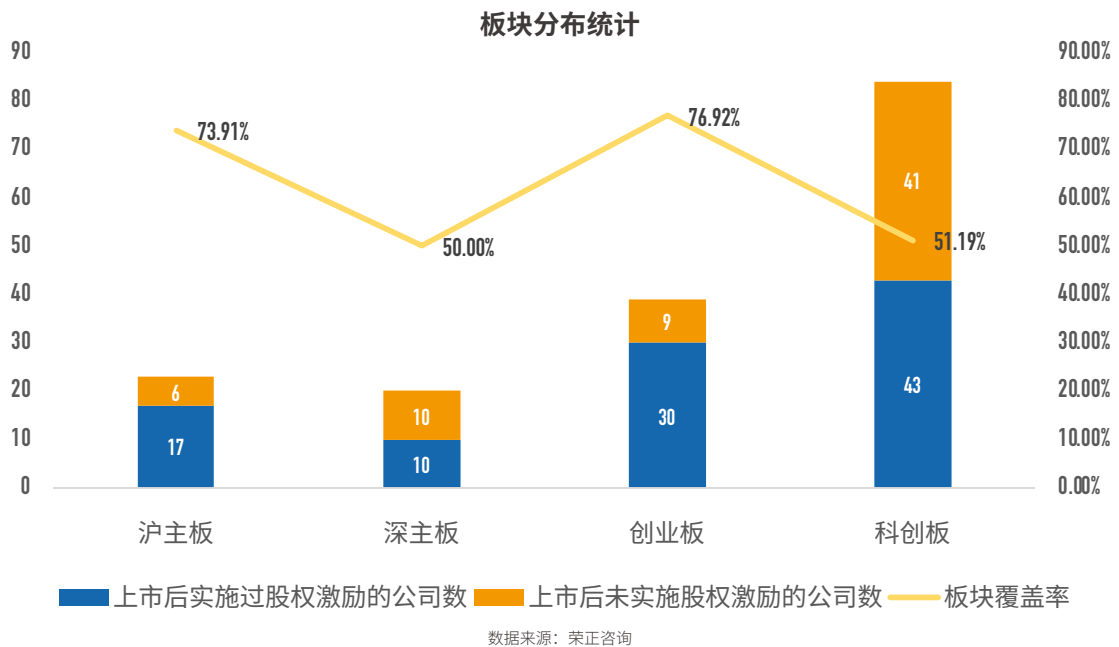


注：股权激励广度 = 累计公告股权激励公司数 / 当年度上市公司总数 × 100%；股权激励深度 = 累计公告股权激励方案数 / 累计公告股权激励公司数

自《上市公司股权激励管理办法（试行）》于2006年1月1日生效实施以来，股权激励已成为A股半导体上市公司优化全面薪酬体系的重要工具。如图2.3所示，半导体上市公司股权激励广度从2006年度的7.14%上升到了2022年度的59.17%；股权激励深度从2006年度的1.00上升到了2022年度的1.98。这表明，越来越多的半导体上市公司选择实施股权激励且愿意实施多期的激励计划来留住和吸引人才。由此可见，半导体上市公司越来越能灵活使用股权这一工具来完善优化公司治理结构。

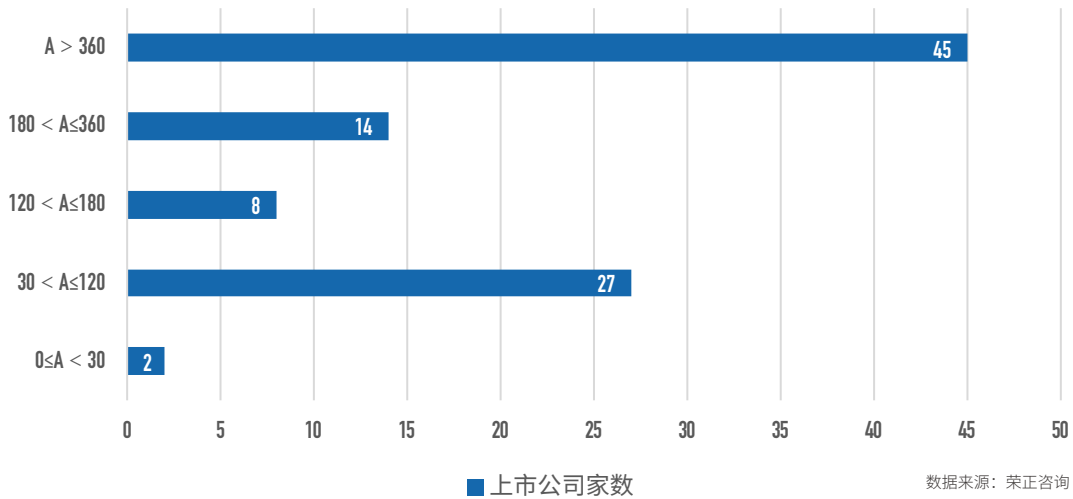


如上图所示，从区域分布来看，沿海地区、华东及华南地区的半导体行业上市公司实施股权激励计划的数量较多。广东省和上海市半导体行业上市公司在 2022 年公告股权激励计划数量最多，均公告了 51 期计划，占比达 25.76%；江苏省、北京市紧随其后，分别公告了 37、21 期计划，占比 18.69%、10.61%。



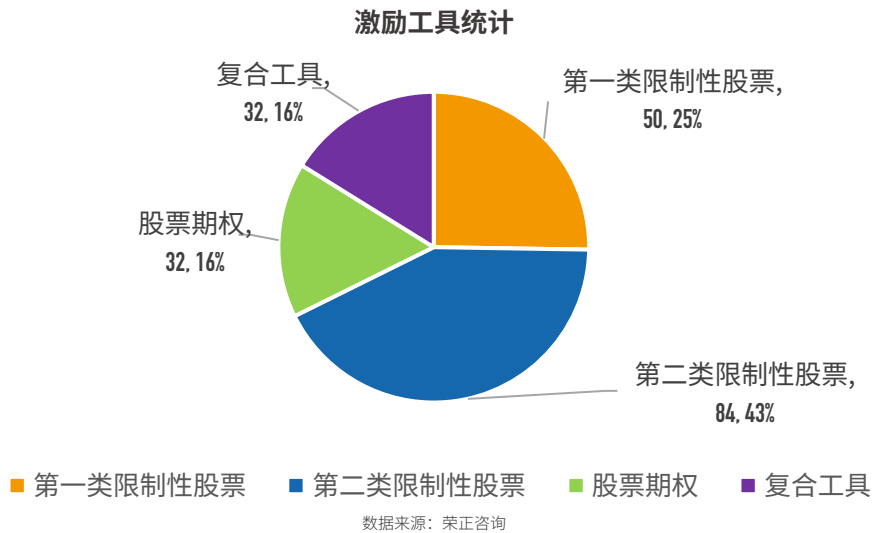
从上图，上市公司板块分布来看，科创板作为硬科技公司聚集地，截至 2022 年底已经上市的半导体行业公司已达 84 家，已占据 A 股半导体行业上市公司的“半壁江山”；其中 43 家公司上市后实施过股权激励，其绝对数量亦领先于其他板块。而从股权激励板块覆盖率来看，除北交所暂无公告案例外，各板块覆盖率均已过半，其中以创业板最高，已达 76.92%。

公告时间统计 (A 为公告日距上市日天数)



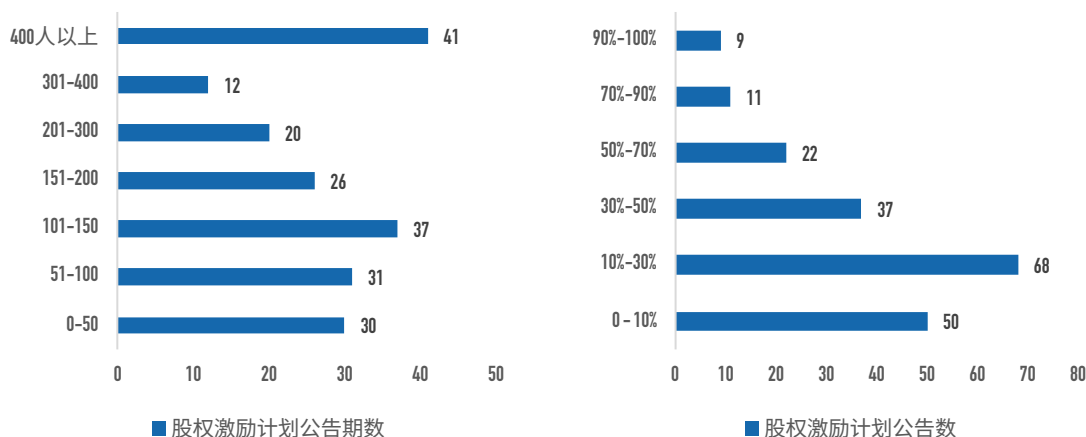
如上图所示, 超半数半导体行业上市公司的首期股权激励计划公告日距上市日在 1 年以内, 这与半导体行业公司对稀缺人才需求旺盛的特点不谋而合, 且充分认可股权激励作为招贤纳士的有力工具。

6.2.2 上市后股权激励要素统计



从上市公司选取的股权激励工具来看, 第二类限制性股票实践中已成为半导体行业上市公司最为青睐的股权激励工具, 占比高达 43%, 尤其在 2022 年度, 54 期公告草案中有 35 期采用了第二类限制性股票作为股权激励工具, 占比高达 65%, 主要由于其授予价格、出资时点等方面的灵活性。第一类限制性股票使用期数占比 25%; 股票期权与复合工具的使用期数持平, 占比均为 16%。

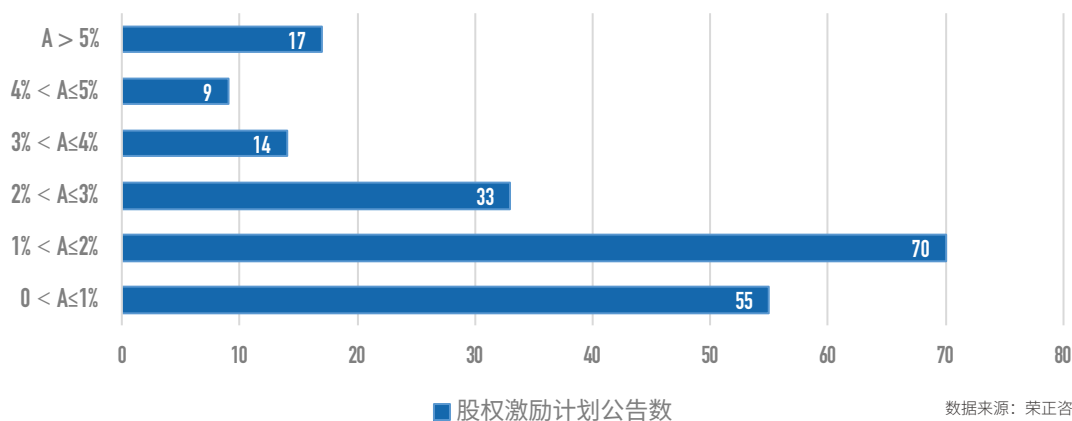
激励对象人数统计



数据来源：荣正咨询

从股权激励员工覆盖率分布来看，以 10-30% 居多，体现了大部分公司将股权激励覆盖面选定在核心骨干员工中。值得注意的是，有 9 家半导体行业上市公司的股权激励员工覆盖率在九成以上，其中，中微公司（688012.SH）公告的 2022 年限制性股票激励计划的员工覆盖率达 99.37%，基本实现了全员持股，落实了中微公司自成立以来一以贯之的扁平化全员激励原则。其中，激励人数最少、覆盖率最低的为南大光电（300346.SZ）2022 年的限制性股票激励计划，授予的激励对象总人数为 1 人，该外籍激励对象为公司新引进的副总经理、技术总监，拥有二十年半导体光刻和工艺研发及生产经验，领导参与了多个先进技术节点研发，南大光电通过本激励计划也是希望能够加速公司的技术迭代，推动公司长远发展。

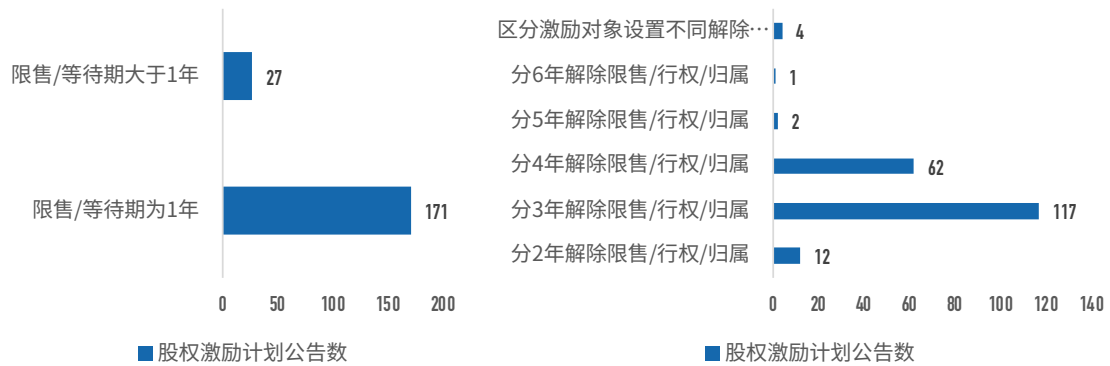
激励总量统计（A 为公告激励总量）



数据来源：荣正咨询

上市公司股权激励需遵循《上市公司股权激励管理办法》中激励总量、个人授予总量的限制，上市公司看待股份支付费用对损益表的影响也更为重视和敏感，同时结合员工出资能力、确定性更强的股票价值（相较上市前）和“滚动授予”的实施节奏，上市后半导体公司单期的股权激励总量相较上市前更低，如上图所示，半导体行业首期公告方案的激励总量平均值为 2.33%，全部已公告方案的激励总量平均值为 2.17%，中位值为 1.49%，大多数公司的激励总量都控制在总股本的 2% 以内。激励总量的确定并没有一个固定的标准可循，具体还是要基于合理测算，在保证激励对象激励力度的同时合理预测股份支付费用对于公司业绩的影响，进而得出一个符合公司实际发展需求的最佳平衡点。

激励时间安排统计

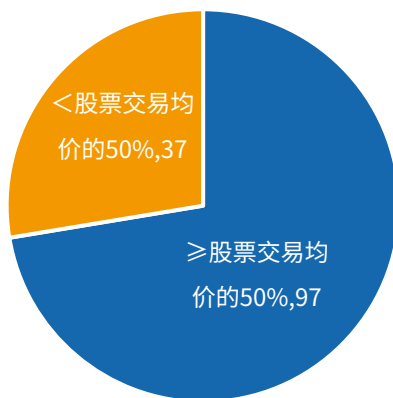


数据来源：荣正咨询

在科技创新类人才高附加值的行业，人才流动更为频繁人才迭代快于产品的迭代，因此大多科技创新公司在发展的不同阶段，采取持续性的激励计划，以保证激励效果的最大化。“1+3”模式是半导体行业上市公司在制定股权激励方案时的主流做法，即限售/等待期为一年，分三年解除限售/行权/归属。

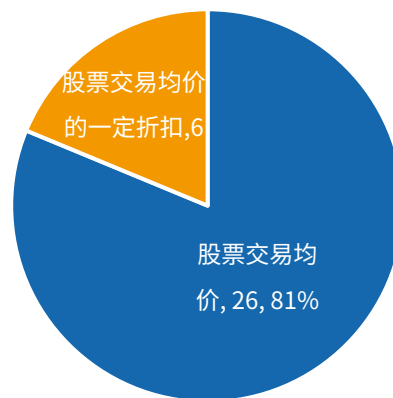
激励定价统计

限制性股票激励计划之授予价格



■ ≥股票交易均价的50%
■ <股票交易均价的50%

股票期权激励计划之行权价格



■ 股票交易均价
■ 股票交易均价的一定折扣

数据来源：荣正咨询

激励定价统计分为已公告的第一类/第二类限制性股票、股票期权以及使用复合工具的统计，具体如下所示：

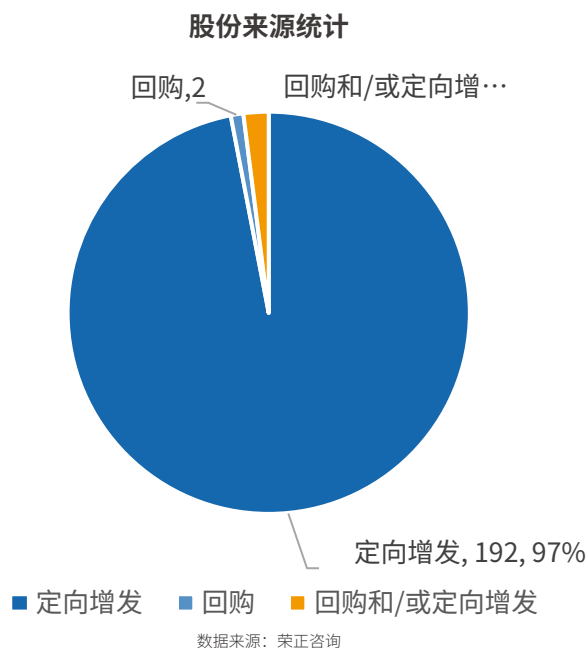
第一类/第二类限制性股票：半导体行业已公告的134期限制性股票激励计划中，97期（72.39%）激励计划均采用不低于公司股票交易均价的50%作为限制性股票的授予价格。

股票期权：半导体行业已公告的32期股票期权激励计划中，26期（81.25%）激励计划是按照公司股票交易均价定价，无折扣，其余6期则按股票交易均价的6-8折定价。

复合工具：半导体行业已公告的32期复合工具激励计划中，限制性股票多数按照公司股票交易均价的

50% 定价，股票期权多数按公司股票交易均价定价。

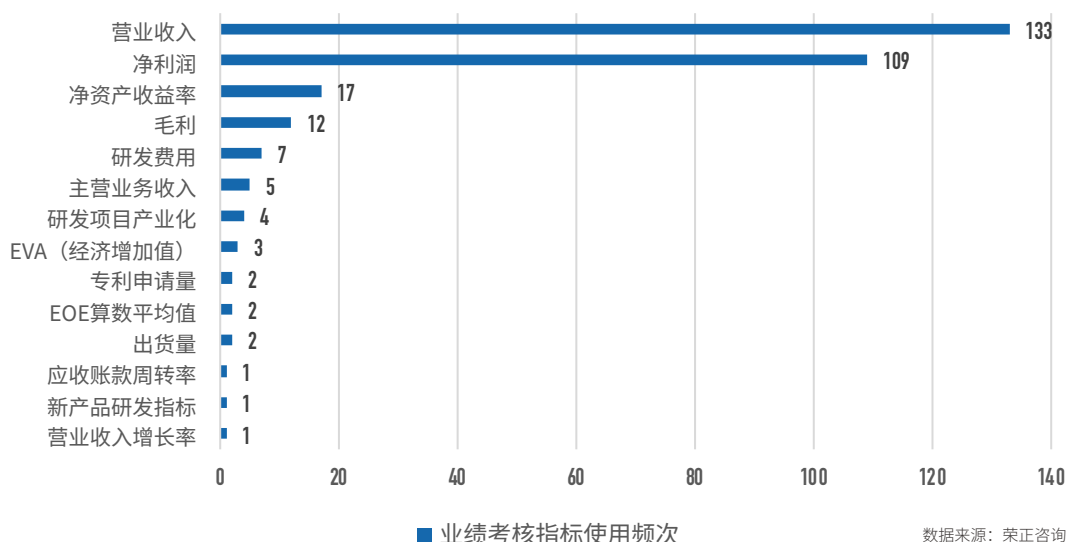
根据《上市公司股权激励管理办法》，上市公司采用其他方法确定限制性股票授予价格/确定行权价格的，应当聘请具有证券从业资质的独立财务顾问，对股权激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、相关定价依据和定价方法的合理性、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见；采用其他方法确定限制性股票授予价格的，应当在股权激励计划中对定价依据及定价方式作出说明。



半导体行业已公告的 198 期方案中，192 期（97%）方案选择定向增发作为股份来源的方式。定向增发是市场通用的激励股份来源方式，其审批流程较为简便、操作效率高且有利于改善公司现金流和资产状况。随着中美贸易战以来，目前集成电路行业整体估值偏高，公司股价涨幅偏大，开展回购型股权激励的难度较大，以定向增发作为股份来源更具实操性。

(7) 业绩考核指标统计

《上市公司股权激励管理办法》规定：上市公司应当在公告股权激励计划草案的同时披露所设定指标的科学性和合理性。上市公司可以公司历史业绩或同行业可比公司相关指标作为公司业绩指标对照依据。公司选取的业绩指标可以包括净资产收益率、每股收益、每股分红等能够反映股东回报和公司价值创造的综合性指标，以及净利润增长率、主营业务收入增长率等能够反映公司盈利能力和市场价值的成长性指标。



股权激励是激励性与约束性的结合，如上图所示，除营业收入、净利润等常规指标外，部分半导体行业上市公司将专利申请量、研发费用、研发项目产业化等研发相关指标作为考核目标，充分反映半导体行业重研发、鼓励创新的行业特性。另外也有一些半导体行业上市国企将 Δ EVA 和 EOE（净资产现金回报率）作为公司层面业绩考核指标。

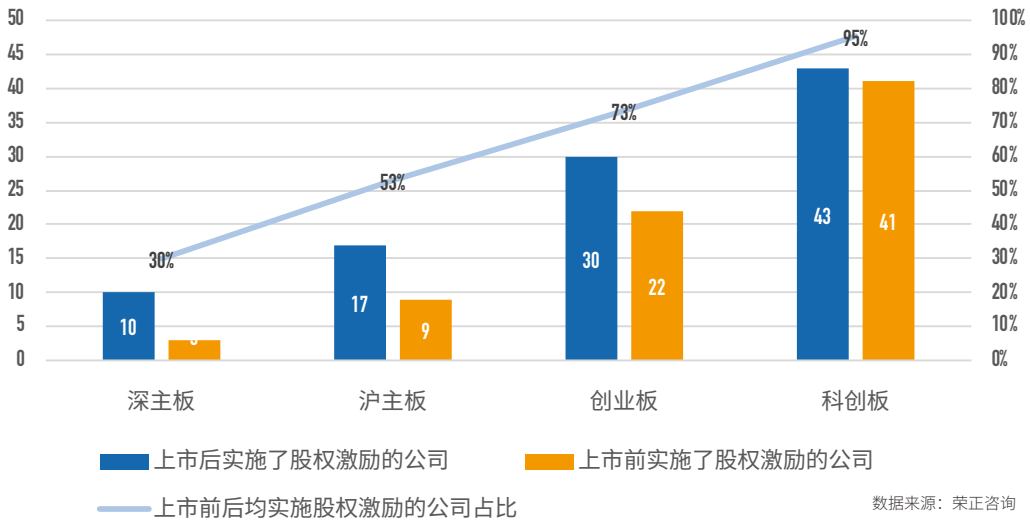
6.2.3 上市后股权激励实践情况总结

股权激励已成为半导体行业激发人才潜力、助推公司高质量发展不可或缺的工具，近 6 成半导体行业上市公司已实施过至少一期股权激励计划，已实施股权激励计划的半导体行业上市公司中超半数实施了多期激励。

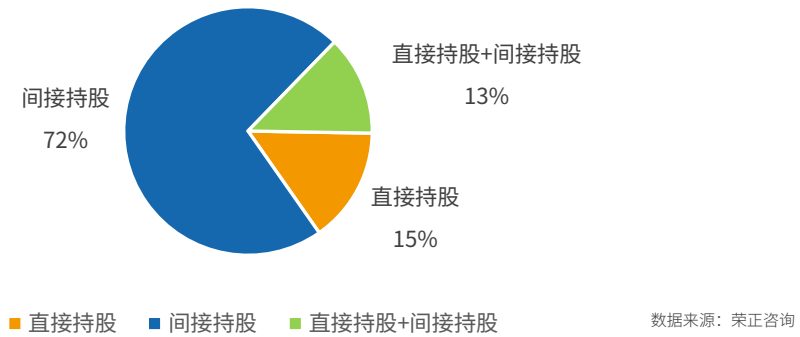
半导体行业的快速发展对人力资本有很强的依赖性，半导体行业的竞争本质上是人才竞争，具有实施股权激励的先天土壤。股权激励作为公司吸引人才和保留人才的重要手段，是公司中长期激励体系的重要组成部分，对公司稳定和发展有着不可忽视的作用，是公司行稳致远的重要助力。

6.3 半导体行业公司上市前股权激励实施情况

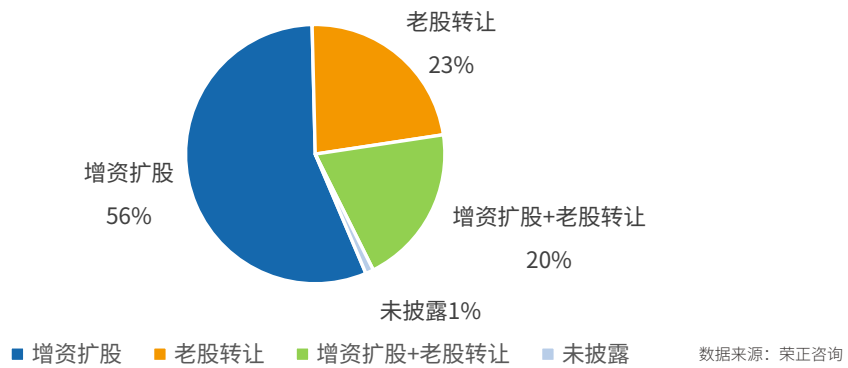
对于公司而言，股权激励聚集人才的效应远不是单一薪酬所能比拟的。在人才驱动为主导的科技经济时代，通过股权激励将核心人才绑定无疑是最牢固的方式。基于半导体企业技术创新、人才依赖的特征，半导体企业在 IPO 前基本都会实施股权激励，在肯定优秀员工历史贡献，鼓励其为公司创造更大的价值，也可以作为吸引外部优秀人才的有效工具。



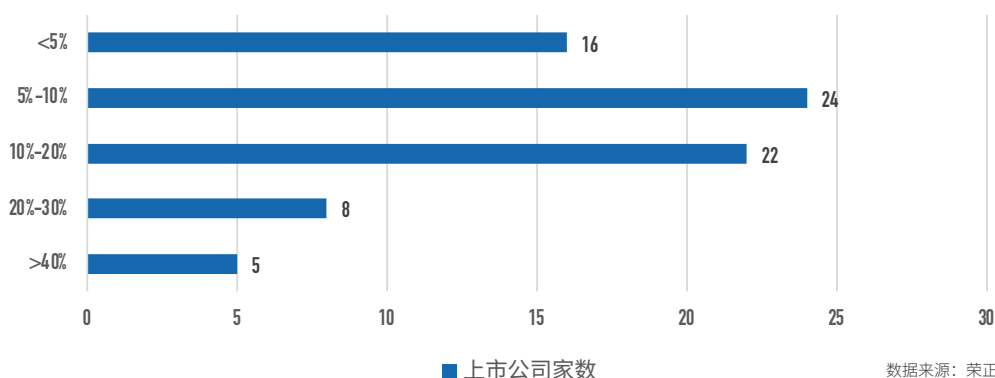
如上图所示，截至 2022 年 12 月 31 日，100 家实施了上市后股权激励的半导体行业上市公司中，共有 75 家在上市前也实施了股权激励，其中科创板和创业板实施了上市后股权激励的半导体上市公司，普遍在上市前也实施了股权激励，占比分别为 95% 和 73%。



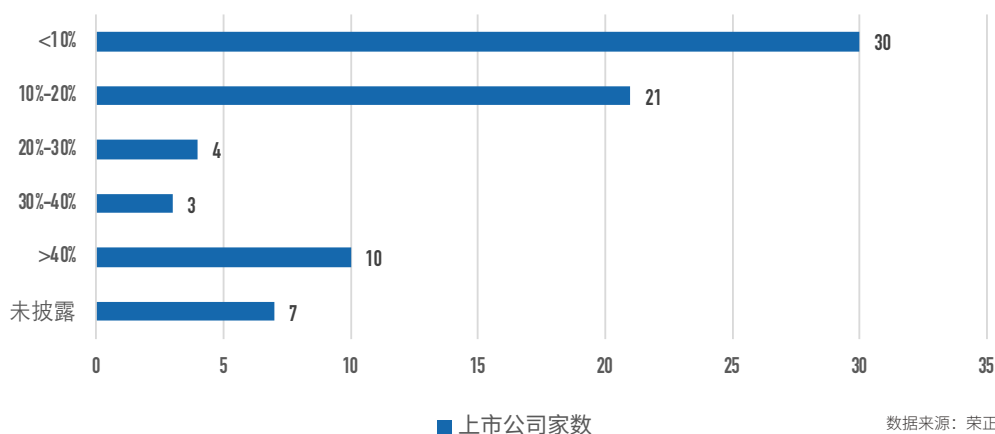
如上图所示，从持股方式来看，在 75 家上市前实施了股权激励计划的半导体行业上市公司中，共有 64 家使用间接持股，占比高达 72%。



从上图股权来源统计可知，在 75 家上市前实施了股权激励计划的半导体行业上市公司中，超半数采用了增资扩股的方式。



从上图激励总量统计可知，在 75 家上市前实施了股权激励计划的半导体行业上市公司中，超半数激励总量不超过 10%。



从上图激励人数占比统计可知，在 75 家上市前实施了股权激励计划的公司中，2/3 以上的公司激励人数占比不超过 20%。

半导体行业上市公司期权带过 IPO 使用情况统计

序号	股票代码	公司简称	上市日	授予日	相隔天数
1	688126.SH	沪硅产业	2020/4/20	2019/4/22	364
2	688521.SH	芯原股份	2020/8/18	2019/6/1	444
3	688728.SH	格科微	2021/8/18	2020/6/26	418
4	688082.SH	盛美上海	2021/11/18	2020/1/1	687
5	688173.SH	希荻微	2022/1/21	2019/6/17	949
6	688153.SH	唯捷创芯	2022/4/12	2020/10/21	538
7	688325.SH	赛微微电	2022/4/22	2020/11/2	536
8	688498.SH	源杰科技	2022/7/1	2020/7/21	339
9	688252.SH	天德钰	2022/9/27	2021/6/7	477

数据来源：荣正咨询

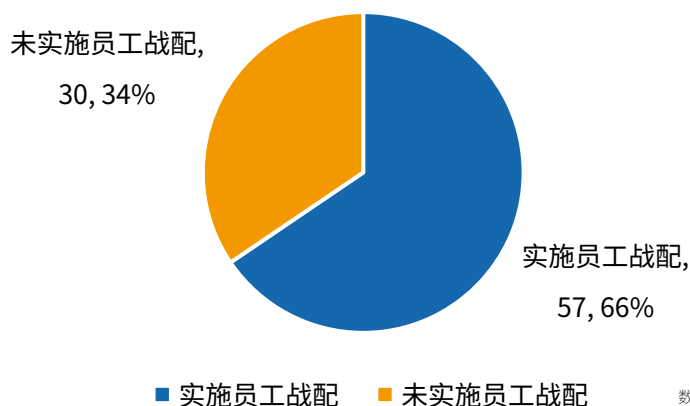
2019年3月上交所发布《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》中第一次明确：上市前制定的期权计划可以在上市后行权。从期权带过IPO的使用情况来看，在75家上市前实施了股权激励计划的半导体行业上市公司中，只有9家使用了期权带过IPO，占比仅为5.33%。半导体公司使用期权带过IPO这一工具案例较少，也是一定程度上受到目前规则中行权出资后需锁定3年且按董监高规定每年减持25%，以及期权行权时提前产生纳税义务造成个税安排与减持安排不匹配的限制。

6.4 半导体行业公司高管及核心员工参与战略配售情况

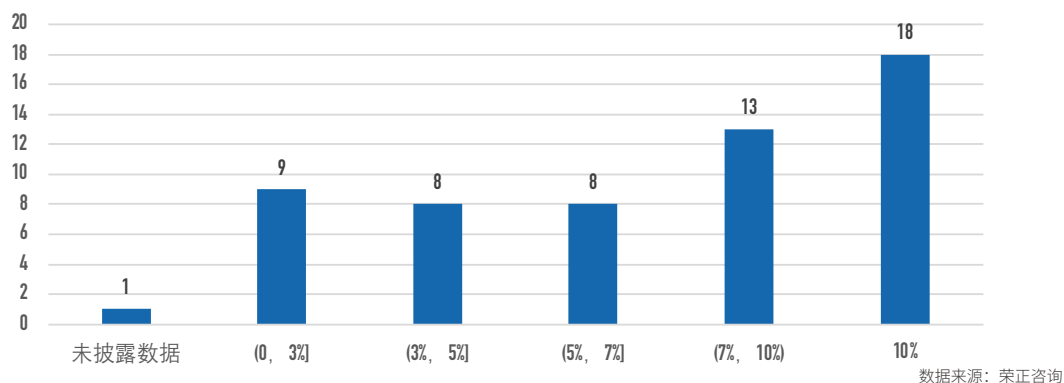
2019年3月，上海证券交易所发布《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》，创新性地提出发行人的高级管理人员与核心员工可设立专项资产管理计划参与发行人战略配售。而后在2020年6月，随着创业板注册制改革发布的《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》亦对员工参与战略配售做出相关规定。

高管及核心员工战略配售（以下简称“员工战配”）作为一种特定形式的“股权激励”，自政策放开实施以来一直备受关注。按照相关监管规定，高管及核心员工参与战略配售需成立一个资产管理计划，并通过该资管计划以发行价格认购本公司首次公开发行的股份，认购股份的数量上限不超过本次公开发行股份的10%，并自上市之日起至少锁定12个月。

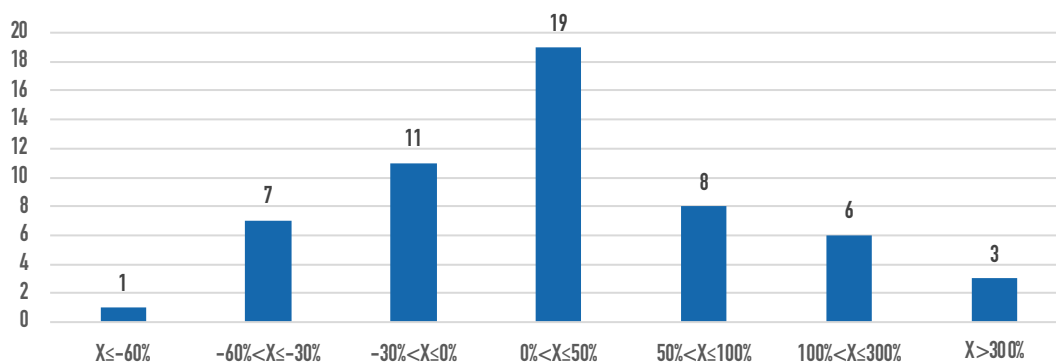
选取169家样本公司中实施了战略配售的科创板公司及2020年8月24日全面试点注册制后上市的创业板公司，共计87家半导体行业上市公司，统计分析半导体行业上市公司员工战配的实施情况。



如上图所示，87家实施了战略配售的半导体行业上市公司中共有57家公司实施了员工战配，占比66%。



如上图所示，实施员工战配的 57 家半导体上市公司中，员工战配获配比例 7% 以上的公司共 31 家，占比 54.39%；其中 18 家公司顶额认购（10%），占比 31.58%。即，半数以上半导体公司员工战配获配比例在 7% 到 10%，三成以上公司选择顶额配售。此外，员工战配获配比例的平均值为 6.91%，中位值为 7.27%。多数公司在实施员工战配的时候选择尽量充分运用激励额度，进一步说明了公司对于员工战配的认同和对核心人才的重视，同样也反映出员工对公司未来长期发展有足够的信心，从而愿意付出一定成本与公司共发展。



数据来源：荣正咨询

如上图所示，以 57 家实施员工战配的半导体上市公司中的 55 家科创板上市公司为样本，统计员工战配截至 2022 年 12 月 31 日的浮盈情况（大部分样本公司员工战配尚未达到解禁时间）。其中，19 家公司的股价处于低于发行价，即 34.55% 的员工战配为浮亏状态，其余 36 家公司的股价超过发行价，即 65.45% 的员工战配为浮盈状态。

如前文所述，员工战配可视为一种以发行价为主要参与成本的股权激励，如果锁定期届满后，企业股价超过发行价，那么员工战配更能彰显对核心人才的正向激励和财富效应。此外，员工战配作为在上市时点的一种员工激励工具，可以进一步扩充或者增强上市前设立的员工持股平台激励范围和人数，进一步增强高管和核心员工与公司之间共赢的利益关系，成为上市前股权激励的有效延续，并为上市后实施股权激励计划奠定基础，员工战配因此获得更多企业的青睐与认可。

半导体行业解码器

围绕半导体企业的业务经营管理为中心，
赋能、陪伴、成就半导体企业的绩效提升及组织发展。

公会介绍：

“半导体HR公会”-上海思将企业管理咨询有限公司 是国内唯一一家聚焦半导体企业战略及组织能力打造的行业服务平台，作为中国电子发展研究院与中国半导体行业协会发起的《中国集成电路产业人才发展报告》（人才白皮书）创始编创单位，自2016年起连续六年参与问卷的设计，收集及编写，通过多年全面透视产业人才结构，企业组织结构及行业薪资趋势，为政府制定产业政策及半导体企业制定人力资源发展战略提供有价值的参考。作为半导体行业的“解码器”，我们致力于为谋求成功的半导体企业提供以绩效提升为目标，涵盖战略及利润提升、组织架构及管理体系搭建、人才选拔与培养、目标共识与效能、领导力与永续经营、企业竞争力打造等的一系列咨询、培训、团队活动、高管及团队教练等不同形式的长期深度陪伴，支持并赋能企业可持续发展。

公会发展历程：

确立“半导体行业解码器”全新定位以助力企业成功为目标，聚焦企业战略及组织能力打造，服务全面升级；聚合多方资源，围绕业务经营管理为中心，打造“业务及组织发展专家顾问团”，全面支持企业可持续发展；

2023

启动会员注册制，企业会员突破1200家；以支持半导体行业人力资源工作降本提效为目标，成立行业HR智库，围绕人力资源范畴，启动平台化集采和咨询培训类服务；

2022

正式独立运营，以赋能半导体行业人力资源从业者为目标，推出人力资源系列公开课及训练营；与中国半导体行业协会正式合作，成功举办年度第一届“芯”雇主-半导体行业优秀人力资源案例评选；

2021

独家梳理半导体行业专属岗位及职级体系，并与“薪智”开启独家战略合作，成功推出《半导体行业年度薪酬报告》以及第一版《半导体细分产业环节岗位薪酬报告》；

2019

与工信部正式合作，成功编创并发布首份《中国集成电路产业人才发展报告》；成功主办“第一届半导体行业人力资源论坛”。

2017

公会服务及产品：



咨询 培训
团队建设

- 四大主题：业绩持续增长、组织能力建设、领导力打造、企业文化建设
- 四种服务形式：咨询，培训，关键项目辅导，团队/高管教练
- 团建活动：拓展训练、体验式项目、家庭日、运动会、年会



薪酬及数据

- 年度中国半导体行业薪酬趋势报告
- 年度中国半导体产业人才洞察报告【标准版】【定制版】
- 半年度 半导体行业细分产业环节岗位薪酬报告【标准版】【定制版】
- 季度半导体行业人力资源调研报告：人力资源预算，调薪率，年终奖，应届生薪酬等)
- 智能薪酬SaaS平台：smartsalary.isee-hr.cn



论坛、峰会
与公益活动

- 年度中国半导体人力资源论坛
- 年度“芯”雇主-半导体行业人力资源优秀实践案例评选
- 公益活动（仅会员单位）：组织赋能系列主题讲座、行业赋能系列高管教练体验活动，ESG相关活动

联络我们：

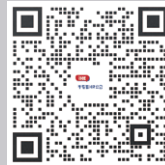
021-51137888

hrservice@isee-hr.cn



公众号二维码
扫码关注
了解更多产品及活动

扫码联系客服
申请入会
申请加入半导体HR公会





2018年
荣获新锐创新企业



2020年
荣获高新技术企业



云宣讲直播平台



电子信息产业
垂直招聘网站



技术课程平台

覆盖30+城市200所高校1000+
电子类相关理工科院系50万+本
硕博；
为广大用户提供职业规划/技术类
职业教育培训/校招实习等就业服
务；
为企业提供校招.实习.社招.雇主
品牌宣传.HRsaaS系统.直播等人才
服务。

公司介绍

复醒科技致力于打造电子信息产业数字化招聘平台，由复旦大学微电子学院硕博创办，成立于2017年9月1日，用数字化赋能科技产业人才服务，成为洞察客户产业人才需求卓越的人才解决方案提供商。

客户第一 · 诚信负责 · 积极主动 · 精进创新 · 利他共赢 · 拥抱变化

主营业务



大同学吧招聘小程序



大同学吧校招订阅号



大同学吧社招服务号



C端服务

半导体技术类职
业教育培训



智能微纳加工和测试

微纳加工服务
测试服务



HRsaas云系统

简历管理系统
薪酬查询系统
人才分布数据
职业测评系统



高校实验室服务

课题组实验室数
字化软硬件管理
和学术知识库管
理saas软件

合作企业

主要覆盖半导体、人工智能、汽车电子、智能制造、通信、软件、云计算、大数据及相关领域；目前平台合作有2000家硬科技企业。

数字芯片

存储

硬件

人工智能

汽车电子

Qualcomm

Micron

dji
大疆创新

nvidia

NXP
恩智浦半导体

MARVELL

EXMT

HIKVISION

Cambricon
寒武纪

ST
life.augmented

BES
佰文科技

长江存储
YANGTZE MEMORY

永贵科技

Enflame
燃原科技

SEMORVE
芯耀科技



13022123703

http://fuxingtech.com/

上海市浦东新区张江路665号德宏大厦808室

合作咨询微信





扫码关注荣正咨询



扫码添加官方客服

为什么选择“荣正集团”

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司（以下称“荣正”）是中国证监会授予的证券投资咨询从业资格机构，并成为首批证监会独财报告备案机构。“荣正”由郑培敏先生创立于1998年，以国际规范的投资银行理念与组织结构组建，同时深耕中国土壤，是一家股份化、知识型，并向合伙人制发展的智慧型“投资银行精品店”（INVESTMENT BANKING BOUTIQUE）机构。公司总部在上海，并在北京、深圳、广州、成都、杭州等地设有办事处。“荣正”以“股权激励”理论和实践研究为核心业务，已成为国内公认的股权激励咨询细分领域的开创机构&领导品牌&隐形冠军，沪深A股上市公司有效市场（按已经聘请了具有证券从业资格的独立财务顾问的企业统计）占有率已经达70%。

如何将优秀的人才与企业结成“利益共同体”，实现双赢局面？股权激励成为越来越多企业的不二之选。通过有效的激励制度打造留人育人的闭环管理，构建企业的顶级人才生态。“荣正”深耕企业中长期激励制度25年，拥有千余家服务案例，有效助力企业实现人力资源的资本化和人力资本的证券化。

01 全案咨询（KCL）

面向上市公司、新三板公司及有支付能力的拟 / 非上市公司，“荣正”专业、高效的项目团队全程服务于整个激励计划的所有会计年度，包括但不限于开展尽职调查、设计优化方案、公告材料准备、协助报会沟通反馈、会计处理、与会计师、律师沟通等服务。

02 轻咨询（KCE）

面向拟上市公司、新三板公司与财务法律规范、资本运作路径清晰、已引进VC/PE的非上市公司，“荣正”团队一次性驻场2-3天进行诊断，3-6个月内线上咨询，并提供框架性股权激励方案文本。

03 微咨询（KCC）

面向有上市梦想、但未启动券商上市辅导的企业；面向所有人力资源从业者匠心打造“小而精”、“专而精”的股权激励方案落地课程。

课程受益

- ▶ 本课程的目标是帮助企业建立关于中长期激励制度的科学认知，并从实操层面拆解股权激励的关键要素、工具。
- ▶ 通过分享25年的一线经验、解析千余家案例库，手把手教授激励方案设计要领，帮助有上市梦想、但未启动券商上市辅导的企业建立系统全面的激励体系，规范公司治理，突破业绩瓶颈，实现企业价值。

理论 + 实操 + 案例

助您从0到1深度了解激励

微
咨
询
面
向
人
群

企业版

企业董事长、总经理、
董秘、人力总监、财务总监
等相关决策部门高管。

个人版

愿意学习股权激励系统
知识、希望掌握股权激励实务
操作能力的从业人员。

